ACCRETECH

INTEGRATED REPORT 2026

東京精密 統合報告書 **2026**

イントロダクション

融合 ～加速するシナジー～ 精密測定機器×半導体製造装置

精密測定機器と半導体製造装置、東京精密グループが擁する両事業のシナジーが加速しています。既に市場には、精密測定機器事業が誇る非接触三次元表面粗さ・形状測定機「Opt-scope」を搭載した半導体製造装置が投入され、切断途中のウェーハ断面の測定や、ICの電極に付けられた検査針跡の深さ測定などの従来にはなかった価値をお客さまにもたらしています。この他にも、大学との共同研究といった、第三者とのコラボレーションも進展してきました。

生成AIブームなどが追い風となり、当社グループの業績は中期経営計画目標を上回る勢いで伸びています。そこに拍車を掛けるのが、両事業のシナジーです。

市場のニーズは刻々と変わっていきます。事業の形も、市場の趨勢とともに変わっていくべきです。当社グループはさまざまなシナジーを通じ、さらなる成長につなげるべく事業の新たな姿を模索していきます。

	2025年度実績	(2025-2027年度)単年度※
売上高	1,668億円 半導体製造装置1,279億円 精密測定機器390億円	1,850億円 半導体製造装置1,400億円 精密測定機器450億円
営業利益	337億円	450億円
営業利益率	20.2%	24%
ROE	13.5%	15%

※3か年のいずれかの単年度目標

目次

Introduction

2 イントロダクション
3 目次
4 東京精密のめざす姿
5 東京精密のDNAと使命
6 事業ポートフォリオ
8 At a Glance
9 会長メッセージ
10 CEOメッセージ

Strategy

15 東京精密がめざす“夢のある未来”
16 東京精密グループ長期ビジョン2050
17 中期経営計画
26 CFOメッセージ
28 財務/非財務ハイライト
30 価値創造プロセス
31 東京精密のビジネスモデル
32 業務会社カンパニー長メッセージ
34 マテリアリティの改定
36 サステナビリティマネジメント
37 知財戦略
39 人財戦略
42 DX戦略
43 環境
51 サプライチェーンマネジメント
53 人権の尊重

Governance

55 社外取締役座談会
59 取締役・執行役員
61 コーポレート・ガバナンス
66 コンプライアンス
68 リスク管理
70 株主・投資家の皆さまとの対話

Data

71 主要連結財務データ
74 非財務データ
75 会社情報・株式情報
76 編集方針・報告対象

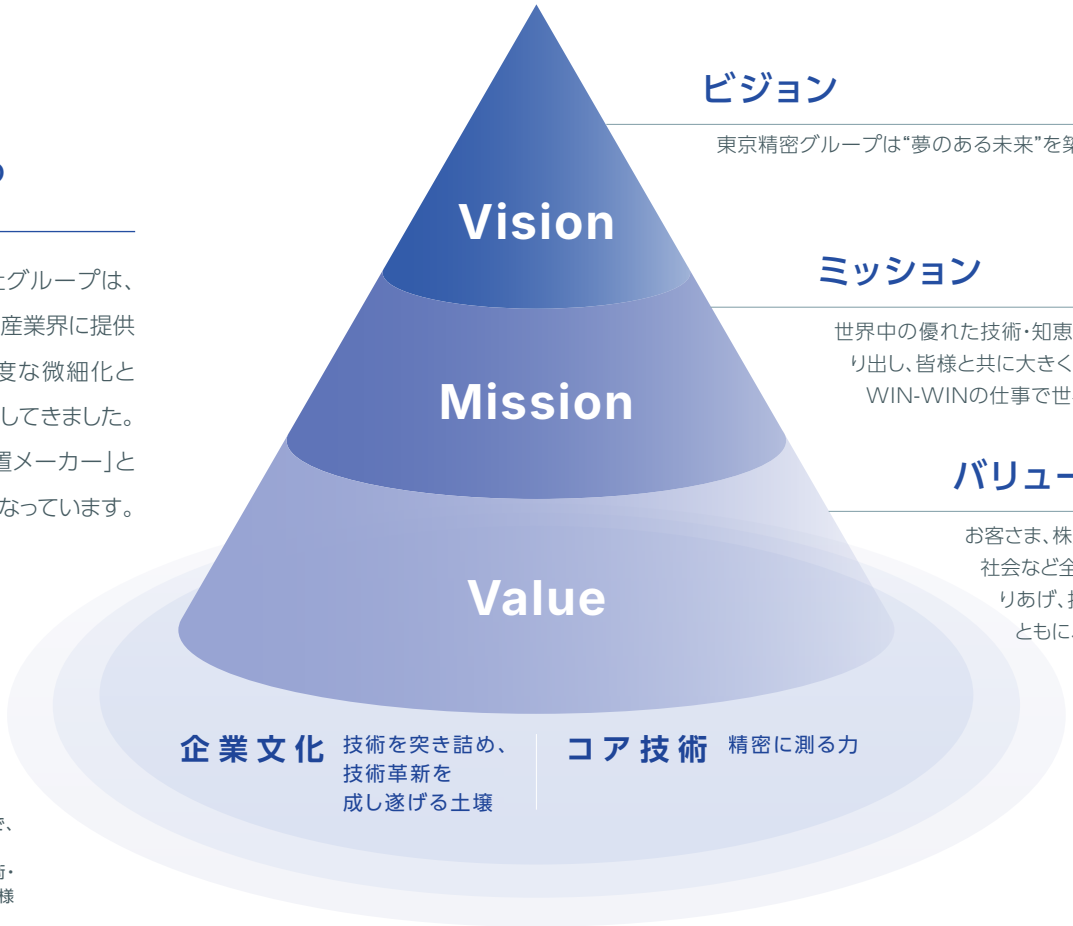
東京精密の目指す姿

創業時から受け継ぐ「技術を突き詰め、技術革新を成し遂げる土壌」を継承し、
世界中の技術・知恵・情報の融合で「夢のある未来」の実現を目指します

Purpose パーパス

計測で未来を測り、
半導体で未来を創る

精密測定機器事業からスタートした当社グループは、高い計測技術を搭載した精密測定機器を産業界に提供し、半導体製造装置事業においても高度な微細化と3D、高効率化への対応に計測技術を活かしてきました。「計測事業を持つ唯一の半導体製造装置メーカー」という特徴は、当社グループの強みの源泉となっています。



ビジョン

東京精密グループは“夢のある未来”を築く一員であり続けます。

ミッション

世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の商品を創り出し、皆様と共に大きく成長していく
WIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう

バリュー

お客さま、株主の皆さま、サプライヤーさま、従業員、地域社会、国際社会など全てのステークホルダーとの間でWIN-WINの関係を創りあげ、持続可能な社会の実現に向け積極的に役割を果たすとともに、企業価値の向上に努めます。

コーポレートブランド

ACCRETECH（アクレーテク）

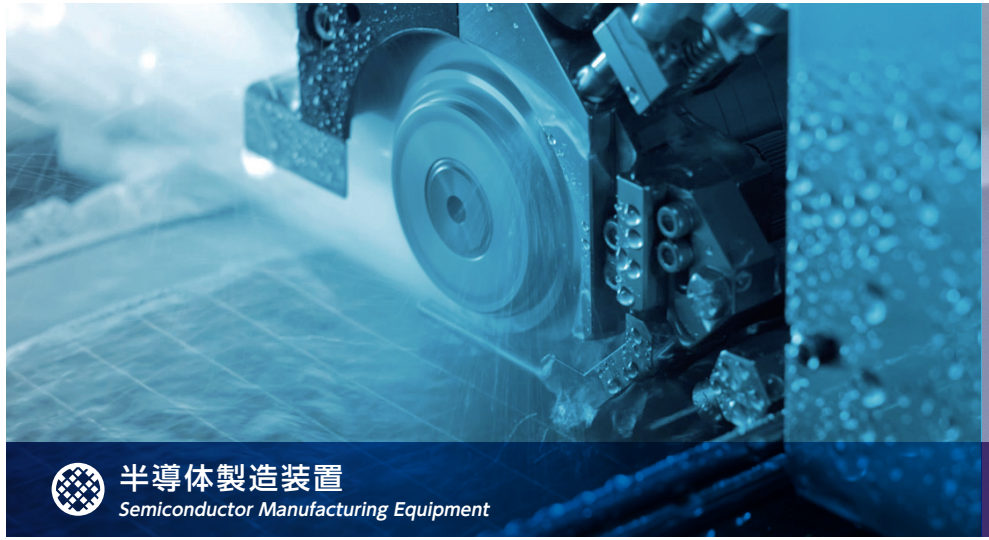
“Accrete（共生）”と“Technology（技術）”の合成語で、Grow Together を意味しています。
シンボルマークには、企業理念「世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の商品を創り出し、皆様と共に大きく成長していく」が表現されています。

東京精密のDNAと使命

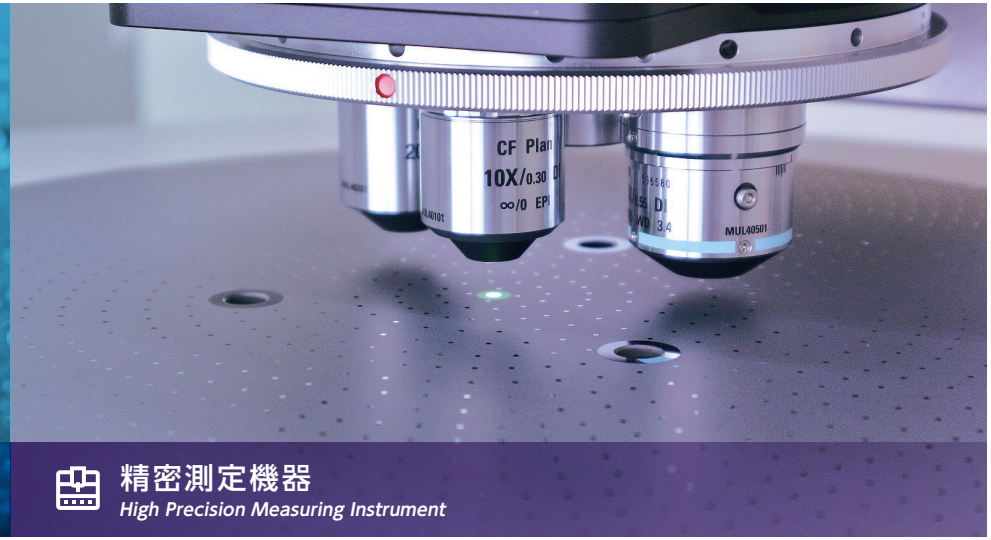
WIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう

WIN-WIN RELATIONSHIPS CREATE THE WORLD'S No.1 PRODUCTS

当社製品・サービスがなければ「モノを作れない・測れない」絶対的なポジション確立



半導体製造装置
Semiconductor Manufacturing Equipment



精密測定機器
High Precision Measuring Instrument

私たちの使命は、お客さまと共に成長を続けながら世界一のモノづくりを実現することです。次世代製品の実現とそれを市場に提供するためには、ブレイクスルーを起こす技術が必要です。創業当初から70年以上にわたり培ってきた世界トップレベルの技術力を活かした精密測定機器と半導体製造装置を世に送り出し、お客さまのモノづくりに新たな可能性を提供しています。

"測れないものは、つくれない。"

全てのモノづくりは「測る」というプロセスなしにはできません。当社は「測れないものは、つくれない。」という考えを基本に、あらゆるものを超高精度に、高速に測る技術で世界中の産業界の発展を支えています。また、この精密に測る力は半導体の高性能・微細化といった進化の支えにつながっています。私たちは時代の最先端を支えることで、人々の豊かな暮らしと新たな未来に貢献しています。

事業ポートフォリオ

半導体製造装置事業



東京精密グループはコア技術である「精密に測る力」を磨き、高精度の位置決め技術を活かして、ウェーハの製造から後工程まで幅広く半導体製造装置を提供してきました。
これからも、計測技術を持つ唯一の半導体製造装置メーカーとしての強みを活かし、優れた製品を提供していきます。

半導体を“測る・切る・削る・磨く”

検査装置
半導体の信頼性を確保するために、製造過程ごとに検査して、適切な品質が保たれているかを調べるための装置です。東京精密グループは中でも、半導体チップの電気的特性の試験に強みを持ちます。

加工装置
半導体を製造する「シリコンウェーハ製造工程」「前工程」「後工程」の3つの工程それぞれに、コア技術である「精密に測る力」を活かした製造装置を数多く提供しています。



全自動高剛性3軸研削盤
HRG3000RMⅡ



世界トップクラスのシェア(当社調べ)
プロービングマシン
ウェーハ上のチップの電気的特性を測定・検査するための高精度な位置決め機構を持つ装置



300mmウェーハ対応
高性能プロービングマシン
AP3000/AP3000e



ポリッシュ・グラインダ
ウェーハの表面や裏面を高精度に研削(グラインド)し、その後に研磨(ポリッシュ)して平坦で滑らかな面を作り出す装置



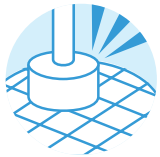
剥離洗浄機
ワイヤーソーでスライス後のインゴット洗浄からウェーハ枚葉化、スクラブ洗浄を行う装置



エッジグラインダ
半導体ウェーハの外周部(エッジ)を加工し、角を丸めたり面取りして欠けや割れを防止する専用の研削装置



CMP装置
ウェーハ表面を化学的な薬品(スラリー)と機械的な研磨パッドを組み合わせて平坦化する装置



高剛性研削盤
特に剛性を高めた構造をもち、SiCやGaNなどの難削材や硬脆材料の基板を高速かつ低ダメージで研削できる装置

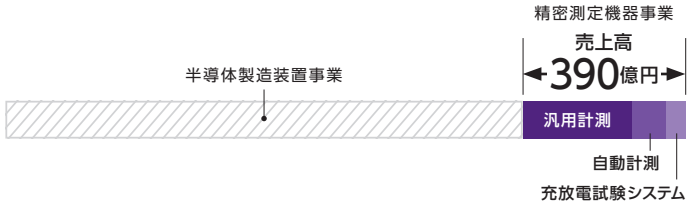


ダイシングマシン
ウェーハ上に形成された多くの集積回路を、1個1個のチップ(ダイ)に切断する装置

より速く、より精密に、より高度に。

事業ポートフォリオ

精密測定機器事業

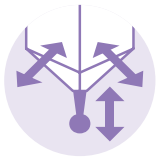


全てのモノづくりは「測る」というプロセスなしには実現できません。
東京精密グループは、世界トップレベルの計測技術を駆使し、世の中のモノづくりを支える精密測定機器を展開していきます。

寸法、形状、粗さを“測る”

汎用計測（座標・形状測定機）

ワークの寸法や粗さ、形状を測定するスタンドアローンの測定機



国内トップクラスのシェア（当社調べ）
三次元座標測定機
物体の寸法や形状を三次元的に正確に測るための高精度な測定装置



三次元座標測定機
XYZAX AXCEL



真円度・円筒形状測定機
円や円筒形の形状精度を厳密に測定する装置



国内トップクラスのシェア（当社調べ）
表面粗さ・輪郭形状測定機
表面の粗さや輪郭形状を高精度に数値化して評価する装置



X線CT装置
X線を使って物体内部の断面画像や立体構造を可視化する装置



光学測定機
光を使って物体の形状や寸法、表面状態を非接触で高精度に測定・検査する装置

充放電試験システム

二次電池やキャパシターに対して「充電」と「放電」を繰り返し、その性能や品質、耐久性などを評価する計測システム



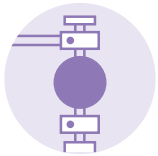
充放電試験システム
充放電試験装置の販売と電池評価受託サービスを提供



エネルギーシェア式
充放電試験装置

自動計測（マシンコントロール測定コンポーネント）

製造ライン上や製造装置内で製品をリアルタイムに検査・測定する測定コンポーネント



マシンコントロールゲージ
工作機械などの動作中に、測定したデータをもとにリアルタイムで機械の制御をするための測定・制御装置



PULCOM W10

より速く、より精密に、より高度に。

At a Glance

主要指標

売上高
1,668億円

営業利益
337億円

営業利益率
20.2%

当期純利益
248億円

ROE
13.5%

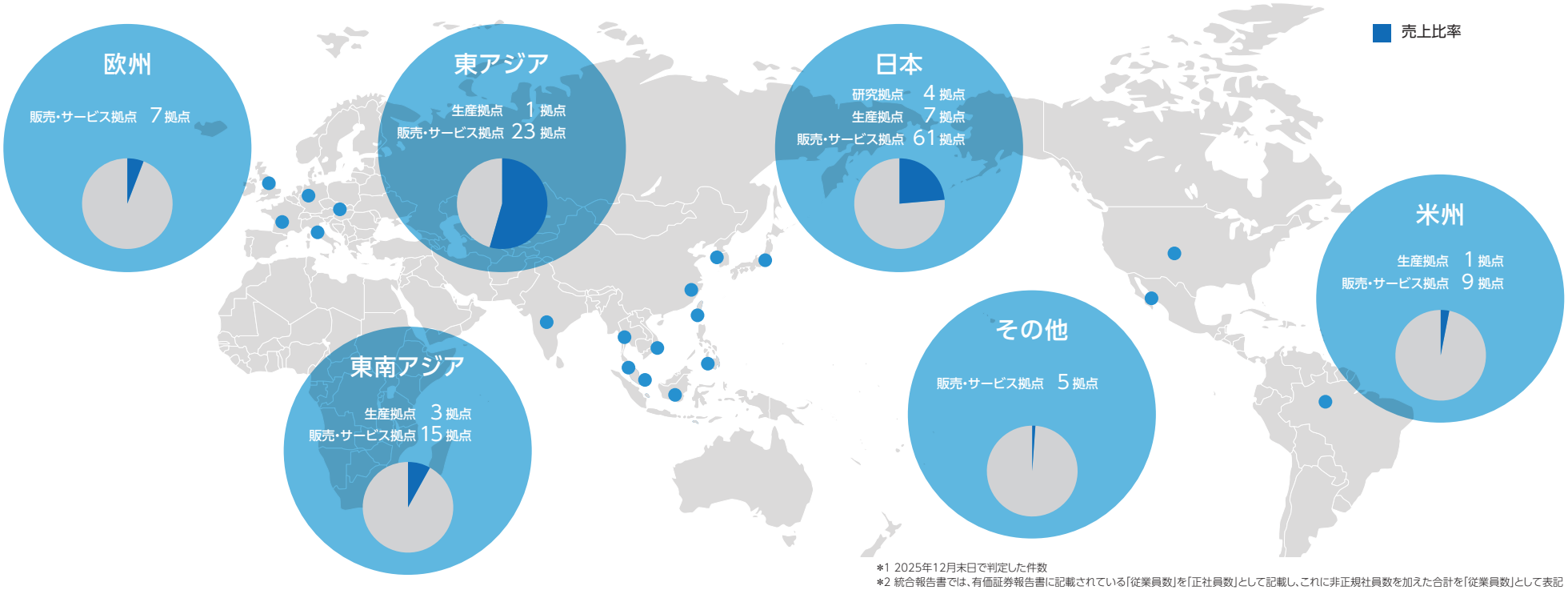
研究開発費
120億円

特許保有件数
1,326件*1

従業員数
3,487名*2

管理職女性比率
2.9%*3

CO_2排出量
19,446t-CO_2*4



*1 2025年12月末日で判定した件数
*2 統合報告書では、有価証券報告書に記載されている「従業員数」を「正社員数」として記載し、これに非正規社員数を加えた合計を「従業員数」として表記
*3 (株)東京精密(単体)　在籍者に占める割合
*4 東京精密(連結)　Scope1+Scope2
Scope2の電気については、(株)東京精密(単体)はマーケット基準、連結子会社(国内・海外)はロケーション基準により算定

会長メッセージ



みんなと「WIN-WIN」であり続けられるために

代表取締役会長　吉田 均

当社グループは、コア技術を基盤としてさまざまな技術を積み重ね、製品づくりをしてきた会社です。最近では半導体製造装置が注目を集めていますが、ベースにあるのは計測の技術で、地味であってもそこを大切にしてきたからこそ、しっかりした会社になりました。

思い出すのは、昔NHKで放送されていた「超絶 凄(すご)ワザ!」という番組のことです。精密加工技術で著名な企業2社が作った金属球を幅10センチのレールの上に転がし、どちらがより遠くまで直進できるかを競う回があり、球の真球度を測るのに使われたのが当社グループの測定機器でした。自動車でもその他の産業でも、本当に精度を上げたい時に必要とされてきたのが我々の製品です。そのことは本当に誇りに思っています。

もうひとつ特徴的なのは、各方面で「WIN-WIN」の関係を大事にしてきたことです。自分のことだけを考えていると、その時々は良くても関係が続きません。サプライヤーでも顧客でも、株主でも従業員でもそうです。長い目で見て両方が得をする関係というのを、私たちは昔から重んじてきています。私も経営者として一番大事にしてきました。

例えば、当社とドイツの光学機器メーカー、カール・ツァイスとは、提携を結んでから既に30年以上が経ちます。互いに「WIN-WIN」であり続けられたからこそ、関係が続いているのです。顧客やサプライヤーでも、長い付き合いのところは数多くあります。木村社長も研修会などでたびたび語っている「相手の立場に立った時にどう見えるか、感じるか」がとても重要で、私も大切にしています。これこそが当社グループの本質だと思っています。

企業が存続していくためには、確かに利益は必要です。でも利益だけを追求していては長続きしません。本当に大切なのは、世の中の役に立つことです。当社グループは、半導体製造装置を通じて世の中に無ければならない半導体の製造に貢献し、一方ではあらゆるモノづくりに絶対必要な精密測定機器を提供し続けてきました。本業を通じて、社会の発展に貢献してきたと自負しています。さらに、サプライヤー各社と共同して人権への取り組みを国内外で進め、環境負荷物質への対応などの環境面も含めサステナビリティ全般の推進も支援してきました。本来業務ではないので面倒と思われがちなことではありますが、企業価値とはそういうところに出るものだ、と思うのです。

今年の夏も暑かったです。最近の気候は、私たちの子どもの頃に比べて異常といえる状況です。これは日本だけではなく世界中で起きています。このままでは本当に大変なことになるのではないでしょうか。子どもたち、孫たちの世代にこの世界を引き継いでいくために、積み重ねた技術、得られた利益を使って私たちには何ができるのか。みんなと「WIN-WIN」であり続けられる方法を、これからも考え続けたいと思います。

CEOメッセージ



「絶対的なポジション確立」が、当社の価値の完成形

代表取締役社長CEO　木村 龍一

強みと目指すこと

コア技術により、他にはない価値を社会に

我々のコア技術はやはり「計測」です。祖業である精密測定機器事業の計測技術があってこそ、半導体製造装置が作れ、競合との差別化も可能となります。

当社のパーパス「計測で未来を測り、半導体で未来を創る」は、案の段階では実は「未来を測り、未来を創る」でした。「計測」と「半導体」という言葉を追加したのは、コア技術を用いた半導体製造装置が差別化要因となり、ビジネス上大きなボリュームを占めている会社だと社内外に伝えるためにより効果的だと考えたためです。

企業の寿命は30年、とよく言われますが、中には100年以上の歴史を持つ老舗企業もあります。何が違うのか。それは独自の技術を持っていることです。そういう何かがあれば、会社はずっと発展し続けられる。当社の場合は「計測」というコア技術です。それを半導体製造装置と「融合」させ、他にはない価値を社会にもたらすことが、当社の企業価値向上につながると私は考えます。

CEOメッセージ

目指すべき価値は、2035年に「当社製品・サービスがなければ『モノを作れない・測れない』絶対的なポジション確立」を実現することです。この測定、この工程だけは東京精密の機械がないと作れない、といわれるような「唯一無二」のポジションに立つこと。それが当社がもたらす価値の完成形だと思っています。

現時点でそのポジションに近い製品のひとつが、高性能プロービングマシン(プローバ)です。半導体製造装置市場は競争が激しく、通常なら価格競争力のある国・地域のメーカーが競争力を高めていきます。しかし、技術障壁の高い製品を持っていれば話は別です。プローバの場合、下はマイナス50℃から上は200℃まで温度が変わり部材が伸縮する環境の中で、プローブ針とウェーハ上のパッド(電極)位置を正確に合わせて通電試験を行う必要があります。また、CPUもGPUもメモリも、微細化に伴い通電時の発熱量が大きくなっており、熱いままでは検査ができないため、熱を速やかに吸収し高い精度で所定の温度に下げる技術が必須です。この点で他者が追い付けない技術を持っているからこそ、高い利益率を享受でき、企業価値へとつながっています。半導体と計測の「融合」を進めてきた成果です。

東京精密グループ長期ビジョン2050



中期経営計画／市況と業績

続く好環境、中計の前倒し達成も

2025年度には、引き続き過去最高の売上高と高水準の営業利益に到達できました。期の前半には中国マーケット拡大の恩恵を受け、期の後半からは欧米系や台湾の顧客の需要が戻ってきたことが主な要因です。生成AI需要に加えコンシューマーデバイスへの需要もようやく回復してきた他、HBM(高帯域幅メモリ)に加え、エッジAI用のASIC(特定用途向け集積回路)やDRAMへの需要も高まっています。特にメモリは、メーカーが作り切れないほど需給がひっ迫しています。

中期経営計画(2025-2027年度)



定量目標(単年度目標)	
売上高	1,850億円 半導体1,400億円 計測450億円
経常利益	450億円
営業利益率	24%
ROE	15%

この流れは、恐らく当面変わらないと見ています。社内では中期経営計画(2025-2027年度)で定めた定量目標の1年前倒し達成の話もしており、市場には実際それだけの勢いはあります。市場環境が整う中で製品に競争力があれば、一気に飛躍できるのがこの業界です。生産人員や生産場所が不足したり、一部部材の調達がひっ迫していたり、中東危機の影響で切削油が手に入りにくくなったりはしていますが、解決は可能でしょう。

デバイスの高性能化に伴って微細化が進み、後工程で一度加工した半導体デバイスを前工程に戻す「中工程」が普及してきているのも追い風です。デバイスを清浄な状態で戻す必要があるため洗浄能力が問われるのですが、当社には前工程用のCMP(化学機械研磨)装置があり、それには研磨後の洗浄機能も備わっています。後工程の機械にCMP装置を

CEOメッセージ

付ければ、洗浄の課題は解決です。この製品の今後には期待しています。

プローバも含め、こうした高性能品への需要は高まっています。中計目標の前倒し達成を実現するためには営業利益率に課題がまだ残りますが、売上における高性能品の比率向上を通じて改善できると思っています。

中期経営計画／目標の進展

飯能工場に新棟建設へ

定性的な目標についても、この1年でさまざまな進展がありました。

「計測・半導体の技術シナジー追求」については、計測の製品を載せた半導体製造装置を幾つかリリースできました。これからリリースする装置もあります。詳細は伏せますが、半導体製造プロセスで使える計測製品がそのひとつです。精密測定機器事業のトップに、半導体製造装置事業出身で半導体の製造プロセスを熟知している人財を据えた効果が早速出ており、これからが楽しみです。

「生産キャパシティ投資」も進みました。先日、飯能工場（埼玉県飯能市）の隣地を購入しており、近く新棟の建設に入ります。チラーなどの生産ラインに加え製品在庫の倉庫機能も持たせて、出荷までのリードタイムを短縮していく考えです。将来的な生産余力を確保する意味合いもあります。



飯能工場

中計で公表している東京都八王子市内の新工場計画は当初想定通り進んでいるものの、条例が定める環境アセスメントなどが必要なため建築・竣工までにはまだ時間が掛かります。もっとも、急拡大する半導体製造装置のニーズに対し、当社の生産能力はひっ迫していますので、会社として、飯能工場の生産能力強化を優先することにしました。

この他最近の特筆すべき事項としては、外部との連携が進みました。旭ダイヤモンド工業株式会社との合弁会社が開発していたダイシングマシンに使用されるハブブレードは、既に製品のサンプル出荷が始まっています。そもそも同社は本来競合他社の位置づけになるのですが、ハブブレードの分野では、互いの商品の長所と短所が真逆です。それで、この分野に限定して共同開発してみてはどうかという話になり、合弁会社を設立して進めたところ、非常に性能の良い商品が開発できました。

株式会社アドバンテストとのダイレベルプローバの共同開発も進んでいます。生成AIを含むHPC（ハイパフォーマンス・コンピューティング）向けの先端パッケージや高性能デバイスの拡大に伴い、ダイレベルでの品質保証や温度を含めた評価ニーズは既に高まりつつあります。その解のひとつとして今後本格普及してくるPLP（パネルレベルパッケージ）は、長方形の基板の上にCPU、GPU、メモリなどのさまざまなデバイスを一括実装する技術で、いずれはチップサイズが100ミリを超えると予想される上に発熱量が大きい。ですから、チップをひとつずつ検査したい、という要望は必ず出て来ます。ダイレベルプローバは、そうなった時に必要な製品です。飯能工場の新棟の一部を生産に使えればと思っています。

新しい試みとしては、大手自動車会社より車載用充電池開発に伴う充放電試験業務を受託しました。通常であれば、当社が販売している充放電試験システムを買っていただいて先方でテストをしてもらうのですが、テストすべき量が非常に多いため、受託サービスを提供する形になりました。試験を通じてお客さまのニーズを直接把握することで、お客さまの先行開発や量産開発のスピード向上、品質改善に寄与できる事業だと思います。

CEOメッセージ

人的資本

人流の垣根を低くし、部門や国内外の枠を取り払う

「シナジー」の話でも少し触れましたが、精密測定機器事業と半導体製造装置事業の垣根がだんだん低くなってきました。事業部門を問わず、それぞれの会議に出席する例も増えており、これからが楽しみです。両部門間の人の異動も、もっと増やしたいと思っています。互いに何をしているのかを知るのも、将来のためには必要でしょう。現在、開発機能はそれぞれの事業部門の傘下にある組織体制となっていますが、枠を取り払ってひとつの開発部にしてもよいかな、と個人的には考えています。

国内外の垣根も低くなってきました。以前の統合報告書CEOメッセージで、海外から管理職を呼び寄せて本社に勤務させる話をしましたが、最近では技術者も海外から連れてきています。装置で使うソフトウェアの開発者などです。ソフトウェア部門で日本人社員と同じ仕事をさせ、ソフトウェアの中身を理解してもらっています。

私が目指しているのは、ソフトウェア開発の現地化です。現地でお客さまの要望を直接現地の言語で受け、要望を満たすソフトウェアを現地で作れる体制を構築したいと思っています。仕組みと人財の育成には何年かは掛かると思いますが、いずれは現地に開発分室のようなものを作りたい考えです。

この他、障がい者雇用のための特例子会社認定取得を2026年度に予定しています。社内の軽作業の他、一部の製造業務も任せています。指導に当たっているのは、かつて当社の製造部門で活躍したベテランです。その人に向いている仕事は何か、ということを、彼らなら良い形で判断できます。得意な仕事を通じて会社に貢献してもらいたいし、働く側にも自分が役に立っているという実感が必要です。その両方を実現でき、当社にとっても良い形になっていると思います。

サクセッションプラン

能力開発への自覚を促し、人財育成を加速

次世代経営層の育成も進めています。新たなリーダーとして活躍が期待される人たちには、取締役会で議案の説明役などを担ってもらい、指名・報酬委員の社外取締役方に人柄を理解してもらえるように取り計っています。この他、年代別にグループリーダーを目指す層から工場長やカンパニー長、社長を目指す層までを分けて育成研修を始めました。自分に何が足りないか、新たに勉強したいことは何か、が分かるようなメニューを組み、能力開発への自覚を促しています。人財確保は喫緊の課題、育成を早めたい考えです。

前にも申し上げましたが、私は従業員が退職するときに「この会社に勤めて良かった。やりたいこともやらせてもらえて、給料も少しは良かった」と思ってもらいたいんです。同じように考えてくれる人に、当社の次代の経営を担っていただきたい。

でも、もしかしたら世の中からは、効率を第一に考えて黒字リストラのような経営の方が求められているのかも知れません。2000年代の世界的な金融危機の際、当社の経営に大きなリスクが生じた結果、大規模なリストラに踏み切らざるを得ない状況となり、その時には私が中心的な役割を任されました。そのようなことに二度とならないようにしたい。

中計最終年度、そして10年後へ

生き残りの条件は「唯一無二」であること

先にも申し上げましたが、中計の定量目標については、1年前倒しでの達成を狙っていきます。そうなると3年目(2027年度)の定量目標を据え置く意義は薄れるので、新しい数値目標を策定する可能性もあります。

ただ、中計の数値目標というのは、当面の指標がないと困るので作っているだけで、企業経営というのは、やはり10年やさらに長い単位で捉えるべきだと考えます。その中で一番大きな目標は、最初に申し上げた「当社製品・サービスがなければ『モノを作れない・測れない』絶対的なポジション確立」を実現することです。進捗はまだ、多少は前進したかな、というところですが。登山で言えば2合目くらいですか。

CEOメッセージ

今の良い事業環境は今後2年くらいは続くでしょうが、如何せん当社は設備産業です。ずっと良い、ということはあり得ません。どこかで、業績が落ちる時は必ず来ます。しかしそれでも、10～15年の期間で均してみれば、トータルでは成長してきました。直近10年だけなら、当社の売上高は3倍近くになっています。

一方、10年後には、業界はもう現在のような過当競争ではなくなり、ある程度絞られた会社しか残れないのではないか、とも予想しています。装置の開発に莫大な開発費が掛かるようになっており、ちょっと良いアイデアがあるから作ってみよう、では通用しなくなってくるからです。

その時に生き残る会社の条件は、最初に申し上げた通り「唯一無二」であることだと思います。だから私はそこを目指しますし、そのために研究開発を常に進めていく必要があると思っています。また、材料メーカーさんとのお付き合いも重要です。半導体製造において、シリコン、ガラス、セラミックスなど、どんな材料が主流になるのかは分かりませんが、平坦化するに当たりどのような条件が適切か、など、材料特有の知見が一番深いのは材料メーカーさんだからです。

余談ですが、私は研究開発は自己資金でやるべきだと思っています。開発は全て成功するようなものではないからです。開発に失敗して負債を返せなくなれば、会社が潰れます。自己資金でやるべきです。そのためには、現預金をある程度手許に置いておく必要があります。当社が現状、キャッシュリッチだとは思いませんが、急なM&A案件への対応用途も含め、ある程度の現預金は持っておくようにしています。




研究開発風景

最後に

2050年にもその先にも継続している企業に

思うに、とにかくいろいろな人間がいる会社が一番良い会社です。賢い人だけではなく、縁の下の力持ちのような人もいたり。リーダーシップも大切ですが、全員がリーダーシップを発揮してしまったら会社がバラバラになってしまいます。

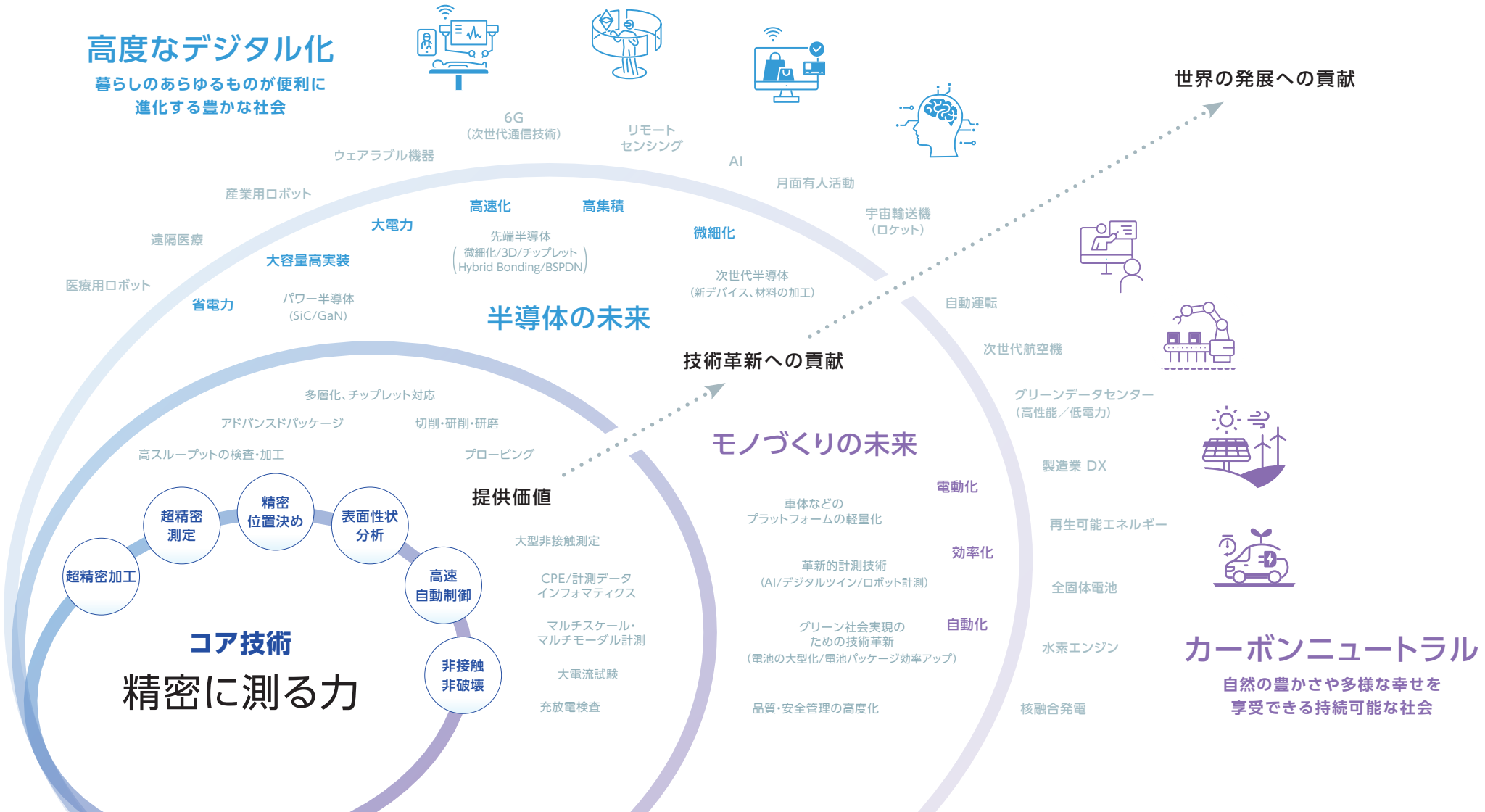
だからなるべく、良いところがそれぞれ異なる人財を集めたいと思っています。営業であれば、ものすごくプレゼンテーションが上手かったり、頼りなく見えるのに何故かお客さまに可愛がられるタイプだったり。こういうところが良いね、と思える人が当社に来てくれたら、とても嬉しいです。そしてその人が何十年後かに辞める時に「ああ、この会社に入って良かったな」と思ってくれたら。そのためには、当社を2050年にもその先にもちゃんと継続している会社にしなければなりません。だから「唯一無二」になりたいと思っています。

もうひとつ。堅実な経営を心掛けたいと思っています。具体的に言えば、ある程度大胆にはやりますが、身の丈を超えるような無茶な投資、リスクの高い投資はしません、ということです。株主・投資家の皆さまには、その点についてはご安心いただき、これからも末永くお付き合いいただければ幸いです。



東京精密が目指す“夢のある未来”

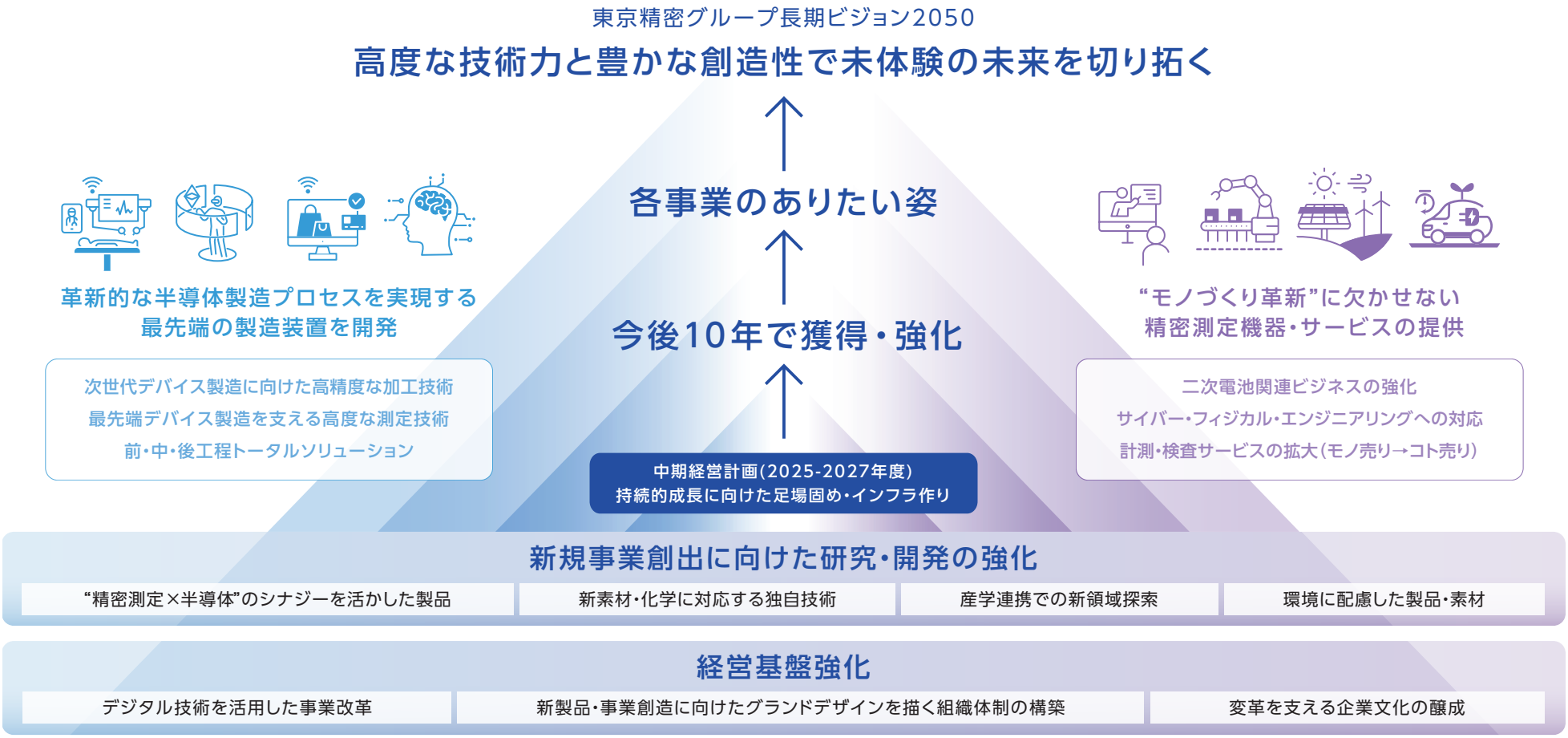
東京精密グループが目指す“夢のある未来”は、暮らしのあらゆるものが便利に進化し、自然の豊かさや多様な幸せを享受できる持続可能で豊かな社会であると考えています。この未来を実現するために、2つの事業領域（半導体製造装置・精密測定機器）のベースとなるコア技術にさらなる磨きをかけ、さらに革新した技術を提供し、半導体とモノづくりの未来の実現に貢献していきます。私たちは世界中のイノベーションをけん引する下支えとなる技術提供を続けていきます。



東京精密グループ長期ビジョン2050

高度な技術力と豊かな創造性で未体験の未来を切り拓く

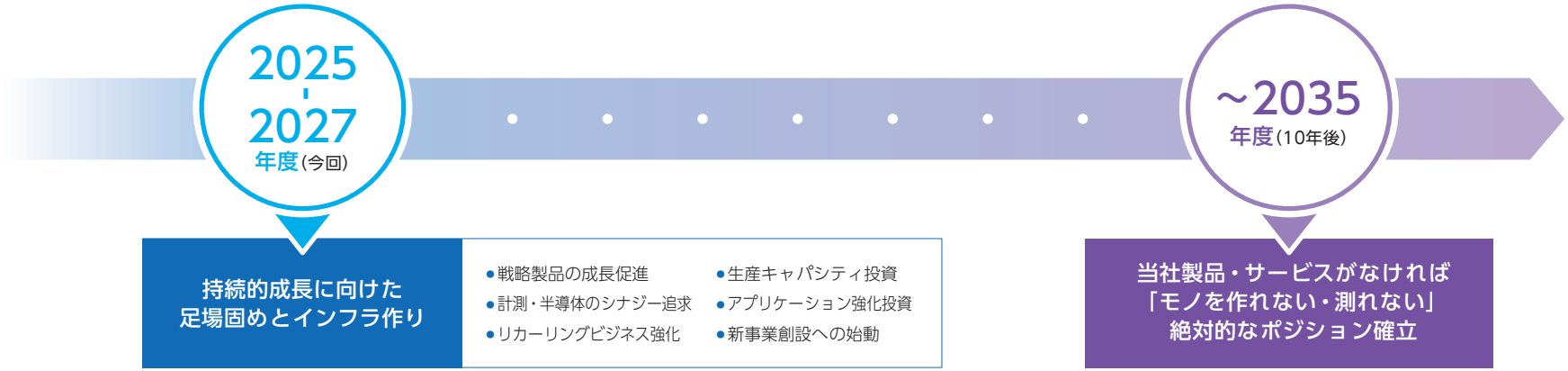
不確実性がかつてなく高い時代において、事業環境の変化に合わせて変わり続けながら成長していくために、東京精密グループのありたい姿であり成長の羅針盤となる「長期ビジョン」を策定しました。ありたい姿を実現するため、将来的にやるべき対応の洗い出しと成長戦略を検討しています。



中期経営計画（2025-2027年度）

持続的成長への基礎作りを経て、「絶対的ポジション」へ

現在の中期経営計画で目指しているのは、長期成長に向けた基盤固めです。生産キャパシティ拡充やアプリケーション強化のための投資に加え、要素技術開発などの技術投資も拡充して業容を拡大。10年後に、当社の製品・サービスがなければ「モノを作れない・測れない」という絶対的なポジションを確立するためのインフラを築きます。



目標

	2024年度実績（中期経営計画開始前年度）	（2025-2027年度）中期経営計画期間いずれかの単年度
売上高	1,505億円 半導体製造装置1,135億円 精密測定機器371億円	1,850億円 半導体製造装置1,400億円 精密測定機器450億円
営業利益	297億円	450億円
営業利益率	20%	24%
ROE	15%	15%

中期経営計画（2025-2027年度）の基本方針

事業強化と事業基盤そのものの強化を両立させる

	戦略製品の成長促進	計測・半導体の技術シナジー追求 →P24	リカーリングビジネス強化
半導体製造装置 →P18	●高付加価値プロービングマシン ●先端グラインダ ●先端ダイシングマシン 等	●精密測定機器をビルトインした新たな半導体製造装置	●サービス/サポートビジネス強化 ●消耗品事業拡大 ●既設装置向け事業機会創出
精密測定機器 →P21	●充放電試験システム ●X線検査装置 等	●計測アプリケーションの半導体エリアへの応用	●受託計測・評価サービス拡充 ●機器校正サービス強化

これらを支える事業基盤の強化

要素技術開発の強化促進 / 新たなチャレンジを促す環境 / サステナビリティマネジメントの進化 / セグメント横断的な事業戦略組織 / ITを活用した生産性向上

2025-2027年度中期経営計画　半導体製造装置事業

急速な技術進化に挑み、高付加価値製品を提供

半導体製造におけるテスト・加工領域での技術進化は著しく、その進化は業界全体に大きな影響を与えています。東京精密グループはこの急速な技術進化に対応するため、最先端の技術要求に応える製品を提供していきます。これによりお客さまに高付加価値をもたらし、競争力のある製品を市場に供給することを目指します。

事業概要

半導体製造装置事業では、ウェーハ上に形成されたチップの電気的特性を試験するプロービングマシン、ウェーハからチップを1個1個分離するダイシングマシン、ウェーハの薄片化や平坦化を行うグラインダなどを提供しています。

半導体デバイスや電子部品の微細化・複雑化が進む中、より詳細に電気的な特性を評価するためのプロービングマシン、より高品質な半導体デバイスの製造に必要なダイシングマシン、グラインダに対する重要性が高まっています。



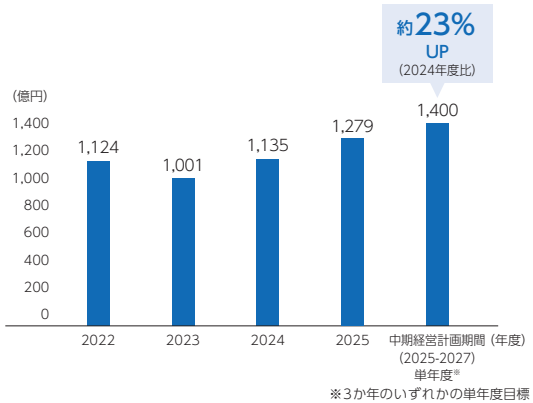
AD3000T-PLUS



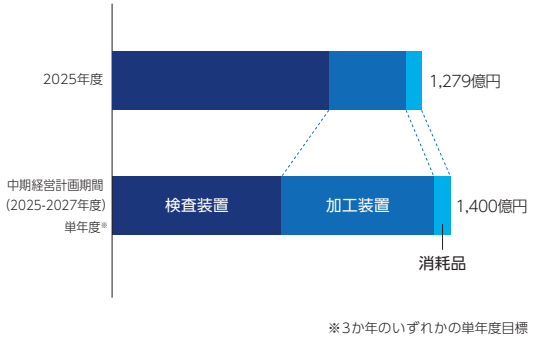
AP3000

売上高目標

半導体市場の成長が進む中、高精度なテスティングを実現するためのプローバに対する高付加価値化の要求が高まっています。また、後工程によるデバイスの革新を実現するため、アドバンスドパッケージング・大型PLP・化合物半導体などの加工に適した高機能な装置の需要も増えています。当社は精密加工技術と精密測定技術を活用し、これらの分野で事業機会を獲得します。一方で新興メーカーの台頭による競争リスクも存在するため、コア技術を基盤に技術的な優位性を高めていきます。



※3か年のいずれかの単年度目標



※3か年のいずれかの単年度目標

売上高

2024年度
1,135億円

2025年度
1,279億円
(2025-2027年度)単年度※
1,400億円
※3か年のいずれかの単年度目標

目標売上高比率

2024年度比
約23% UP

2025-2027年度中期経営計画　半導体製造装置事業



事業環境と業績

半導体市場では、生成AIブームに伴いハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)、高帯域幅メモリ(HBM)関連の最先端品を中心に、極めて強い引き合いが継続している状態です。

こうした環境を追い風に、2025年度の半導体製造装置事業の売上高は1,278億78百万円(前期比12.7%増)と既往ピークを更新しました。

2026年度の需要はさらに強まっています。生成AI/HPCの一強状態で、GPU最大手のみならず、各メーカーが独自製品を市場投入し市場拡大傾向が続く状況です。当社グループへの半導体製造装置の注文も増加しており、2026年度上期の受注高は計画に対し30%増、売上高も同2%増となる見込みです。下期はさらに、受注高が対上期比で44%増と大幅に増える見通しですが、売上高は生産が追い付かず同11%増にとどまる見込みです。当社は製品の内製を基本としていることから急な増産は困難で、現在対策を進めています。

このような活況から、半導体製造装置事業は2年目にして連結の中期経営計画(2025-2027年度)目標を達成できる見通しで、営業利益率も通年では25.7%の見込みで目標を達成できる予定です。

市場変化への予想と対応

半導体製造装置市場の活況は今後もしばらく続く見通しで、中国最大の顧客が来年の大規模注文を伝えてきている他、各メモリメーカーも装置確保のために当社の生産能力を押さえに掛かってきています。加えて、現時点で世代が4～4EにあるHBMが来年に5に移行し始めれば、積層数が増えて技術的な難易度が上がる上に発熱も2～3倍となることから今までのプローバが使えなくなり、新機種に買い替える必要が出てきます。ロジック半導体についても同様で、熱対策と必要テスト数の増加から新たな機種への入れ替えが発生します。

現状、新規需要が集中しているのがプローバで、半導体社の売上の70%以上を占めています。高剛性研削盤(HRG)というタイプのグラインダも競合に比べ高い競争力を保っており、来年、または再来年には出荷数が倍になる見通しです。

こうした状況は当面は止まらないでしょう。中国大手が公表している調達見通しを見ても、2028年までは活況は続きそうです。その頃にはパネルレベルパッケージ(PLP)の普及も始まり、PLP用の製造装置も必要となります。

その後、勢いが継続するか一度落ち込むのかは分かりません。勢いが止まった時には怖いですが、今の需要に対応できなければ、次の需要の山が来た時に「あの時には供給責任に対応し切れなかった」と見なされてしまいます。市況リスクを承知で頑張るしかありません。

既にPLPについては各製品で対応準備を整えており、特にプローバについては先行して大手半導体製造会社に評価機を納めています。CMP装置は、競合が510×500ミリ以上の大型機に力を入れている一方で、我々は大手半導体メーカーが提唱している310ミリに対応した機種を用意しているので、優位性はあります。これら以外にも、高剛性研削盤、ダイシングマシンもPLP対応機種が完成しており、客先評価に対応できる状態にあります。PLPの製造は前工程で大サイズで製作後すぐ切断し、基板を310ミリ以下のサイズにして後の工

2025-2027年度中期経営計画　半導体製造装置事業

程を行うのではないかと我々は見ています。大型の製造・加工装置需要は台数自体は多くはありませんが、1台売れるだけでも単価の関係上、かなり売上金額が上がっていくのではないかと見込んでいます。

設備投資と研究開発

拡大する需要に対応していくために、生産施設2か所の用地を確保しています。ひとつは飯能第2工場（埼玉県飯能市）で、2028年度中には稼働する見通しです。プローバの増産にかなり寄与してくれると期待しています。もともとの構想では在庫用の倉庫も兼ねる予定でしたが、今の状況を考えると全て製造ラインとして使うことになるかも知れません。

もうひとつの八王子西工場（東京都八王子市）の稼働は、2029年か2030年になりそうです。加工機の設置は計画通り行いますが、それ以外についてはフレキシブルに考えています。

ただ、飯能第2工場稼働前に生産能力が不足しますので、引き続き増産の検討を継続していきます。

これらの問題を解決していくためには、工場の在り方自体を変えていくことも必要です。そのために最近社内で、「自動化・省人化」プロジェクトが立ち上がりました。1回目の打ち合わせでは「まずは目先の効率に気を取られて可能性を狭めないよう留意しつつ、どこの工程が自動化可能か、視野を拡げて検討してみてほしい」と話をしています。

いずれにせよ労働人口は減少していきます。いろいろな企業がヒューマノイドの導入を試しており、我々も組み立てについての検討が必要です。当社の製品は顧客ごとに仕様が異なるので、固定設置の多関節ロボットを使った流れ作業では恐らく上手く行かないと考えています。また、倉庫などでのピッキングについても、自動化をはじめとする効率化が求められます。いずれにせよ生産性を向上させ、お客さまの短納期ニーズに応えていく必要があります。

なお、研究開発費については、各グループの売上高の10%以内が目安ですが、ケース・バイ・ケースで10%を超えることも許容しています。黒字を出すために研究開発費を削るのは本末転倒と考えています。

中計最終年度に向けて

中計3年目に向けた戦略はありません、というと語弊がありますが、2年目の2026年中に現中計を達成したいと思いますし、もしそれが実現できるなら、新しい数値目標に設定したいという考えを持っています。もしそうなった場合、新しい数値目標は年内いっぱいくらいで決めることになりますが、装置市場の強い成長が今後も続くことを前提にするなら、半導体製造装置事業だけで2,000億円に近い売上高目標を設定する可能性も十分にあり得ると考えています。

次の中計期間にも、良好な市場環境は続いていく見通しです。業績の中心はプローバ、グラインダとなりますが、次中計達成のためには全装置でさらなる業績アップが必要であると考えています。

2025-2027年度中期経営計画　精密測定機器事業

多様化する計測ニーズに応える技術力強化と事業拡大

多様化・拡大化する計測ニーズに対し、東京精密グループは汎用計測製品(座標・形状測定機)や自動計測製品(マシンコントロール測定コンポーネント)、充放電試験システム、X線CT装置などによる計測ソリューションを積極的に活用し、幅広いニーズに対応します。これにより計測分野での競争力を高め、事業拡大を図ります。

事業概要

精密測定機器事業では、物体の寸法を測定する三次元座標測定機、表面・円筒形状の誤差などを正確に算出する表面粗さ・輪郭形状測定機、工作機械内部で計測を行うマシンコントロールゲージ、バッテリーなどの二次電池の試験を行う充放電試験システムなどを提供しています。

モノづくりにおいて正しく設計通りに作られるかを確認するために、精密測定機器は欠かせません。最近ではカーボンニュートラルに向けたNEV(新エネルギー車)普及による新たな精密測定のニーズが高まる中、自動化への需要も高まっています。



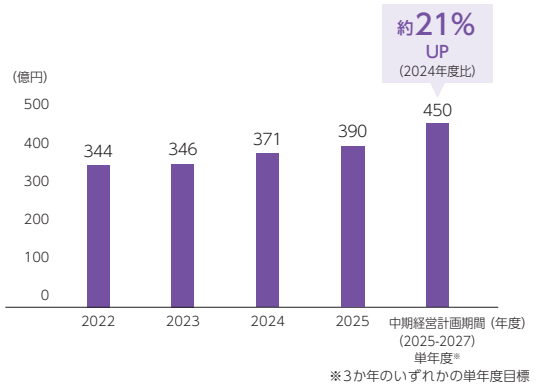
SURFCOM NEX

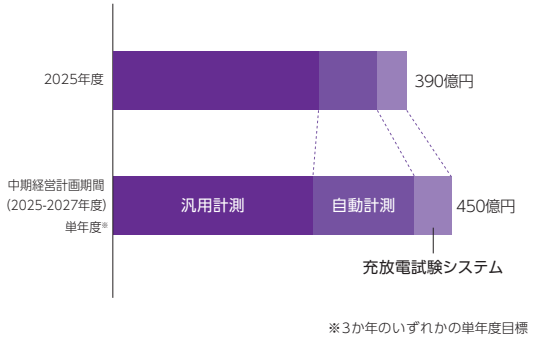


PULCOM W10

売上高目標

前回の中期経営計画策定時は、内燃機関自動車向け需要が過半を占め、業界ごとの成長・成熟エリアが明確であったため、それに基づく戦略を策定していました。しかし現在は、内燃機関向けの売上高構成比が約4割に低下し、測定ニーズも多様化しています。これに対応し、製品や業界を区分せず、当社が提供するソリューションを拡大する戦略を採っています。汎用計測製品(座標・形状測定機)、自動計測製品(マシンコントロール測定コンポーネント)、充放電試験システムに加え、内製化を始めたX線CT装置を用いて多様なニーズに応え、事業の拡大を目指します。





売上高

2024年度
371億円

2025年度
390億円
(2025-2027年度)単年度※
450億円
※3か年のいずれかの単年度目標

目標売上高比率

2024年度比
約21% UP

2025-2027年度中期経営計画　精密測定機器事業



市況と業績

2025年度以降、中国や欧州で電気自動車（EV）普及の勢いが弱まる一方で、ハイブリッド車（HV）やプラグインハイブリッド車（PHEV）向けを中心に、エンジン関連の測定機器需要が堅調に推移しています。また、二次電池関連の事業機会も変わらず拡大しています。

半導体関連では、2025年度後半からサーバラックや冷却システム、冷却用配管、コールドプレート（冷却板）などのデータセンター向け機器をはじめ、関連した大型非常発電機の需要が急拡大しており、そのモノづくり促進および高精度化に呼応し、ハイエンド型の汎用計測製品ならびに自動計測製品への需要も高まっているところです。

こうした市況を受け、精密測定機器事業の2025年度の業績は、売上高が389億60百万円（前期比5.1%増）と当初予想を上回り、既往ピークを更新しました。HV／PHEVの人気に伴うエンジン分野の堅調さに加え、二次電池市場の拡大を背景に、着実にビジネスを伸ばした結果です。2026年度には二次電池の充放電試験事業の受託評価ビジネスが拡大しつつある他、計測機器については半導体材料メーカーやデバイスメーカーからの引き合いも増えています。

成長戦略

近年、自動車に搭載するセンサは増加の一途を辿り、データセンター向け部材の需要も拡大しています。これらをはじめとした半導体分野の製造に伴う測定ニーズの取り込みを行い、お客さまの声をひとつでも多く具現化していく必要性を感じています。そのきっかけづくりとして、昨年より半導体分野向け計測ソリューション事例集を作成し公開しました。計測社の各種計測機器で半導体プロセス中の表面性状や基板、微細構造などを測定したデータをまとめたもので、取引先やお客さまから高評価を得ることができました。現在は第2弾を作成中です。半導体メーカーや部材メーカーなどに、このように測ればこうしたデータが取れる、ということを認知いただくとともに、先方からこういうデータが測れないか・観られないか、という“困りごと”を引き出し、双方向のキャッチボールの中でシーズ・ニーズをキャッチアップして次の開発テーマにつなげたいと思っています。

半導体社との“融合”も進展しています。既にプロービングマシンやダイシングマシンに計測社の測定機器を組み込んだものを市場投入しており、他にもエッジグラインダ（ウェーハ面取り装置）向けをはじめとした他製品群の評価検証を進めているところです。ただ単に半導体社の半導体製造装置に、計測社の機器を積めばよいわけではありません。

計測を組み込んだ半導体製造装置として現状市場の優位性を高めていくことは「フェーズ0」に相当、つまり第一段階の目的です。次の段階として、現状では測れないものを測れる新たなセンサを開発して半導体製造装置に搭載していく「フェーズ1」、さらに広範なシーズ・ニーズに刺さるよう製造装置を磨き上げていく「フェーズ2」へと発展させていく、というのが、私たちが描いている計画です。その実現にはお客さまとのキャッチボールが必要で、先に説明した事例集はその手段の一つとなります。

二次電池の充放電試験システムも、今後の成長が見込める製品です。機器の販売だけで

2025-2027年度中期経営計画　精密測定機器事業

なく、評価試験の受託というサービス事業も新たなビジネスとして確立しつつあり、そのために福島県と愛知県に、2か所の受託専用の評価センターを組織として独立させました。主要顧客である自動車メーカーやバッテリーメーカーに対し、求められる評価パラメータを正確かつ安全に測れる測定環境を提供していきます。開発した製品の評価段階では受託サービスをご利用いただき、量産段階で機器をご購入いただく、という流れを想定しています。

航空・宇宙・防衛も成長が見込める分野です。ご存じのように航空機やロケット、防衛関連は非常に精密な機械であり、高効率化(省エネルギー)・低騒音化などの要求により、さらなる高精度かつ複雑形状の測定が求められています。

IT革命以来の「軽薄短小」の流れから「重厚長大」の流れに沿った工作物が増加しているように見受けられます。これは航空・宇宙・防衛関連にとどまらず、先ほど触れたデータセンターでも、非常発電用のディーゼル発電機やガスタービン発電機のような大きなモノを測定する機会が増加しています。また、測定室に移動させることなく現場で測れるような計測装置を求める声も聞こえてきており、こうした部分においても対応が必要だと思っています。

将来を見据えて

もうひとつ、今後のキーワードとなるのが「自動化・省人化」です。工場へのロボット導入が最近話題となっていますが、工作機械とロボット、そして計測機器とのインテグレーションというのが、まさしく今進みつつあります。夜半、人が帰った後でロボットが仕掛品を搬送して計測装置に掛け、翌朝になって人が出勤してきた時にはその結果レポートが出力されている、というイメージでしょうか。

現実問題として、これから労働人口は確実に減少していきます。呼応して、計測機器も工作機械も、工場そのものも変わっていかざるを得ません。そこで当社グループでも最近、新たに「自動化・省人化プロジェクト」を立ち上げました。私が責任者で、サブは半導体社カンパニー長の伯耆田。その下に各工場の工場長を配置し、各工場が抱える悩みを抽出し、現実的な形で自動化を推進していきます。

全自動化、といえば話としては美しいのですが、実際には既存の工場の全自動化というのは現実的ではありません。新しい設備建屋は自動化、既存工場は省人化、といった使い分けが必要です。まずはプロジェクトを通じ、既存工場の現状や必要なことを洗い出し、人はどう働くべきか、を考える。人でなければ駄目なところと自動化できるところを峻別し、本当に人が必要なところにまとめてマンパワーを投入する。その上で無人化や省人化を進める。

一定の結論が出るまで3年くらいは掛かると思いますが、将来増産投資を行う際に必要となるので頑張りたいと思います。

中計最終年度に向けて

中計最終年度の2027年度には、売上高450億円を達成したいと思っています。2026年度で410億円前後を狙える環境にあると思うので、2027年度にさらに40億円を積み増すイメージです。ポイントとなるのは海外でしょう。計測社は国内の販売力に比べ、海外は販売チャンネルを含めてまだまだ乏しい、というのが正直なところです。市場規模としては国内が3とすれば海外が7はありますので、拡大の余地はあります。

打ち手としては2つ考えており、ひとつは半導体分野顧客への半導体社との合同営業です。既に国内では行っているもので、顧客と付き合いがありドアをノックできる人間と一緒に動けば効率が上がります。もうひとつは海外工作機械メーカーなどへの認知拡大。および弊社現地法人と連携したグローバル拡販プロジェクト組織を軌道に乗せ、着実に結果を積み上げていきたいところです。

最終年度に向けた施策を確実に実行し、次の3か年を見据え、それにつながるよう、今からその準備と道筋をしっかりと築き上げます。

セグメントを超えた融合的な事業戦略

半導体が進化する限り、新しいモノづくりは止まらない

東京精密グループが進める「精密測定機器事業と半導体製造装置事業の融合」。その先駆けとなったのが、ダイシングマシン「AD3000T-PLUS Opt-scope Built in」(AD)と、プロービングマシン「AP3000-Opt/Ales」(AP)です。これらの開発に携わった4人に、これまでの苦労や今後の展望を聞きました。



半導体社
ダイサシステムグループ
グループリーダー
鎌田 真治

半導体社
プローバシステムグループ
グループリーダー
井口 靖仁

計測社
開発部主査
川田 善之

計測社
Surface Form & Gaugeグループ
グループリーダー
増田 光

AD3000T-PLUS
Opt-scope Built in

ウェーハ上に形成された多数のICなどを個別のチップに切り出す装置。省スペース性と高メンテナンス性が特徴。Opt-scopeの搭載により、従来機種では不可能だった断面形状の測定を実現。



AP3000-Opt/Ales

ウェーハ上に形成されたICなどの電気的特性検査に用いる、ウェーハ搬送位置決め装置。高精度、ハイスループット、低振動、静粛を高水準で達成。Opt-scopeの搭載により、従来機種では不可能だった針跡の深さ測定をナノオーダーレベルで実現。



Opt-scope

非接触三次元表面粗さ・形状測定機。光の「干渉※」を利用し、非接触で部品の表面粗さや微細な形状を、ナノメートル単位で素早く測定。



※複数の光の波が重なり合った際、相互に強め合ったり弱め合ったりする現象。対象物に光を当てて干渉が起こった位置を測れば、対象物の三次元形状を非接触で測定できる。

達成できたこと

鎌田▶ 従来のダイシングマシンでは顕微鏡で切断位置の表面観察を行うことはできますが、その深さや形状を正確に見ることはできません。デバイスの構造はどんどん複雑化していて、切断品位や生産性の維持・向上のためには、加工中の切断状態を高精度で認識することが重要です。従来ですと、高精度に切断状態を確認するには別の装置での検査が必要でした。しかし、Opt-scopeがあれば、ダイシングマシン上で深さや形状を正確に測定して適切なタイミングで加工深さの補正やブレード先端の形状調整もできるため、高い切断品位を維持することが可能です。レーザアブレーション装置でも、グルービング後の溝形状を正確に把握することができます。お客さまからは、便利で効率が良いと好評です。

井口▶ プロービングマシン(プローバ)とは、ウェーハ上に形成されたチップの電気的特性を試験するための、ウェーハ搬送位置決め装置です。プローブカードと呼ばれるウェーハ検査用のプローブ針をウェーハ上の微細な電極パッドと正確に接触させて電気的特性を測定し、チップの良品、不良品を選別します。検査を行うと電極パッドに針跡が付くのですが、稀にプローブ針が曲がっていたりして電極パッドの端エッジ部に針跡がついてしまうことがあり、そうなるとプローバに搭載された光学カメラでの針跡検査では、針跡位置、深さ方向までは見えません。AP3000に搭載したOpt-scopeであれば、ナノメートル単位で立体的に観測でき、チップ内のどの電極パッドに針跡異常があるのかを全て針跡測定データとして残すこともできます。トレーサビリティが確保できるので、品質管理上非常に有効です。

セグメントを超えた融合的な事業戦略

増田▶ 従来は、オペレーターの方が顕微鏡などで見てチェックをしていたんです。そうなると測定データが残らない。トレーサビリティ面で問題があります。また、労働人口が今後減ることを考えると、人がいなくても検査ができるようにしたい、というニーズがお客さまにあります。APは、そうしたニーズに対応するために作りました。



井口▶ ポイントは「自動化」です。Opt-scopeをAPに搭載すれば、APが持っている情報との組み合わせで従来は手動だった位置合わせを自動化できる他、電極の異常に関する情報も使え、さらにそれらの情報を全工程で共有できます。

問題認識と解決

鎌田▶ ダイシングマシンとOpt-scopeの「融合」を考え始めたのは結構古い話です。加工機と計測機器は親和性が高いこともあって、先に話したような使い方ができるのでは、という議論を水面下でしながら進めました。社内に良い測定技術があるのに活かせているのか、という思いも以前からあり、それで計測社と半導体社で集まって勉強や意見交換をする中で、Opt-scopeを使ってダイシングマシン上で断面形状を正確に測定できたら、わざわざ別に検査をせずに済むので問題解決じゃないか、と。それが開発のスタートです。



井口▶ プローバの方は何年か前にお客さまを訪問した際、こういう形で検査ができたらいいね、という話を聞いたのがきっかけです。当時お客さまの工場では、針跡検査オペレーターの方が何名かでウェーハの抜き取り検査を行い、指定されたチップにある何百か所かの電極パッド内の針跡を延々と顕微鏡で目視チェックしていたんです。目を使い過ぎるので視界がぼやけてきて誤判断も生じる。個人のスキルへの依存度が高い。自動化して定量的に判断できるようにできないか、というのがお客さまの要望でした。



増田▶ ただ、ADには最終的には、Opt-scopeのハードウェアそのものは積みませんでした。光の「干渉」を起こす部分と、それを解析するソフトウェアだけです。他の部分は、ADにもともと付いていた検査装置を使いました。求められる測定精度がミクロンオーダーなので、コストを考えれば十分です。

川田▶ 逆にAPのようなプローバの場合、ナノメートル単位の測定精度が求められるため、高精度なOpt-scope全体をそのまま載せる必要がありました。ただ、APの上に載せると床の振動を拾ってしまい、Opt-scopeとウェーハの相対距離がわずかに変わり誤差が出る。工場の床はあまり硬くないので、近くを人が歩くだけで装置が揺れてしまうんです。最終的には、APの下に空気ばねのような「除振台」を敷いて解決しました。

今後の展開

鎌田▶ ここからが勝負です。こういうダイシングマシンが1機種できました、で終わってはいけない。計測社との交流を深めてシナジーを強化し、Opt-scopeに限らない新しい計測技術を取り入れていく必要があります。互いに対する知識・認識のレベルは上がってきているので、心強いです。

井口▶ プローバの場合はお客さまから、Opt-scopeの搭載を前提とした機能追加要望がユーザーごとに出てくることが予想されるため、別途個別対応が必要になると考えています。特にスループットの改善。針跡検査の時間は、お客さまにとってはウェーハテストを行っていないテスト不稼働時間となります。現状のままで良い、とは間違いなく言われない。継続してスループット改善は必要だと感じており、これを進めます。

増田▶ 半導体が進化する限り、我々の新しいモノづくりは止まりません。Opt-scope自体についても、測定速度の改善に加え、撮影範囲を拡大しても分解能が落ちない高性能レンズの導入なども視野に入れています。

川田▶ 大学との共同研究も進めていますので、そちらでの研究成果も順次、新たな機能として追加し、日進月歩で進化する半導体業界での課題解決に貢献していきたいと思っています。



CFOメッセージ



“本業の稼ぐ力”を高め、営業利益率の向上へ

執行役員常務CFO
小泉 公人

事業環境と業績

まず、2025年度以降の当社グループをめぐる事業環境についてお話します。生成AIやハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）関連の需要が引き続き強い拡大基調にある一方、衰えを見せない中国需要やメモリ不足などAI以外の需要回復要因もあり、半導体製造装置事業を取り巻く事業環境は非常に好ましい状況にあります。精密測定機器事業についても、工作機械需要の回復が計測機器需要にも波及してくることが期待される他、航空・宇宙・防衛や半導体向けの需要も拡大しつつあり、事業環境は改善してきました。

このような状況の中、当社グループの2025年度の業績は、売上高が1,668億円と既往ピークを更新し、営業利益は337億円と既往2番目の水準になりました。半導体製造装置事業の伸びが全社業績をけん引したことが主な理由です。第2四半期に特別損失を計上したにもかかわらず、当期純利益は土地売却の特別利益を計上した前年度とほぼ同じ水準に達しました。当初の想定よりも売上高、営業利益ともに上振れしており、中期経営計画初年度としては順調な滑り出しになったとポジティブに評価しています。

利益率も、2025年度第4四半期から改善の兆しが見えます。AIやHPC向け先端デバイスの検査に使われる、高付加価値プロービングマシン（プローバ）の対売上高比率が高まったことによるものです。

2026年度からはハイブリッド・ボンディング用グラインダの受注も加わる他、消耗品など利益率の高いリカーリングビジネスの売上増も見込むため、粗利率のさらなる改善を期待しています。但し、輸出規制や一部買い占めなどの影響による部材費や外注費の高騰はリスク要因として慎重に見ていく必要があります。

	売上高	営業利益	営業利益率	ROE
2025年度実績	1,668億円 半導体製造装置1,279億円 精密測定機器390億円	337億円 半導体製造装置284億円 精密測定機器53億円	20.2% 半導体製造装置22.2% 精密測定機器13.7%	13.5%
中期経営計画期間（2025-2027年度）単年度	1,850億円 半導体製造装置1,400億円 精密測定機器450億円	450億円	24%	15%

財務の方向性

財務面における本中計のゴールは、営業利益率の向上により、1,850億円の売上で450億円の営業利益を達成することです。プローバなどの高付加価値製品の対売上高比率向上の他、充放電試験システムビジネスの黒字化と精密測定機器事業全体の利益率改善、リカーリングビジネスの拡大などが主な施策となります。

バランスシートについては、借方側は売上増・戦略在庫積み増しによる運転資本の増加、設備投資による固定資産の増加、現預金水準の維持という流れを想定しています。事業機会の逸失を避けるために戦略在庫の拡充が必要な状況ですが、全体のバランスを見ながら管理していきたいと思います。

一方、貸方は当期純利益の拡大に伴い純資産が積み上がり、一方で借入金は減少していく見通しです。自己資本比率は70%程度を目安としています。

半導体業界は技術革新のスピードが速く、何よりも研究開発を優先して技術競争力を保持せねばなりません。市場の拡大に伴い、求められる供給能力も高くなっています。たとえ今後、市場が低迷期に入っても、研究開発・供給責任・戦略投資を止めないことが重要であり、そのためには強固な財務基盤が必要です。そういう意味で、自己資本比率70%は決して保守的ではなく、事業継続と成長投資を両立するために必要なレジリエンスの水準だと考えています。

CFOメッセージ

ROEとROIC

前述のように、本中計で重視しているのは営業利益率の向上です。その結果として、ROEを高めていくことになります。そうした意味からも、ROEを純利益率、総資産回転率、財務レバレッジの3つに分解した際に最も重視するのは純利益率です。現在進めている粗利率・営業利益率の改善に直結しており、かつ技術力に基づく製品優位性や付加価値といった"本業の稼ぐ力"を最も反映するものだからです。

本中計のROE目標は15%となっていますが、前中計終了時と同じ水準であり、最低限やらねばならないこと、という認識です。株主資本コストについては、昨今の金利上昇や半導体産業のボラティリティを踏まえ、11%台後半を想定しています。

一方、ROIC(投下資本利益率)については、2023年度以降、事業別ROIC実績の評価と想定されるWACC(加重平均資本コスト)との比較を行い、事業セグメントごとにWACCを上回るROICが創出されていることを確認しています。利益率の向上は全社的に課題として共有認識されており、ROICの改善に結び付けていきます。

キャピタル・アロケーション

今回から、キャピタル・アロケーションの概略図を掲載することとしました。図にもありますが、原資となるのは事業から生まれる営業キャッシュ・フローで、3年の累計額で850億～900億円を想定しています。現時点では他人資本を使う予定はありませんが、M&Aなど計画外の投資案件が発生した場合や、顧客からの納期要求に対応するため戦略在庫を大きく積み増す場合には改めて検討します。キャッシュの使途は、設備投資が4割強、株主還元が4割、借入金返済が2割弱というイメージです。

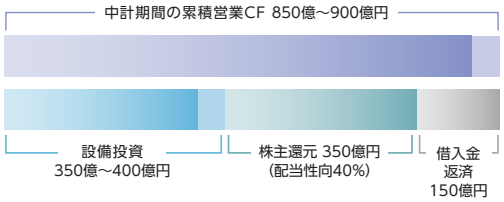
設備投資については、中長期的成長に向けた半導体の生産キャパシティ拡充を中心に、毎期百数十億円の投資を継続的に行っていきます。具体的には、飯能工場(埼玉県飯能市)の近隣地に倉庫を兼ねた工場の建設を計画しているほか、八王子西地区に大型装置の生産を行う工場の建設を予定しています。海外には、お客さまの技術要求を現地でサポートするためのデモ/アプリケーションセンターを海外の主要拠点に設置していきます。現在韓国にデモセンターを建設中です。

株主還元については、連結配当性向40%を目安とするという中計方針に変わりはありません。同業他社と比べても遜色のない水準だと考えます。一方、自己株買いはあくまで機動的に用いる補助的な還元手段と認識しており、開発や設備投資の進捗状況、キャッシュの状況などを踏まえて随時検討していきます。

借入金については、本中計期間中にほぼ返済が終了する見通しです。今後の資金の使途としては、戦略在庫を中心に運転資金に使う分が増えていくと予想しています。

なお、キャッシュ・アロケーションの範疇ではありませんが、研究開発費については対売上高比で8%弱、3年累計で350億～400億円という当初方針を維持しています。競争力の源泉となる要素技術の開発、既存製品の性能向上、オプション開発などが主な使途です。

2025年度～2027年度　キャピタル・アロケーション概略図



格付政策

当社に対する信用格付けは、昨年12月に格付投資情報センター(R&I)からの格付けが「A−」から「A」に引き上げられました。生成AI/HPC関連の高付加価値製品の需要増により収益基盤の拡充が図られていることが評価されたものと認識しています。先にも述べましたが、事業継続と成長投資を両立するための財務基盤の強化が主目的であり、格付けはあくまでもその結果という認識です。

最後に

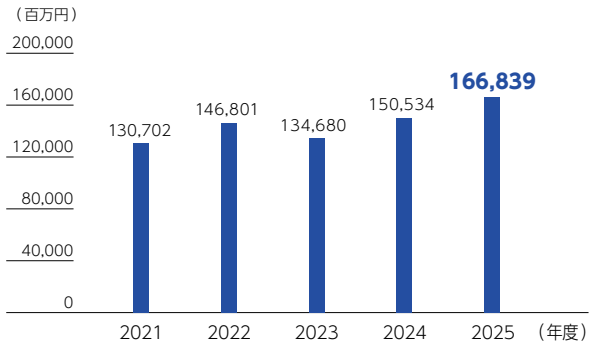
2025年度以降、これまで全くコンタクトがなかった投資家からの面談依頼が増えました。当社に関心を持つ投資家が増えている、という印象です。初面談の投資家であっても、当社の事業や製品についての基本情報は既にインプット済で、いきなり具体的な質疑応答に移るケースも多く、我々としても緊張感をもって対応しています。

当社グループは高いシェアと技術競争力を持つプローバ、高精度なパッケージングに必要なグラインダを中核として、成長への大きな潜在力を有する企業です。今後は、計測と半導体の技術シナジーの創出を通じてさらなる付加価値を生み出し、企業価値のより一層の向上を目指していきます。皆さまには、変わらぬご支援を賜りますようお願いいたします。

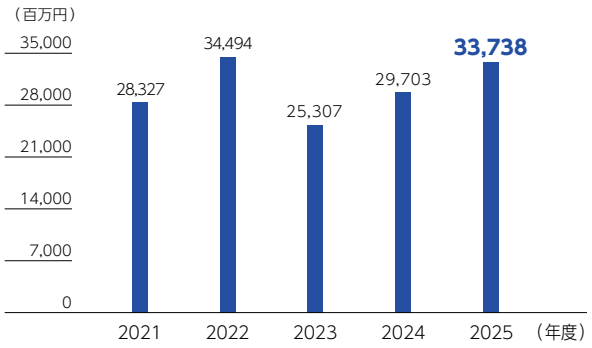
財務/非財務ハイライト

財務

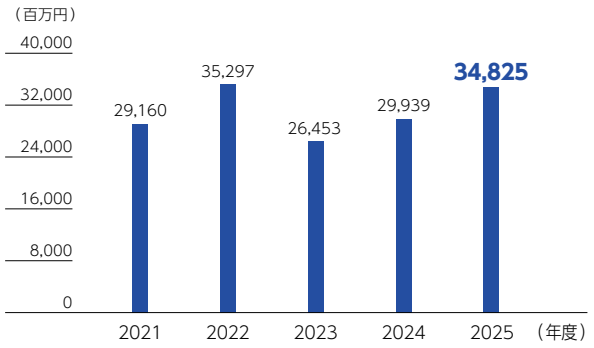
売上高



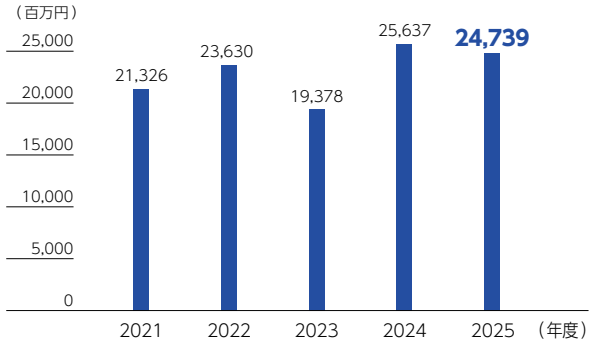
営業利益



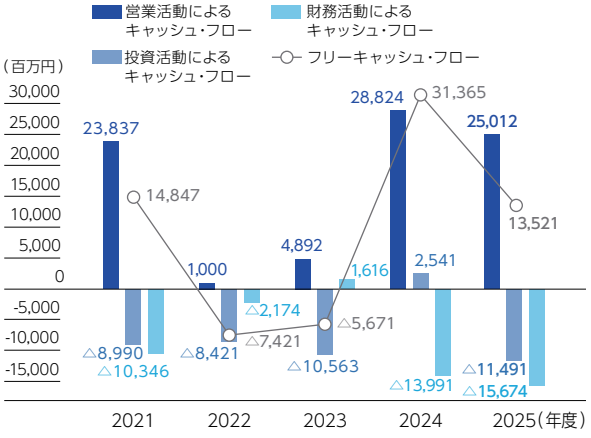
経常利益



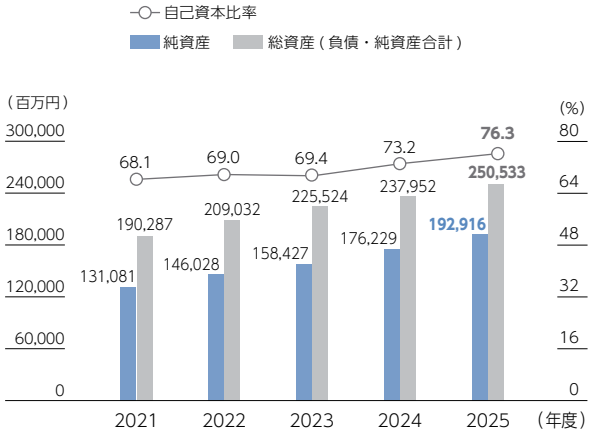
純利益（親会社株主に帰属する当期純利益）



キャッシュ・フロー



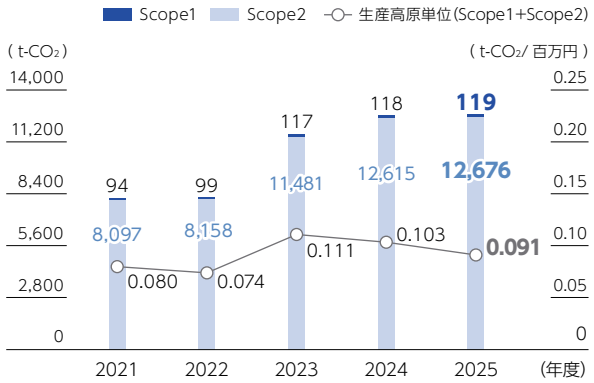
貸借対照表



財務/非財務ハイライト

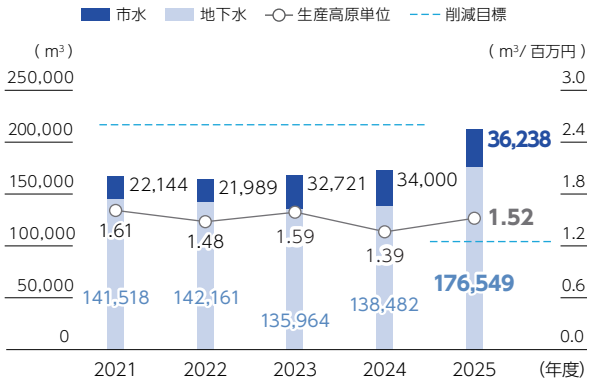
非財務

CO₂排出量



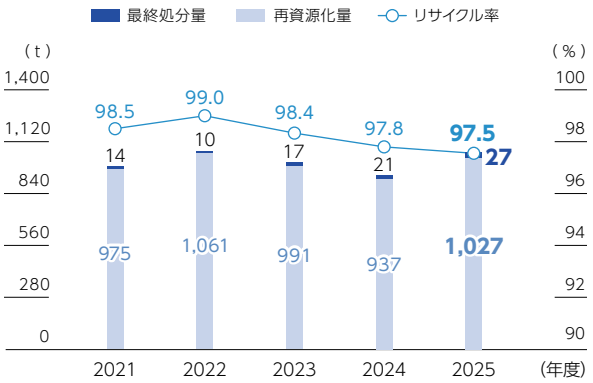
対象範囲：(株)東京精密(単体)　生産拠点
(株)東京精密(単体・連結子会社)のデータは2024年度より集計し、当社サステナビリティサイトで掲載
サステナビリティ　https://www.accretech.com/jp/sustainability/index.html

取水量



対象範囲：(株)東京精密(単体)　生産拠点
(株)東京精密(単体・連結子会社)のデータは2024年度より集計し、当社サステナビリティサイトで掲載
サステナビリティ　https://www.accretech.com/jp/sustainability/index.html

廃棄物量とリサイクル率



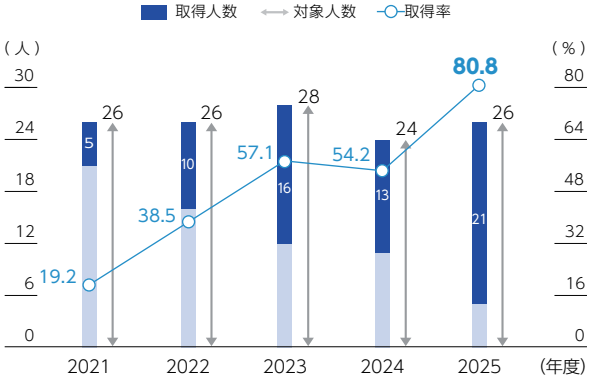
対象範囲：(株)東京精密(単体)　生産拠点

女性正社員・女性管理職比率

	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
管理職女性比率	1.9%	2.4%	2.1%	2.6%	**2.9%**
役員女性比率	7.7%	15.4%	16.7%	16.7%	**30.0%**
正社員採用者に占める女性割合	17.0%	18.3%	22.1%	21.9%	**16.9%**
正社員に占める女性割合	7.4%	8.5%	10.2%	11.3%	**11.7%**

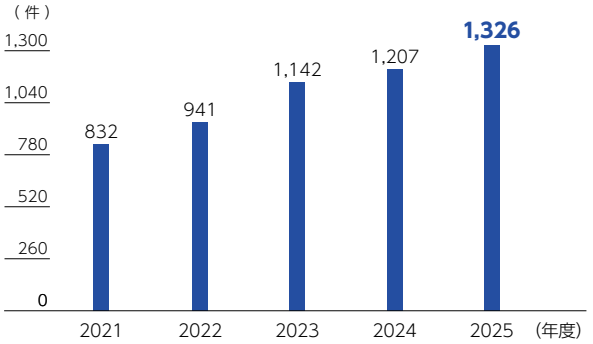
対象範囲：(株)東京精密(単体)　在籍者に占める割合です。

男性育児休業取得率



対象範囲：(株)東京精密(単体)

特許保有件数



※特許保有件数は各年の12月末日で判定した件数を示しています。

価値創造プロセス

東京精密グループには、「技術を突き詰め、技術革新を成し遂げる土壌」が脈々と受け継がれ、コア技術を源泉とした6つの要素技術として結実しています。
コア技術と当社の3つの強みによる相乗効果によってビジネスの成長を推進し、当社グループのビジネスモデルが今後も進化し続けることで、
「暮らしのあらゆるものが便利に進化する豊かな社会」と「自然の豊かさや多様な幸せを享受できる持続可能な社会」の実現につながると考えています。

INPUT*1

財務資本
・株主資本：1,828億円
・格付け：A（R&I）
・ROE：13.5%

製造資本
・累計設備投資額：874億円*2
・売上高設備投資比率：7.4%*2
・生産拠点：5か国・地域/12か所
・販売・サービス拠点：
　国内61拠点
　海外18か国・地域59拠点

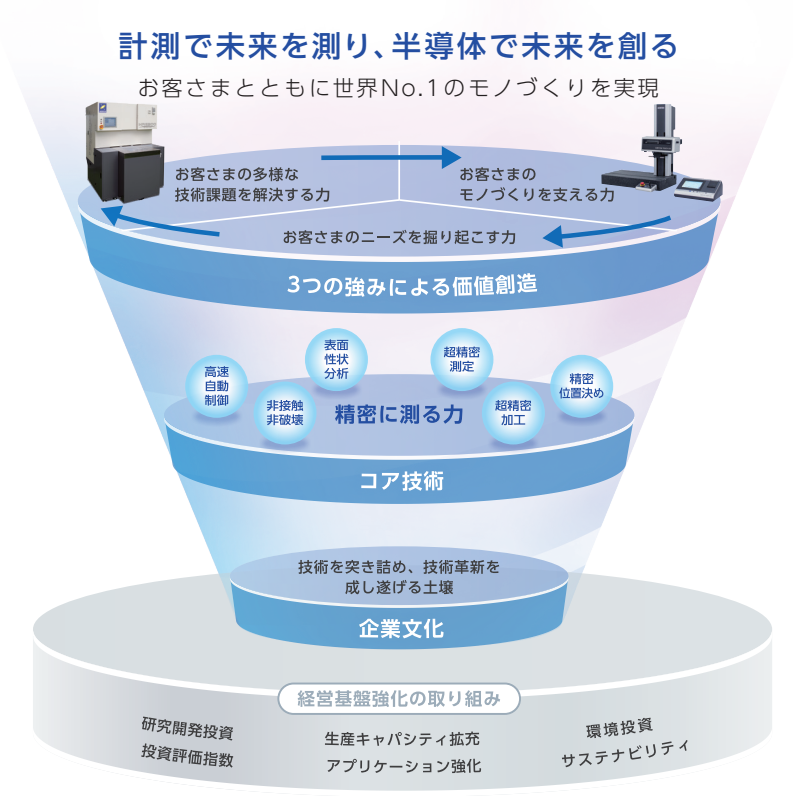
知的資本
・累計研究開発費：850億円*2
・特許数：1,326件（2025年12月末日）
・グループリーダー制
・技術伝承プロジェクト

人的資本
・連結正社員数：2,890名
　うちエンジニア：1,603名
　うち製造部門：766名
・エンジニアが挑戦できるカルチャー

社会関係資本
・お客さまと結ぶ強固な信頼関係と提案力
・トップレベル企業とのアライアンス
・顧客満足度

自然資本
・エネルギー使用量合計：389,812GJ*3
・水使用量：212,787m³
　エコファクトリー、エコプロダクツの推進

PURPOSE



OUTPUT

経済的価値の創出（2025年度実績）

ROE	3年平均14.0%*4
売上高	1,668億円 半導体製造装置　1,279億円 精密測定機器　390億円
営業利益	337億円
株主還元	配当性向　43.2%

ESG重要課題の取り組み

持続可能な社会づくりに貢献する
事業活動の推進

ステークホルダーの信用・信頼に応える
企業姿勢の維持・強化

多様な人々が前向きに活々と働ける
職場環境の醸成

公正な企業活動の基盤となる
ガバナンスの強化

OUTCOME

暮らしのあらゆるものが便利に進化する豊かな社会

スマートファクトリー



手術ロボット、遠隔医療



メタバース



自然の豊かさや多様な幸せを享受できる持続可能な社会

電気自動車



エコロジーと効率を両立した発電



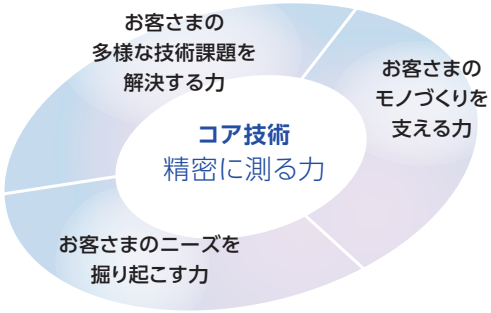
持続的な成長

*1 2025年度実績　*2 10年間の累積値　*3 （株）東京精密（単体）生産拠点。2025年度より、改正（2023年4月施行）省エネ法の換算係数（8.64 GJ/千kWh）を適用
*4 3年平均ROE＝親株主に帰属する当期純利益（2023-2025年度単純平均）÷自己資本（2023-2025年度単純平均）で算出

東京精密のビジネスモデル

コア技術×3つの強み×徹底したお客さま目線

東京精密グループは「精密位置決め」「超精密測定」「超精密加工」など「測る」に関わる独自の技術により、お客さまのモノづくりを支えています。
お客さまの側で声を聞き、未解決のニーズ・シーズを深掘りし、経験豊富なエンジニアたちの知恵と経験を結集してきた結果、
数々の革新的なソリューションを提供しています。技術への飽くなき探究心と徹底したお客さま志向で、モノづくりに変革をもたらします。



東京精密のコア技術



当社製品はコア技術である「精密に測る力」を源泉とする、各種要素技術により構成されています。

精密に測ることで、位置決めや超精密加工、高速自動制御のためのフィードバックを実現。さらに進化した超精密測定へと領域を拡げ、非接触・非破壊で対応する要素技術にまでフィールドを拡げつつあります。

また、計測データから対象物の性状を合否識別するアルゴリズムなど、ソフトウェア面の要素技術にも注力しています。

東京精密の3つの強み

強み1　お客さまのニーズを掘り起こす力

お客さまとの強い信頼関係のもと多様なニーズを早期に把握

差別化ポイント

- お客さまの多様な要望をキャッチする力
  - ▶技術・製造・営業・カスタマーエンジニア（CE）が一体となってお客さまニーズを把握する体制
- 幅広いお客さまニーズを形にするソリューション力
  - ▶グループリーダー制のもと技術者が中心となりマーケティング・企画

強み2　お客さまの多様な技術課題を解決する力

お客さまの視点やニーズを元に、独創的な技術開発力で革新的な機能を創出

差別化ポイント

- エンジニアが新しいことにチャレンジできるカルチャー
- 難易度の高い機能要件を実現できる経験豊富なエンジニア
- 匠の技術を継承し技を標準化
- 電気制御技術、設計手法などに組織横断で横串を通す標準化委員会

強み3　お客さまのモノづくりを支える力

高い技術力で、お客さまの生産能力の最適化と最大化をサポート

差別化ポイント

- カスタマーエンジニアとお客さまの深い信頼関係
- お客さま固有の要求に応え、装置パフォーマンスの最大化を支援
- 素早いレスポンス、お客さま第一のサポート体制
- 優秀なカスタマーエンジニアの育成と、装置ごとの柔軟なチームワーク体制

潤沢な資金力 → 潜在的なニーズ・シーズを発掘 → 知恵、情報を融合した革新的技術の研究開発 → 独創的な発想で先鋭的な装置を創造 → お客さまの期待を超えるパフォーマンスの実現

業務会社カンパニー長メッセージ



サステナビリティと経営

マテリアリティを活用した持続的な成長の実現へ

気候変動に伴い災害は激甚化し、サイバーアタックの脅威は高まり、人口減少により労働力確保も難しくなるなど、企業にとって外部環境はますます厳しくなっています。危機はまさに現実のものとなりつつあり、備えを怠れば会社の持続性も危ぶまれます。会社の持続的な成長を支えるためには、サステナビリティ各施策の充実が急務です。私はCSO（最高サステナビリティ責任者）を兼務する中で、日々そのことを実感しています。

マテリアリティは、当社が持続的に成長し続けるための重要な経営課題であり、経営の方向性を示す指針です。改定は毎年行っていますが、今年度はさらに事業の持続的な成長を支えるために必要なものを加えました。半導体と計測のさらなる融合、それを加速する社員のモチベーション施策などです。マテリアリティを経営の重要課題と位置づけ、現場の人たちと認識合わせをしながら優先すべき活動を選び、組み立てていきました。

年に2回開催するサステナビリティ委員会では委員長の吉田会長、副委員長の木村社長からも、これは本業そのものであると繰り返し示されました。徐々に社内に浸透してきており、会社全体がその方向に向かいつつあると手応えを感じています。

マテリアリティの実践 ①

「自律人財」が事業の成長を支える

マテリアリティは、製品・サービスの拡大、品質向上や環境への配慮も含めた事業面の話、ガバナンスとリスク管理系、人財・組織・風土、ステークホルダーとのリレーション強化の項目で構成されています。これらは全てつながっており、どれか一つが進まなくても会社は継続し得ません。

事業面で半導体と計測の融合の加速、2つの社内カンパニーの連携を促進するためには、社内コミュニケーションの活性化、モチベーションの向上、組織改革、人財の成長などの多様な取り組みが必要です。

そのための具体的な施策として、全管理職を集めたイベントで、当社グループの設立当初からの両事業の歴史を振り返り、それを踏まえて両事業の強みを再認識した上で、未来に向けて両事業のシナジーをどのように創出していくかをテーマとしたセッションを実施しました。



また、当社のパーパス「計測で未来を測り、半導体で未来を創る」の社内浸透も進めています。ハンドブックを作り、全従業員に配布しました。パーパスは、当社グループがどう世の中に必要とされているかという存在意義を表すものであり、共感してもらうことが大事です。皆の心に届いて、強みをもっと活かそう、という雰囲気になってくれれば一番良い、と思っています。

業務会社カンパニー長メッセージ

加えて今年度から「人的資本ワーキンググループ（WG）」に、入社10年目前後の従業員を集めて意見交換をしてもらっています。以前は部長クラスだけを集めていたのですが、それだと若手の本当の声が拾えないのでは、という意見が出たため、思い切って年齢層を下げました。すると、会社をもっとこうしたい、というような前向きな意見や、新しいアイデアが結構出てくるようになり、大変良かったと思っています。

人財の教育も重要な課題です。当社が目指しているのは「自律人財」の育成。主体的にやりたいことや目標を見つけ出し、計画を立て仕事を進め、自分自身のキャリアを築いていくような人財を育てていきたいと考えています。管理職に対する人財育成力研修は一巡し、若手のやる気を引き出そうという気持ちは徐々に醸成されてきていると思います。次は若手層の主体的な挑戦意欲を高めてもらうことが重要だと考え、3年目や6年目研修を開始しました。自ら創意工夫をしながら周りと協力し、いろんな考え方を吸収しながら成長していくスキルを身に着けてもらっています。

最初に本人にやりたい気持ちがないと、何をやってもお仕着せになってしまいます。一人ひとりが挑戦したいことに取り組める環境を整え、その成長を後押しすることが会社の重要な役割です。



社員意見交換会

マテリアリティの実践 ②
開示対応を企業価値向上につなげる

環境対応では、TCFD開示のバウンダリ（範囲）の連結ベースへの拡大を目指していきます。この1年で、海外子会社を含め必要な情報を集められる体制を整備しました。早ければ来年度からの適用を目指します。

情報開示への対応は、ここ数年で一定の水準に達しました。これからは要請されたから開示するのではなく、開示要請項目を参考にしながら、当社の中長期的な成長に真に必要な施策を実施し、その結果を開示するというマインドに切り替えていきたいと考えています。

TCFDでの経験を手本に拡張していくことになる見通しです。本来的に当社がやるべき方向に軸足を置いて進めれば、自然と対応できると思います。

マテリアリティの実践 ③
デジタル活用による競争力の向上

サイバー攻撃が日常化する中、攻撃に備える対策に加え、攻撃を受けてからの対応力も重要です。グループベースでのセキュリティレベル向上を図るとともに、対応策についても拡充を進めており、CSIRTを立ち上げてから2年になりますが、徐々にその対応力も上がってきています。

情報セキュリティ技術に限らず、IT活用力向上も競争力を確保する上での重要な要素です。当社グループにはシステム開発を担うトーセーシステムズがあり、同社を中心にAIをはじめとした新しい技術の活用に取り組んでいます。AIの価値は、使い手がしっかり考え、課題の解決や新たな価値創造にどう結び付けるかによって決まります。開発業務での活用に加え、間接業務の高度化、効率化を進めているところです。サステナビリティ関連の社内情報収集も、AIでの自動化を進めていきます。

私たち業務会社は、これらマテリアリティを推進し、経営基盤を強化することで、両事業を支え、中長期的な企業価値向上に貢献していきたいと考えています。

マテリアリティの改定

東京精密グループは、2025-2027年度中期経営計画に合わせ、事業活動のバリューチェーンの状況と環境、社会への影響など配慮すべき課題を整理し、以下のようにマテリアリティを見直しました。6テーマ、23マテリアリティで構成されており、「持続可能な社会への貢献」と「ステークホルダーからの信用・信頼」を通じて「豊かな社会の実現に貢献」することを目指すものです。今後も必要に応じて適宜見直していきます。

マテリアリティの特定プロセス

当社は、サステナビリティへの取り組みを、経営基盤を一層強固にし、中長期的な価値創造を安定的に実現するための重要な活動として位置づけています。マテリアリティは、多様なサステナビリティの課題の中から特に重要度の高いテーマを特定し、グループの経営方針に組み込むとともに、適切な情報開示を行うための枠組みとして活用しています。

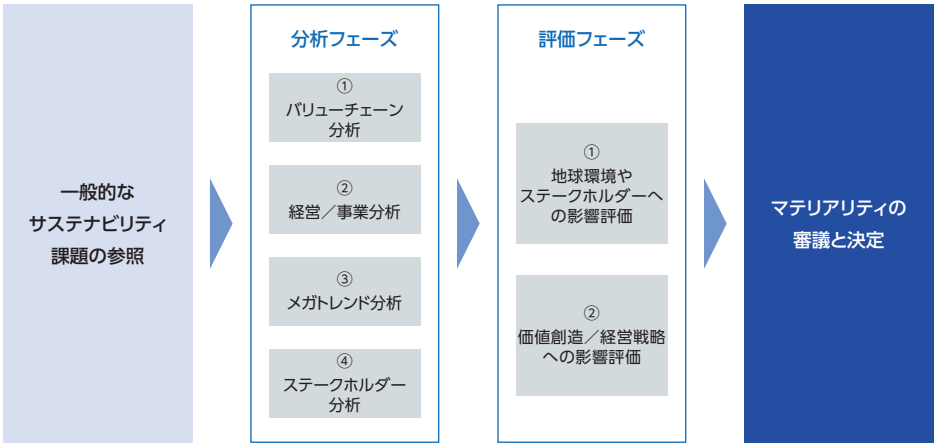
マテリアリティの特定に際しては、財務上の連結対象となるグループ全体のバリューチェーンを責任範囲とし、既に顕在化している課題の洗い出しに加えて、中長期的な社会・環境の変化を踏まえた潜在的課題の抽出、さらには主要ステークホルダーごとに求められる対応事項の整理など、多角的な分析を実施しています。

これらの分析結果を基に、以下の二つの観点から影響評価を行っています。

①自社が地球環境やステークホルダーへ与える影響

②サステナビリティに関する課題が、自社の価値創造や経営戦略へ与える影響

それぞれの観点で重要度が高いと判断された課題をマテリアリティとして特定しています。



1. 一般的なサステナビリティ課題の参照

GRIスタンダード、SASBスタンダード、グローバルコンパクトなど主要な世界的ガイドライン、およびESG格付け機関の評価項目などから、一般的に企業が求められるサステナビリティの課題を参照しています。

2. 分析フェーズ

① バリューチェーン分析

原材料の調達から製造、販売、さらには顧客による製品の使用・廃棄に至るまで、バリューチェーン全体を対象に、自社の価値創造の過程のどこで、どのように社会・環境へ影響（正の影響・負の影響）を与えているかを整理し、そこから重要な課題を抽出しています。バリューチェーン分析では、現在既に発生している顕在的なサステナビリティ課題を主に抽出しています。

② 経営・事業分析

中期経営計画や各事業計画、各種方針を分析し、既に顕在化し取り組みが進められているサステナビリティ課題に加え、事業計画に内在する、将来的に発生する可能性のある潜在的なサステナビリティ課題を抽出しています。

③ メガトレンド分析

気候変動、テクノロジーの進化、経済の変化など、将来の事業環境に大きく影響を及ぼすと考えられるテーマについてメガトレンドを予測し、今後自社が社会・環境に対して果たすべき役割や課題を予想しています。メガトレンド分析では、主に将来的に対応が必要と考えられる潜在的なサステナビリティ課題を抽出しました。

④ ステークホルダー分析

主要なステークホルダーごとに、彼らが抱える課題や関心事項、自社への期待を調査・分析し、それらへの自社の対応の在り方を検討しています。ステークホルダーごとに分析することで、より深いニーズや、自社が対応すべき具体的な事項を明確化しました。ステークホルダー分析では、現在発生している顕在的なサステナビリティ課題とともに、将来的に対応が必要となる潜在的な課題を抽出しています。

3. 評価フェーズ

① 地球環境やステークホルダーへの影響評価

当社事業が地球環境や各ステークホルダーに与える影響について、その規模と発生可能性の観点で評価を行い、影響度を判断しています。評価の結果、地球環境やステークホルダーに一定以上の影響を及ぼしていると考えられる課題をマテリアリティ（インパクト・マテリアリティ）としています。

② 価値創造/経営戦略への影響評価

サステナビリティ課題が当社の価値創造や経営戦略に与える影響について、リスクおよび機会のそれぞれの側面で、その規模と発生可能性の観点から評価を行い、影響度を判断しています。リスク面または機会面のどちらかあるいは両方で影響度が高いと判断した項目を、当社のマテリアリティ（ファイナンシャル・マテリアリティ）としています。

4. マテリアリティの審議と決定

評価フェーズで影響度が高いと判断された項目を、当社従業員やステークホルダーに適切に伝達できるよう、内容を分かりやすい表現に整え、必要に応じてグルーピングを調整した上で、最終的なマテリアリティとして取りまとめています。マテリアリティは、サステナビリティ委員会、経営執行会議で審議を行い、取締役会において確認の上、決定をしています。

マテリアリティの改定

東京精密のマテリアリティとその取り組み

テーマ	マテリアリティ	優先的な活動(2026年度)
豊かな社会の実現に貢献	社会課題を解決する製品の創出と提供(P49)	環境課題に寄与する製品・サービスの拡大
	未来を創り社会を豊かにする半導体製造への貢献(P18)	最先端デバイスに向けた製品開発とサービスの提供
	精密測定を通じたモノづくりのイノベーションへの貢献(P21)	次世代製造技術に寄与する加工時のリアルタイム測定の提供
		精密測定による半導体製造への貢献
持続可能な社会づくりに貢献する事業活動の推進	バリューチェーンにおける温室効果ガスの削減(P43)	カーボンニュートラルに向けた取り組み
		事業のCO_2排出量削減
		エネルギー管理の徹底
	地球環境に貢献する製品の創出と提供(P49)	環境に配慮した製品開発
	環境保全と資源管理の最適化(P48)	水使用量の調査分析と削減
		有害物質及び高懸念物質の管理と削減
		生物多様性保全活動の推進
	サーキュラー・エコノミーの実現(P47)	資源循環(サーキュラー・エコノミー)の推進
	環境マネジメントシステムの高度化(P47)	ISO14001による環境配慮活動の推進
ステークホルダーの信用・信頼に応える企業姿勢の維持・強化	バリューチェーンにおけるサステナビリティの推進(P51)	サステナブル調達の推進
		人権の尊重／紛争鉱物対応
	製品安定供給とカスタマーサポートの充実	顧客満足度の向上
		品質管理の高度化
		東京精密技術の伝承
	ステークホルダーエンゲージメントの推進	IR活動推進
		産官学連携での技術発展への貢献
		地域美化活動の推進
		迅速・公正な情報開示
		サステナビリティサイトの積極運用

テーマ	マテリアリティ	優先的な活動(2026年度)
多様な人々が前向きに活々と働ける職場環境の醸成	多様な視点と価値観の尊重(P39)	女性活躍推進(女性中核人財の採用と育成)
		海外グループ会社との人財交流
		障がい者が活躍できる職場環境の整備
	心身ともに健康で安全に働ける職場づくり(P41)	従業員の健康推進に資する施策の周知と強化
		労働災害の防止
		安全・安心に働ける環境づくり
		自主的な安全活動推進
	従業員エンゲージメントの向上(P39)	パーパス、ビジョンの浸透
		失敗を恐れずにより高度な課題にチャレンジできる風土の醸成
		カンパニーや部門間の垣根を越え、一体感のある組織風土の醸成
公正な企業活動の基盤となるガバナンスの強化	コーポレート・ガバナンスの強化(P61)	企業倫理・法令遵守の厳格化
		適時・適切な情報開示
	コンプライアンスの強化(P66)	内部統制機能の維持・向上
	リスクマネジメントの推進(P68)	リスクマネジメントの強化（BCM/BCP)
		グループ会社のセキュリティ強化
		CSIRT体制の強化
		次世代セキュリティ基盤への移行
事業基盤の強化	人財の確保と育成の推進(P39)	採用力の強化
		教育研修機会の充実
	研究開発力の強化	最先端技術への対応力強化
	知的財産の管理と活用(P37)	知的財産投資・活用
		独占的事業領域の確保
	DXの推進(P42)	IT活用による業務効率化
		個別DX案件の推進
		各種AI推進施策（ガイドライン/規程/環境整備)
		自動化・省人化の推進
	変革を支える企業風土の醸成(P39)	パーパスの浸透
	持続可能な安定経営の実現	リカーリングビジネスの強化
		強固な事業継続計画の策定
		棚卸資産の管理強化
		投資判断フォーマットの導入
		公正な利益分配

サステナビリティマネジメント

東京精密グループはサステナビリティを重要な経営課題と認識し、サステナビリティ活動を推進しています。2021年11月には「サステナビリティ基本方針」を定め、サステナビリティ委員会を設置するなど、パーパスの実現に向けた推進体制を強化してきました。サステナビリティの重要課題を特定し、中長期戦略に組み込んで具体的な取り組みを設定、事業を通じて実行していくことが重要だという考えのもと、これからも社会の持続可能な発展と東京精密グループの持続的な成長を目指します。

サステナビリティ基本方針

私たち東京精密グループは、ミッション「世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の商品を創りだし、皆様と共に大きく成長していく」に基づき実践する事業活動を通じて、お客さま、株主の皆さま、サプライヤーさま、従業員、地域社会、国際社会など全てのステークホルダーとの間でWIN-WINの関係を創りあげ、持続可能な社会の実現に向け積極的に役割を果たすとともに、企業価値の向上に努めます。

サステナビリティ基本方針

1. 環境問題への取り組み
2. 社会からの信頼の確立
3. 人権の尊重
4. 人財育成
5. 地域社会への参画と貢献
6. 公平、透明で効率的なガバナンス体制の構築と運営

サステナビリティ基本方針全文
https://www.accretech.com/jp/sustainability/esg/guideline.html

サステナビリティ推進体制

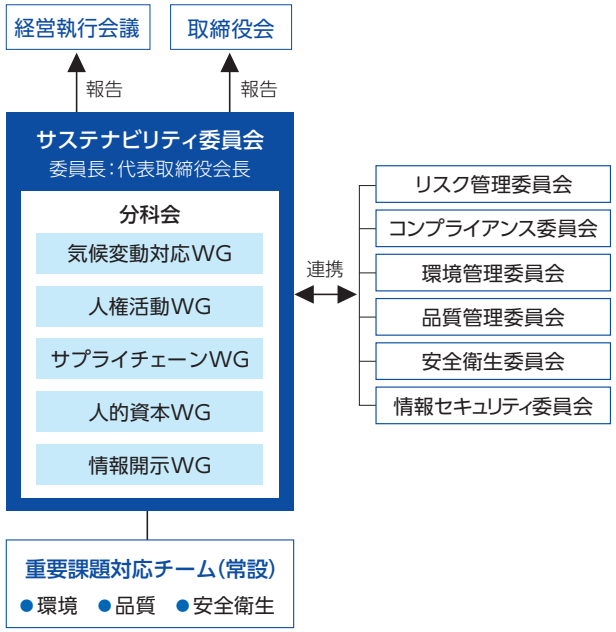
当社グループは、サステナビリティ活動を的確に推進・マネジメントしていくために、サステナビリティ委員会を設置しています。代表取締役会長を委員長に社外取締役とグループ会社の担当役員を加え、サステナビリティ活動に関する企画・立案・計画・実施を担うものです。本委員会は6つの専門委員会と連携を取り、工場部門に3つの重要課題対応チームを設置して活動を推進しています。喫緊の課題とされるものについては、委員長によって分科会が設置されます。現在は5つの分科会が活動しています。

サステナビリティ委員会

委 員 長: 代表取締役会長
開催頻度: 年2回
機　　能: 基本方針の策定、運営体制の構築、目標・指標の設定
執行役員会議や取締役会への報告・提言
施策実行のモニタリングおよび各種情報収集

2023年7月よりサプライチェーンワーキンググループ(WG)を新設し、サステナブル調達の実現を進めています。また、2024年4月より、人権活動プロジェクトを常設の人権活動WGに変更し、当社グループはもとよりサプライチェーンとも一体となり人権に関わる課題に対応していきます。

サステナビリティ推進体制



知財戦略

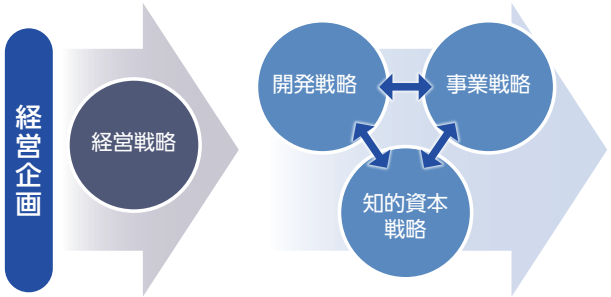
知的資本戦略での技術開拓

知的資本基本方針

● 知的資本戦略の位置づけ

東京精密は、無形資産の一つである知的資本を重要視しており、知的資本の充実に向けて積極的に投資を行っています。

知的財産部門は、事業部門と密接に連携し、効果的な知的資本戦略を立案・実行することで、知的財産の側面から技術開発支援と経営戦略を推進しています。



経営戦略に基づく開発戦略や事業戦略に基づく知的資本戦略を推進

テーマ	事業基盤の強化
マテリアリティ	知的財産の管理と活用
優先的な活動・KPI	

知的財産投資・活用

KPI：既存事業の競争力強化

- 高需要製品の素地構築
  製品の改良技術を特許化して競合との差別化を図ります。当社独自の製品機能により、売上高や利益率向上に貢献します。
- 自社ブランディング
  当社製品やサービスの信頼性を企業イメージとして保護し、販促活動の支援につなげます。

独占的事業領域の確保

KPI：独占的事業領域の確保

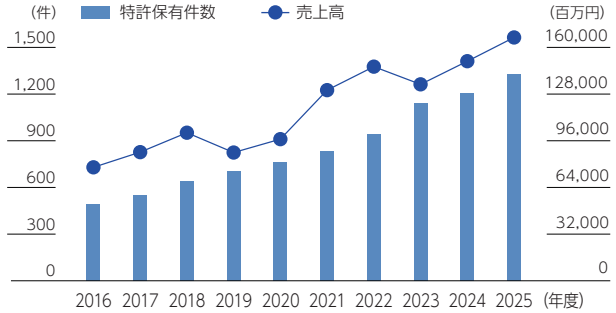
当社の経営資源と市場環境とを勘案して新事業領域を創出するとともに、当該事業領域の独占的権利の確保を目指します。

● 知的資本の拡充

当社は、知的財産権の保有件数が従前から増加傾向にあり、今後もさらに、積極的に権利取得を進め、知的資本の拡充を図ります。また、知的資本の拡充と相関して当社業績が向上していることが確認できます。なお、知的資本の安定的な拡充は、潤沢な研究開発費の予算配分が下支えしていることも確認できます。

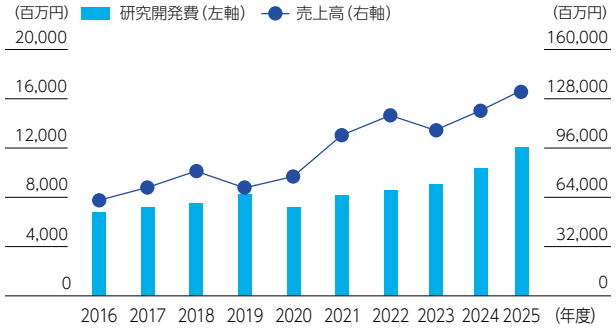
また、外国への展開については、昨今の半導体の自国内生産への流れや今後の経済動向予測を踏まえて知的財産権の各国での取得を進めています。

特許保有件数と売上高の関係



*特許保有件数は各年の12月末日で判定した件数を示しています。

研究開発費と売上高



*売上高、研究開発費は年度末の値を示しています。

知的資本に対する取り組み

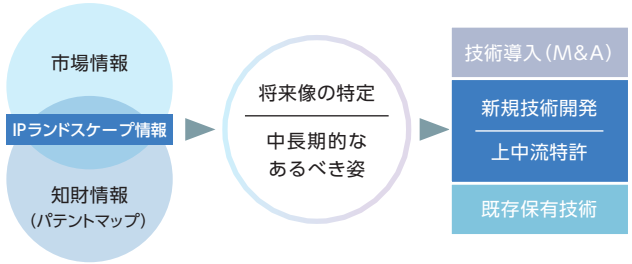
現状分析

● 知的財産戦略と市場動向予測による技術創出

当社では、知的財産の状況分析としてパテントマップ分析および保有資本の棚卸に取り組んでいます。この分析を通じて、自社コア技術の強化やさらなる強化方針（ポートフォリオの充実化）の策定に活かすほか、他社の知的資本状況の把握や、新規技術分野への展開可能性の探索にも活用しています。

さらに、IPランドスケープ的試行による市場の動向予測と戦略においては、知財情報の自他分析にとどまらず、これに市場情報を融合させて、中長期的な事業戦略のヒントを探ります。これにより、中長期的な時間軸で必要となる技術要素を特定し、顧客需要にフィットした技術創出を図ります。

また当社では、中長期戦略の観点から創出される特許技術を「中流・上流特許」と名付け、テーマ会議を定期的に開催し、市場の到来前に事業領域の確保を狙う取り組みを行っています。上流特許においては、自社だけでなく産官学との連携を通じての共同開発も視野に入れ、先進的な技術の創出を目指しています。



知財戦略

● 特許網の充実

自社特許網の現状を知的財産の棚卸で把握し、必要に応じて特許を追加取得することで、理想的な特許網を構築しています。これにより高い参入障壁を実現し、競争優位性を確保しています。特に基本特許は世界各国で幅広く取得し、重要な発明は秘密情報として厳重に管理しています。

また、技術部門と連携し、不要な権利は定期的に見直して放棄し、過剰な投資を防いでいます。

● 出願戦略（包括的かつ安定的な権利の取得）

技術部門と定期的に発明相談会を開催し、発明者自身が気付かない発明も含めて漏れなく発掘・出願しています。また、出願明細書の品質向上や実験データの充実を図ることで、瑕疵のない安定した権利の取得に努めています。

審査対応では不要な限定補正や意見主張を控え、広範な権利化を目指すとともに、類似発明を複数の観点から出願することで、万一一部が無効化されても実質的な発明の保護を維持できるよう権利の安定性を高めています。

さらに、事業領域外への技術転用も想定した権利化を進め、ライセンス需要の創出にも注力しています。

● ブランド保護

当社はハウスマークや製品名・ロゴの商標権を世界各国で取得し、ブランド保護体制を構築しています。他社の商標登録状況も監視し、出所混同リスクにも適切に対応しています。ドメインも事業活動地域において各国で幅広く登録しています。

● デザイン保護

審美性の高い製品デザインやパーツデザインなど技術的側面以外の製品特徴も知的資本として保護しています。知財ミックスにより当社事業を多角的に保護し、知的資本価値の相乗的向上を図っています。



PULCOM W10
インプロセス・ポストプロセス両用指示管制部

● 知的資本創出の促進

当社は、各部門の責任者が集まり未来社会を考える場を定期的に設け、社会貢献の可能性を探っています。そこで抽出された課題については、各部門の担当者が集まりソリューションを検討することで、質の高い特許発明の創出を促進しています。この取り組みは若手従業員にも発言や挑戦の機会を与え、エンゲージメント向上や人財育成にも寄与しています。

また、知的創造活動の活性化と知的財産保護の徹底を目的に、職務発明の対価だけでなく、優秀な発明や業績貢献の大きい特許発明には報奨金を支給し、年度ごとに多数出願した部署や個人には発明表彰も行っています。

● 他社権利の尊重

当社では製品開発の各段階で開発審議会を実施し、他社知的財産とのクリアランスや抵触リスクを評価しています。知的財産専門スタッフが開発初期から営業活動まで関与し、特許・意匠・商標・著作権・不正競争防止など幅広く適法な事業活動を支援します。

また、特許公報の監視や他社の開発動向調査も行い、リスクを早期にヘッジしています。

さらに、取扱説明書やカタログなどの知的財産表記も関係部署と連携し適切に対応しています。

● 知的財産人財育成

当社は知的財産リテラシー向上のため、職能別に知的財産研修を実施しています。特に若手技術者には、技術部門ごとに年数回の基礎研修を繰り返し行い、新たな知的資本の創出を促進しています。さらに、各技術部門には特許や商標、意匠、著作などを管理する知財管理責任者を配置し、日常的な管理やOJTを実施しています。発明者は知財部門や知財管理責任者と連携して特許出願や審査対応を行い、実践的な知見を深めています。また、e-learningによる全社的な知財教育も推進し、知財に関わりの薄い部署にも基礎知識の習得を促し、全社的な知財リテラシーの底上げに努めています。

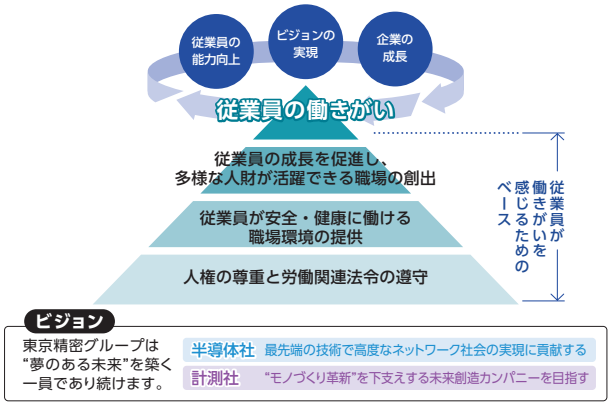
人財戦略

基本的な考え方

東京精密グループのビジョンの実現、ミッションの達成のためには、当社グループ最大の財産である従業員一人ひとりが、夢に向かってその能力を最大限発揮しながら成長していくことが必要です。

そのため当社グループは、「人権の尊重と労働関連法令の遵守」「従業員が安全・健康に働ける職場環境の提供」「従業員の成長を促進し、多様な人財が活躍できる職場の創出」を推進し、働きがいの向上を図っています。

東京精密グループのビジョン・ミッション
https://www.accretech.com/jp/company/purpose.html



人財育成

マテリアリティ	人財の確保と育成の推進
優先的な活動	教育研修機会の充実

従業員一人ひとりの成長は、当社グループが持続可能な成長を続ける上で不可欠なものであるという考えのもと、人財育成方針を定めています。次世代を担う人財を育成するため、本方針に基づき多様な研修機会を設け、計画的かつ継続的に人財育成に取り組んでいます。

人財育成方針
https://www.accretech.com/jp/sustainability/esg/humanresources.html

教育・研修

全社共通で求められる基礎的な知識・ビジネススキルの習得をする「共通研修」、それぞれの階層に必要となるスキルを習得する「階層別研修」、組織別・業務別に必要となる専門性の高い個別技術の習得をする「部門別研修」を実施しています。

● 人財育成力の強化

当社では、従業員の自律的成長を支援する組織風土の醸成に向け、管理職層への「人財育成力研修」を展開しており、研修を通じて部下の「成長を促進する対話力」の獲得を推進しています。

自己啓発支援制度

当社では従業員の自発的なスキルアップと継続的な成長を支援するため、自己啓発支援制度を充実させています。近年、学習コンテンツおよび提供形態を大幅に見直し、従来の通信教育に加え、国内外で幅広く活用されているオンライン学習サービスを導入しました。

従業員エンゲージメントの向上

当社グループが激変する環境で持続的成長を実現するためには、従業員が高い意欲で業務に取り組み、生産性向上や革新的なアイデアの創出を通じて、顧客に高い付加価値を提供することが重要です。そこで毎年実施するエンゲージメントサーベイ結果をもとに、部門横断で取り組みを進めるため2024年1月に「エンゲージメント向上ワーキンググループ(以下WG)」を立ち上げました。さらに2024年10月には人的資本全般の強化に向けて「人的資本WG」に拡大して、以下の取り組みを進めています。

マテリアリティ	従業員エンゲージメントの向上
優先的な活動	パーパス、ビジョンの浸透 カンパニーや部門間の垣根を越え、一体感のある組織風土の醸成

- 尖った発想を持つ人財の発掘と、イノベーションを生み出すための教育を実施
- パーパス／ビジョンの浸透に向けた冊子や動画の作成
- 部署間で相互理解を深めるため、部署横断チーム組成や部署紹介冊子作成
- 社内コミュニケーションを活性化し、若手が意見を発しやすい職場づくり

活動の一環として2026年8月に「パーパスブック」を発行・配布しました。パーパスの浸透を通して、価値観の共有化と自分ごと化を促します。

多様な人財の活躍推進

マテリアリティ	多様な視点と価値観の尊重
優先的な活動	女性活躍推進(女性中核人財の採用と育成) 海外グループ会社との人財交流 障がい者が活躍できる職場環境の整備

当社グループは、多様な視点や発想が互いを刺激し合えば新たな価値の創造につながり、個人の能力の総和を超える相乗効果を得ることができると考えています。そのため、年齢、性別、人種、宗教、出身国、障がいなどを理由とする一切の差別的行為を禁止するとともに、多様な人財が、安全・健康で働ける職

人財戦略

場の実現に努めています。そして、従業員一人ひとりの個性が尊重され、自身の持つ能力を最大限発揮でき、やりがいを持って働ける環境を構築していきます。

女性活躍推進

当社グループは、多様な人財がおのおのの強みを発揮できる企業風土の醸成を目指して「女性活躍推進宣言」を掲げ、具体的な行動を推進しています。

中核人財として女性が一層活躍できる組織の実現に向け、女性正社員の採用拡大および職場環境の整備を喫緊の課題と認識し、「女性活躍推進に関する行動計画」を策定し、各種施策を推進してきました。その結果、(2021年度-2025年度)計画の目標を2024年度に達成したため、新たに「女性活躍推進法に基づく行動計画」(2025年度-2026年度)を策定しました。

今後も、女性正社員の採用拡大を継続するとともに、これまで以上に女性の活躍を促進するための取り組みを強化し、持続可能な組織づくりを目指していきます。

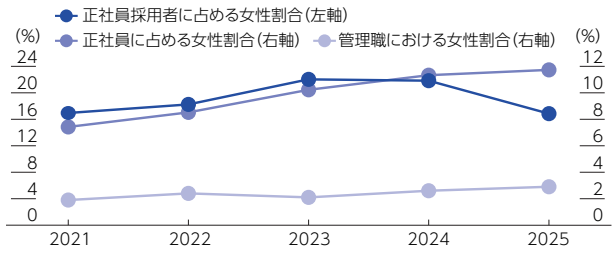
女性活躍推進宣言
https://www.accretech.com/jp/assets/womensparticipation_2026_01.pdf

● 女性活躍推進法に基づく行動計画

(2025年度-2026年度)における目標

管理職および主任、主任補の女性	2025年3月比で1.5倍以上

女性活躍推進に関するデータ推移



外国籍および中途採用者雇用

当社において中途採用人財は既に欠かせない戦力となっています。また当社は国籍にかかわらず優秀な人財を採用、登用しています。中途採用人財、外国籍人財のいずれも多様な視点や発想および海外との緊密な連携などに大きな力を発揮しています。

当社の管理職における外国籍従業員割合は0.4%、同中途採用者割合は41.0%です。

海外グループ会社との人財交流

海外拠点では、制度や商習慣の違いから本社の意図が十分に伝わりにくく、拠点ごとの運用の属人化により人財活用に差が生まれることがあります。この「距離」や「前提の違い」の放置は、駐在員・現地従業員双方の不安や負担を増やし、モチベーション低下や早期帰任を招き、グループの成長機会を損じかねません。この課題を改善するため、当社は海外グループ会社との人財交流を「多様な視点と価値観の尊重」を実現する施策としています。

2025年度から年次で実施している「アドミン会議」では、本社と海外現地法人の管理部門が実務を起点に対話を行い、仕事の進め方や判断の背景にある価値観を共有しています。会計・人事・ITなどの運用知見を持ち寄り、各拠点の強み・弱みを学び合うことで、協働の質を高めています。

また、人財の双方向の往来を支えるため、2026年6月に現地調査を実施しました。駐在制度の理解促進に加え、駐在員や現地従業員、現法責任者・HR担当者、帯同家族との対話を通じて、働き方や生活面の要望、税制面の論点などを把握し、改善につなげています。

こうした取り組みにより、挑戦しやすい環境と納得感のある人財活用を実現します。不安や負担を軽減し、人財の定着と成長を後押しすることで、将来のグローバルリーダー育成と、グループの一体感に基づく価値創出につなげていきます。

障がい者雇用・活躍

当社グループは、障がいのある社員一人ひとりが個性を活かして活躍できる企業を目指し、仕事を通じた成長と自立を支援するとともに、就労支援を通じて雇用の社会的責任を確実に果たすための基盤構築を進めています。

● 障がい者の活躍基盤の強化

当社は2023年4月に障がい者就労支援を担う専任部署「Sフロア」を設置し、専門指導員による育成と社内業務の切り出し・受託を一体的に進めてきました。2026年4月からはSフロアで担っていた障がい者の就労支援機能をアクレーテク・クリエイトへ移管し、障がい者雇用の拡大と活躍機会の創出に向けた体制を強化しています。社内各部門からの業務受託を通じて業務領域を拡げるとともに、個々の強みを活かせる環境の強化と、グループ内の業務効率化にもつなげていきます。

● 長期就労を支える採用・育成体制と活躍フィールドの拡大

障がいを「個性」と捉え、それぞれの得意領域を伸ばすために、採用から定着、キャリアステップまで一貫した支援体制を構築しています。近隣の特別支援学校や支援センターと密に連携した持続可能な採用基盤の構築に加え、現場の指導員向け研修を定期開催し、組織全体のサポート品質を向上させています。将来的には他部署への就労を後押しする動機付けも進め、活躍のフィールドをさらに拡げていく方針です。

また、これら一連の取り組みを永続的かつ組織的な仕組みへと昇華させ、グループ全体の障がい者雇用をさらに安定的・持続的に拡大させるための経営基盤として、2026年度に特例子会社認定の取得を予定しています。

人財戦略

健康経営

東京精密グループの価値創造を支えているのは、研究開発、生産、営業、サービス、管理部門など、それぞれの領域で専門性を発揮する従業員です。

従業員一人ひとりが心身ともに健康で、安全に、持続的に能力を発揮できる職場環境を整えることは、当社グループの技術力、品質、安定供給を支える重要な経営基盤であると考えています。当社グループでは、健康診断、ストレスチェック、労働時間の把握、産業保健活動などを通じて従業員の健康課題を把握し、生活習慣病の予防、メンタルヘルス不調の早期発見・早期対応、過重労働の防止および職場環境の改善に取り組んでいます。

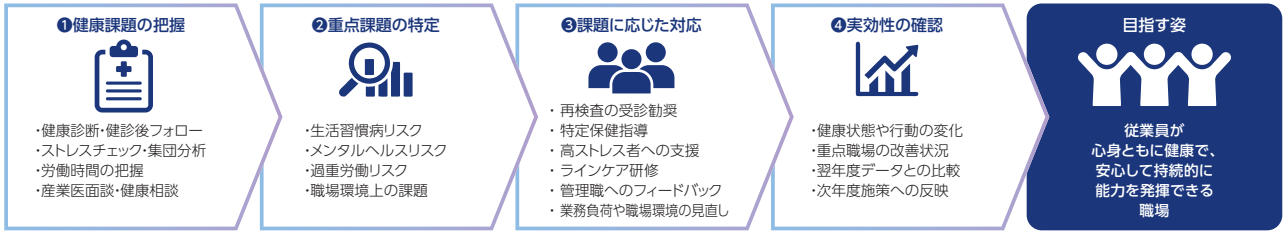
今後は、健康施策を実施することにとどまらず、各種データの分析結果を従業員への支援や職場改善に結び付け、その実効性を継続的に確認することで、健康経営のさらなる高度化を進めていきます。

マテリアリティ	心身ともに健康で安全に働ける職場づくり
優先的な活動	従業員の健康推進に資する施策の周知と強化 安全・安心に働ける環境づくり
コミットメント	健康診断やストレスチェック等から得られるデータを活用し、健康リスクの低減と職場環境の改善を進めることで、従業員が安心して持続的に能力を発揮できる事業基盤を構築します。

● 主要指標

指標	2025年度実績	今後の方向性
定期健康診断受診率	94.4%	100%
特定保健指導実施率 (対象者に対する実施率)	54.3%	継続的な向上
ストレスチェック受験率	99.4%	高水準の維持
ラインケア研修受講率 (管理職対象)	100%	100%

健康課題の把握から改善まで



集団分析を職場改善の起点に



高い受験率を基盤に、データを職場改善につなげることで、メンタルヘルス不調の予防と働きやすい職場環境の実現を目指します。

健康優良企業「金の認定」を継続改善の出発点に

当社は、従業員の心身の健康保持・増進に向けた取り組みが評価され、2026年3月に健康優良企業「金の認定」を取得しました。認定取得をゴールと捉えず、今後も従業員一人ひとりが健康でいきいきと働ける職場を目指していきます。

健康優良企業
認定 協金第 278号

ワーク・ライフ・バランス

当社グループは、従業員一人ひとりが仕事と生活を両立しながら能力を最大限に発揮できる職場環境の整備に取り組んでいます。

法定基準を大きく上回る独自の休業制度を設け、従業員が仕事と子育てを両立し安心して働ける環境を実現するため、「次世代育成支援対策推進法」に基づく行動計画(2025-2026年度)を策定しました。

● 目標

年次有給休暇	年5日取得率100%

有給休暇付与日数が年10日以上ある対象の従業員
特別有給休暇など年次有給休暇以外の休暇は含まれません。

● 実績

年度		2021	2022	2023	2024	2025
年次有給休暇取得率(%)		69.8	76.7	72.3	71.9	75.8
年次有給休暇年5日取得率(%)		100	100	100	100	100
育児休業取得率(%) (取得/対象者数)	女性	対象者なし	100(2/2)	100(1/1)	100(3/3)	100(5/5)
	男性	19.2 (5/26)	38.5 (10/26)	57.1 (16/28)	54.2 (13/24)	80.8 (21/26)
	復職率	100	100	100	93.3	100
子の看護休暇取得者数(名)		7	11	16	18	26
介護休業取得者数(名)		0	0	0	0	2
介護休暇取得者数(名)		4	9	12	15	15

対象範囲：(株)東京精密(単体)　正社員

DX戦略

東京精密グループは、デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進を経営の重要課題と位置づけています。業務のデジタル化やAI・データの高度な活用により意思決定を迅速化し、顧客や取引先への提供価値を最大化します。同時に業務負荷の軽減や柔軟な働き方を実現し、従業員のエンゲージメントを高めます。これらの変革をサプライチェーン全体へ波及させ、社会全体の生産性向上と持続可能な発展に貢献していきます。

ITを活用した業務の高度化・効率化

生成AIの業務への活用

近年の生成AIの進化により、その活用は業務効率化やコスト削減にとどまらず、開発や経営判断のスピード・精度を高め、企業の競争力強化と新たな価値創出を支える重要な基盤となりつつあります。

当社はChatGPTをベースとした自社向け生成AI基盤（ACCT-BRAIN）を2024年9月より導入し、国内従業員が業務に活用しています。導入時には研修を実施し、活用方法に加え、機密情報・個人情報の取り扱い、出力内容の検証などの注意点を周知しました。モデル・機能のアップデートによる回答品質と操作性の向上により現場での使い勝手が高まった結果、利用者数および利用回数も増加し、日常業務への定着が進んでいます。

今後は、効果が高い業務からユースケースの標準化と業務プロセスへの組み込みを進め、継続的な改善につなげていきます。

ワールドワイドでの情報共有基盤の強化

当社グループでは、ワールドワイドでの情報共有を実現するため、クラウドストレージを導入しています。これにより、グループ全体でコンテンツの一元管理が可能となり、各拠点で分散していた情報資産の効率的な管理・運用が進みつつあります。

2025年度よりクラウドストレージ内のAI機能の活用も開始しました。蓄積された社内データからの迅速な情報抽出や要約などが実現し、日常業務の効率化やグローバルな意思決定の迅速化といった新たな効果が生まれ始めています。

安全面においては、クラウドストレージの導入によって、グループ会社全体で高いセキュリティレベルを維持することが可能となりました。情報漏えいリスクを低減するとともに、全社的なガバナンスの強化にもつなげています。ストレージ内の情報管理については、グループ共通の規程を新たに作成し、ワールドワイドで統一されたルールのもと運用を行っています。これらを通じて効率的で安全な情報共有環境とAIによる業務効率化を進め、持続的なグローバルビジネス展開を支える基盤を強化していきます。

AI利用方針・規程の策定

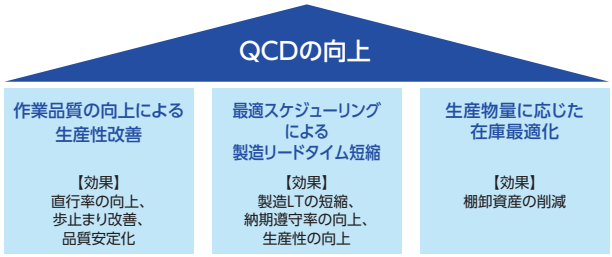
社会全体で生成AIの利活用が急速に進む中、企業には革新的な価値創造と同時に、適切なガバナンスの構築が求められています。当社グループは、この変化に迅速に対応するため、生成AIの活用に関する利用方針および具体的な行動基準を定める利用規程の策定を進めています。今後、本規程の運用開始にあわせて、機密情報の入力禁止や生成物の検証、定期的な社員教育を徹底し、グループ全体でリスク管理体制を構築していきます。

ITを活用した生産性の向上

成長が期待される半導体市場の動向を踏まえ、当社グループは生産キャパシティの拡充に取り組み、将来的な需要増加に備えた体制整備を進めています。市場の急激な変化や高い品質要求に柔軟に対応していくためには、生産規模を拡大するだけでなく、安定的な生産・供給と、高水準なQ（品質）・C（コスト）・D（納期）を維持し続ける必要があります。そのためには、既存の生産プロセスの再評価に加え、ITを活用したさらなる業務効率の向上が求められます。

当社グループはこれまでも生産現場で、ITを活用した生産性向上に取り組んできましたが、紙ベースやエクセルファイルでの管理も残っており、情報共有の遅延や属人化、業務の非効率性といった課題につながっています。

こうした状況を踏まえ、当社のQCD向上に向けては、「作業品質の向上による生産性改善」「最適スケジューリングによる製造リードタイムの短縮」「生産物量に応じた在庫最適化」の観点で取り組むべき課題があると認識しており、課題解決の一環として、最適スケジューリングによる製造リードタイムの短縮に向けた生産システムの改善を進めています。この取り組みを通じて、改善によるKPIと期待効果を明確にし、システム化を推進するとともに、将来的にはIT（情報技術）とOT（制御・運用技術）の融合によって、業務効率の向上と生産性の最大化を目指していきます。



環境

気候変動に関わる情報開示(TCFDに基づく開示)

2022年3月、東京精密は「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)」提言への賛同を表明しました。気候変動が当社事業に与えるリスクと機会を分析し、課題を共有・展開するとともに、TCFDの枠組みに基づいた気候関連財務情報の開示を進めます。

▼詳細は、下記Webサイトを参照ください
気候変動に関わる情報開示(TCFDに基づく開示)
https://www.accretech.com/jp/sustainability/esg/tcfd.html

TCFD TASK FORCE ON CLIMATE-RELATED FINANCIAL DISCLOSURES

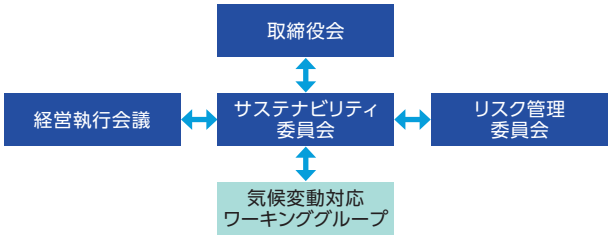
ガバナンス

東京精密グループは、気候変動を経営上の重要課題として認識しており、気候変動問題に関するリスク・機会をサステナビリティ委員会で審議・管理し、その内容を定期的に取締役会に付議・報告します。

サステナビリティ委員会の委員長は代表取締役会長が務め、年2回定例のサステナビリティ委員会で審議するとともに、委員長が必要と認める場合、取締役会に付議・報告します。各取締役は、刻々と移りかわる気候変動関連の状況を把握するために、さまざまな機会や方法を通じて情報収集を行い、知見を深めています。取締役会では気候変動に係るリスク・機会の課題を共有し、目標管理や課題解決に向けた議論を行う他、今後は気候変動対応ワーキンググループを通じ、2030年度目標達成に向けたマイルストーン設定をします。

● 気候変動対応ワーキンググループ

サステナビリティ委員会の分科会として「気候変動対応ワーキンググループ」を設置し、気候変動対応活動に関する調査・検討を担い、定期的に委員会に報告します。技術、製造、営業および管理部門の関係者が参加し、リスク・機会の抽出、シナリオ分析および対応策の検討を組織横断的に推進しています。



リスクマネジメント

東京精密グループは、業務執行に係るリスクの把握と管理を目的として「リスク管理規程」を定め、代表取締役社長を責任者とする「リスク管理委員会」を設置し、潜在的なリスクの発生予防と危機発生に備えた体制を整備しています。

気候変動に関するリスク(移行／物理)については、サステナビリティ委員会の分科会である「気候変動対応ワーキンググループ」が中心となって識別・評価・検討を行い、その結果を定期的にサステナビリティ委員会へ報告する他、緊急性に応じて適宜報告し、事業経営に影響すると思われる事案に関しては、委員会より取締役会に速やかに報告し、審議されます。

リスク管理委員会で取り上げる対象リスクにも気候変動リスクを追加し、リスクアセスメントおよび顕在化したリスク事象についての対策検討などの議論を機動的に行うことにより、グループ全体の対応に当たります。

戦略

現状の分析対象は当社国内事業で、Scope1、Scope2を対象とします。

国内および海外子会社グループ企業のGHG排出量については、今後モニタリングを進めながら順次対応していく予定です。また、Scope3については、排出量が大きいと予測されるカテゴリ1とカテゴリ11の把握を進めてきました。2025年より他のカテゴリの把握を進めています。

● 気候変動のリスクおよび機会

将来予測は不確実性が高く分析が難しいことから複数のシナリオを参照して検討を行いました。2℃未満シナリオの下での対応では不十分との国際的な世論が形成されつつあり、1.5℃シナリオを視野に入れて分析を行いました。一方、1.5℃シナリオへの対応では、物理的リスクへの意識が希薄化することから、現状の経済活動を継続した場合に気温が上昇する4℃シナリオでの事業環境を想定しました。

(参照したシナリオ)
1.5℃シナリオ:【IEA】NZE、1.5℃特別報告書【IPCC】SSP1-1.9
4℃シナリオ:【IEA】STEPS【IPCC】SSP2-4.5、SSP3-7.0

また、環境リスク・機会の再分析を行い、中期・長期で取り組むアクションを以下のように見直しました。

- **気候変動に対する全体像の整理と取り組み方針**
- **新規事業領域探索**
- **気候変動対応を起点としたBCPの強化**
- **LCA・Scope3(顧客・サプライヤーとの連携含む)**

環境

シナリオ	リスク／機会		イベント	内容	財務インパクト	発現時期
1.5℃	リスク	規制	カーボンプライシング	●炭素税導入による原材料・資機材・エネルギー・輸送費用等の上昇 ●国境炭素税の導入により、製品輸出への制約	▲▲	中期
		市場	EV化	●従来の事業・製品（内燃機関関連部品向け計測器）の需要縮小	▲▲▲	短期
			脱炭素化プレミアム	●脱炭素化に伴う材料価格の高騰、調達難、代替品確保に伴うコスト発生 ●非化石エネルギーの調達難や調達コストの上昇	▲▲	中期
		評判	脱炭素化対応の遅れ	●気候変動対応をはじめとするESG対応の遅れは、資金調達や取引関係に悪影響	▲▲	中期
	機会	市場	EV化 電化・デジタル化	●EVの新たな素材・部品への計測需要が拡大・半導体利用が増加し、生産能力が拡張	▲▲▲	中期
			再生可能エネルギー 市場拡大	●再生可能エネルギー市場拡大に伴う計測機器需要の拡大	▲	長期
		資源効率 エネルギー	生産設備	●工場内の省エネ対策（設備やプロセス）や資源の再利用により、生産性向上と顧客の脱炭素化要望に対応	▲	短期
		製品 サービス	低炭素製品・サービス	●LCA観点による環境負荷の低減により、市場での製品評価や優位性が向上 ●顧客の軽量化ニーズを実現捕捉（計測製品需要拡大）	▲▲	短期
4℃	リスク	物理 （急性）	激甚化災害の発現	●リスク対策費用（BCP対応）の増加 ●被災による物的損害と復旧費用の発生 ●被災による操業停止（自社・サプライヤー要因）	▲▲▲	中期
	機会	レジリエンス	災害対応	●災害時における製品・サービスの安定供給により、顧客生産体制の維持に貢献	▲▲	中期

凡例　財務インパクト:▲▲▲　大、▲▲　中、▲　小　発現時期:短期2022～2024、中期2025～2029、長期2030～

▶グループ企業（国内および海外子会社）のGHG排出量のモニタリング

当社グループ企業のうち生産拠点におけるScope1とScope2のGHG排出量の調査を開始しました。

▶Scope3の開示に向けた取り組み

当社のほとんどの製品は、部品・部材を調達し、自社で製造・販売、お客さまの現場で稼働しています。
そのため、バリューチェーン全体での温室効果ガス排出量を把握することが重要であると考えます。
2024年度より新たにScope3対応プロジェクトを発足し、カテゴリ1～カテゴリ15の把握を進めています。

● 機会に対する戦略

世界がカーボンニュートラルを目指す過程で、生産活動の効率化・省エネルギー化（主にデジタル化による）と脱炭素エネルギーへの転換（主に電化による）が進むと予想されます。これにより、デジタル・情報通信技術の適用範囲が拡がり、電子機器・電子部品が急増し、半導体デバイスの需要も持続的に増大すると考えられ、当社の半導体製造装置のニーズも飛躍的に高まることが見込まれます。また、電子機器・電子部品の高機能化に伴い設計が複雑化し、新たな製造工程の課題解決ニーズが高まります。当社はこれに対応した製品群を開発・提供していきます。

さらに、デジタル化・電化の進展に伴い、データ量・計算量の増加（IoT機器・AIの普及）による消費電力の増大や電気モータの利用拡大による損失電力の増大といった課題も発生します。半導体分野においては、次世代パワー半導体（GaN、SiCなど）の普及が期待されており、当社も関連技術・製品開発を推進しています。

また、カーボンニュートラルを達成するためには、温室効果ガス排出量が大きい電力分野の脱炭素化だけでなく、非電力分野（民生・産業・運輸）においても、省エネルギー化や電化をはじめとする多種多様な取り組みが必要です。その中で重要な役割を果たす工業製品は、日々高精度化、高度化、複雑化しており、モノづくりを効率よく、安定して合理的に供給するには、形状や輪郭を管理し、長さや表面粗さを精密に測定する必要があります。当社の計測技術は、電力・非電力分野にかかわらず、幅広い領域でカーボンニュートラル施策の根幹を担っています。

環境

半導体製造装置事業の機会

・新たに生まれるニーズと当社の提供価値

カーボンニュートラルの実現に向けては、新たな課題が生まれるとともに、お客さまからのニーズも絶えず変化していきます。当社は検査装置・加工装置に及ぶ広範な製品群で変わりゆくニーズに総合的に対応し、新たな価値を提供し続けます。

▼詳細は、下記Webサイトを参照ください
半導体製造装置事業の戦略と目標
https://www.accretech.com/jp/sustainability/esg/tcfd.html#tcfd_03

	予想される社会の変化	新たに生まれる課題	当社の提供価値(例)
1	半導体デバイスの生産量増加	検査時間の延伸	プロービングマシンのスループット向上
		半導体製造装置の増設	半導体製造装置の安定供給
2	半導体デバイス設計の複雑化	測定時の発熱量増加	高精度温度制御に対応したプロービングマシン
		加工精度の高度化	高精度な高剛性研削盤、アブレーションレーザダイシングマシン
3	次世代パワー半導体の普及	難削材加工の需要増加	高精度な高剛性研削盤、エッジグラインダ、CMP装置

精密測定機器事業の機会

・新たに生まれるニーズと当社の提供価値

絶えず変化していく社会環境やお客さまニーズに対応しカーボンニュートラルを実現するために、当社は多彩な計測技術・製品を通じ、社会の脱炭素への道のりを支援し続けます。

▼詳細は、下記Webサイトを参照ください
精密測定機器事業の戦略と目標
https://www.accretech.com/jp/sustainability/esg/tcfd.html#tcfd_03

	予想される社会の変化	新たに生まれる課題	当社の提供価値(例)
1	再生可能エネルギーの主力電源化	大型ベアリングの歪み・傾き	高精度計測技術で品質評価
2	蓄電池の普及と増加	電池の性能や信頼性	充放電試験システムによる性能評価試験
3	電動化・デジタル化・自動化	高速制御、高精度、低消費電力、多機能化	精密測定機器による高精度な計測
4	地球温暖化による気温上昇	測定環境の温度変化の拡大	測定環境の温度変化に強い計測製品群
5	航空機の機体構造・エンジン設計の高度化	複雑な三次元形状ゆえに製造精度の確保が困難	高難度領域に対する安定した精度での測定

環境

● リスクに対する戦略

BCP・BCMS強化

気候変動による自然災害などのリスクの高まりに加え、経済安全保障などの観点からも、有事の事業継続ニーズが高まっています。そうした背景を受け、当社では事業継続計画(BCP)および事業継続マネジメント(BCMS)の強化に取り組んでいます。

気候変動に伴う災害激甚化に備え、自社工場の操業停止、サプライヤーや協力会社の被災を想定した計画・マネジメントを実施しています。

Scope3(カテゴリ11)に対する戦略

LCAを元にScope3 カテゴリ1～カテゴリ15を算出した結果、半導体製造装置のカテゴリ1とカテゴリ11のインパクトが最も大きく、全体の70%を超えており、削減取り組みの重要度が高いことが分かりました。

半導体製造工程では、当社製品自体の電力消費に加えて、クリーンルームの維持や温度制御、半導体の洗浄に必要な超純水の製造でもエネルギーが消費されます。

当社としても、製品のフットプリント(専有面積)を削減することにより、製品当たりで必要な空調のエネルギー削減や、半導体の切削・加工をより少量の水(超純水)で行える製品開発などに取り組んでいます。

当社の新製品開発における設計原則には、「コンパクト化」「ライフサイクルでの省エネ設計」「省資源設計」が含まれ、製品開発時に間接排出量に関するCO_2排出も含めたLCAの評価と目標値の設定を行っています。

指標・目標

東京精密グループは、2050年カーボンニュートラルを目指します。

当社単体では、2030年度達成に向けたCO_2(Scope1およびScope2)排出量削減目標を策定しています。

当社が排出する温室効果ガス(GHG)は、工場操業時に使用される購買電力換算分のCO_2が大半を占めるため、省電力に重点を置いた活動に取り組んでいます。

2018年度(基準年)より、設備の見直し、太陽光発電システム導入、低炭素電力導入などでCO_2排出量の削減に取り組みました。しかし、半導体需要の拡大による大幅な生産増や新工場の竣工、新ビジネスの開業などのため、2025年度の当社排出量は12,796t-co_2となりました(2018年度比3.9%増加)。

今後は2030年度の目標値50%削減に向け、さらに省エネルギー活動の推進、太陽光発電システムの増設、非化石証明書の活用などを進めます。

CO_2排出量の実績と2030年度の目標

	2018年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2030年度
	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	目標
排出量(t-CO_2)	12,312	9,524	8,191	8,257	11,598	12,733	12,796	6,156
(2018年度比)	–	22.64%減	33.47%減	32.94%減	5.80%減	3.42%増	3.93%増	50.00%減
電力使用量(MWh)	25,765	28,843	29,835	29,546	37,432	44,065(*)	45,493(*)	–
Scope2削減量(t-CO_2)	–	3,659	5,089	4,929	5,676	5,885	7,266	–

対象範囲:(株)東京精密(単体)
2022年度まで:八王子工場、土浦工場
2023年度以降:八王子工場、土浦工場、飯能工場(7月竣工以降)、二次電池評価センター 福島サイト[旧古殿工場](10月事業譲渡以降)
*自社の太陽光発電設備による発電量を含む(2024年度から)

環境

環境マネジメント

東京精密グループは、環境基本理念「東京精密は、地球環境保全が人類共通の重要課題であることを認識し、開発・設計・生産・サービスの全域において、積極的に環境保全に配慮した行動をとる。」のもと、持続可能な社会の実現に貢献します。

環境基本理念・環境基本方針・環境方針
https://www.accretech.com/jp/sustainability/esg/management.html

環境マネジメントシステム
https://www.accretech.com/jp/sustainability/esg/management.html

環境目標実施計画書／環境管理システムプログラム

環境部会に属する部署では、半導体社・計測社の環境目標を達成するための取り組み内容、期限、評価方法などを明記した環境目標実施計画書と、それに基づき年ごとの実行計画と進捗を記した環境管理システムプログラムを作成しています。

プログラムの結果は、3か月ごとに所属部署長と環境管理責任者に報告され、2025年度には68項目のプログラムのうち62項目が目標を達成しています（達成率91.2%）。

2025年度に実施した環境管理システムプログラム

主な取り組み	プログラム件数
設備効率による電力削減	25
加工・生産時の消費電力削減	13
改善提案・小集団活動による電力削減	6
生産時の水・エア使用量削減	4
有機溶剤使用量削減	2
有害化学物質削減	5
使用ガス代替によるCO_2削減	2
廃棄物削減	7
その他	4

エコファクトリー

製造業である当社グループでは、CO_2排出量の99%以上が工場で使用する電力による他、水資源や廃棄物なども含め、環境負荷のほぼ全てが工場における操業に起因します。そのため、各工場がアプローチを主導することによって、環境負荷低減に関わる活動を推進しています。

地球温暖化防止の推進（脱炭素社会に向けて）

当社が排出するGHGは、工場操業時に使用される購買電力換算分のCO_2がほとんどを占めており、地球温暖化防止対策として再生可能エネルギー電力の調達と省エネルギー推進に重点を置いた取り組みを進めています。

CO_2排出量削減目標と2025年度実績

		Scope1+Scope2 削減（2018年度比）	排出量(t-CO_2)
目標	2025年度	35%削減	8,003
	2026年度	38%削減	7,634
	2030年度	50%削減	6,156
実績	2025年度	3.93%増	12,796

基準排出量（2018年度） 12,312 t-CO_2
2025年度、2030年度目標は2021年設定、2026年度目標は2026年設定
対象範囲：（株）東京精密
八王子工場、土浦工場、飯能工場（2023.7 竣工）、二次電池評価センター福島サイト[旧古殿工場]（2023.10 事業譲受）

当社グループは、長年にわたり独自の目標を定め、生産の拠点である八王子工場・土浦工場の省エネルギー化に取り組んできました。また、日本政府が掲げる2030年度の温室効果ガス削減目標の実現に向け、事業・生産・研究開発活動で使用されるエネルギーを対象に、中長期のCO_2削減目標を設定し、進捗の管理と評価を継続しています。両工場でのCO_2排出量削減は達成できたものの、新工場の稼働や事業拡大により、全社的なCO_2排出量は増加傾向となりました。中長期目標を確実に達成するため、2026年度以降は、高効率機器への更新によるさらなる電力使用量の削減を推進するとともに、再生可能エネルギー、非化石電力の導入を積極的に拡大し、脱炭素化を加速させていきます。

資源循環・廃棄物削減

当社グループの製品・事業活動には、さまざまな資源を使用します。私たちは持続可能な循環型社会の形成に貢献するため、あらゆる資源を有効に活用していくとともに、省資源・廃棄物削減・リサイクルにも取り組むことを環境方針で宣言しています。

廃棄物削減・再資源化

指標・目標値	リサイクル率 95 %以上
実績（2025年度）	リサイクル率 97.5 % 総排出量 1,054 t 再資源化量 1,027 t 最終処分量 27 t

資源利用（紙）の削減（紙購入量生産高原単位削減）

指標・目標値	2024年度比10%削減 基準使用量 0.122 kg/百万円 削減目標 0.110 kg/百万円以下
実績（2025年度）	0.111 kg/百万円

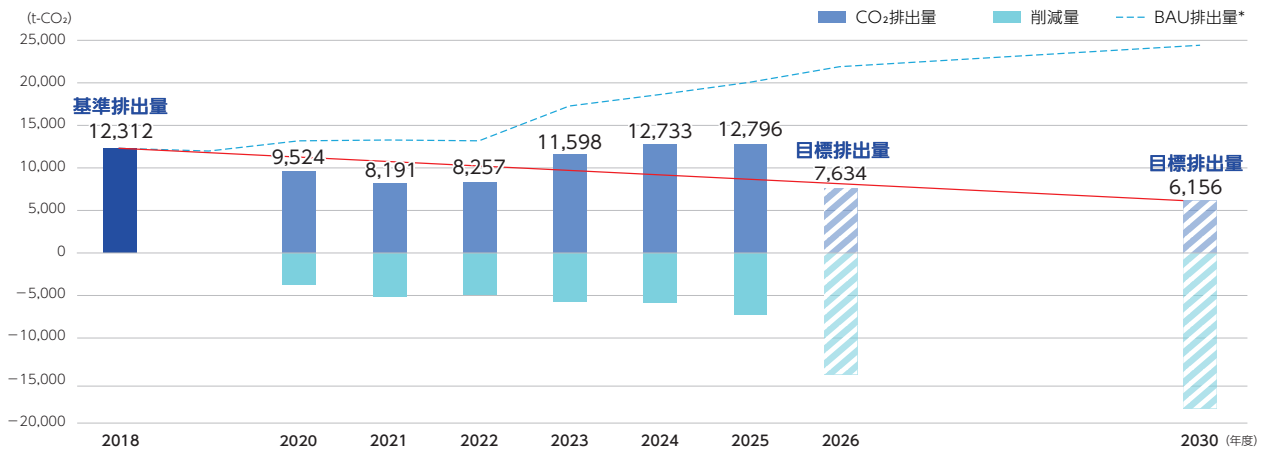
対象範囲：（株）東京精密 八王子工場、土浦工場、飯能工場、二次電池評価センター福島サイト[旧古殿工場]は資源利用（紙）の削減のみ
2020～2024年度期間の計画終了により、新たに2025～2027年度期間の計画・目標を設定

● 廃棄物削減・再資源化

当社では廃棄物を削減するため、納入部品の梱包用ダンボールを通い箱に置き換えたり、木製パレットを運送業者に引き取ってもらうなど、さまざまな取り組みを進めています。各工場で廃棄物の削減・再資源化の目標を設定し、八王子工場ではサーマルリサイクルも含め全ての廃棄物のリサイクル、土浦工場では廃液のリサイクルが可能な処理業者への切り替えなどを実施して、リサイクル率向上を図っています。

環境

Scope1+Scope2のCO_2排出量(削減量)と目標排出量



＊BAU排出量(Business-As-Usual Emissions):特別な削減対策を講じなかった場合の本来の排出量

● 有害廃棄物の管理

当社は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)が定める特別管理産業廃棄物を有害廃棄物として管理しています。2025年度には59,225kgの有害廃棄物全量のリサイクル(リサイクル率100%)を達成しました。水銀灯のLEDへの交換も推進するほか、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特置法)にのっとり、トランスやコンデンサなどPCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処分も完了しました。

● 資源利用(紙)の削減

社内各工程のデジタル化によるペーパーレス化を進めています。2023年稼働の電子取引システム(ACCRETECH Web-EDI System)で発注書や図面などを電子データ化し、2023-2024年度の紙使用量を大幅に削減。これに伴い、2025年度より目標値(生産高原単位)を2024年度比10%削減に設定。2025年度は目標に僅かに届かなかったものの、前年比約9.3%改善しました。今後はシステムの活用拡大とサプライチェーン全体への定着により、さらなるペーパーレス化を推進します。

資源(紙)購入量

	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
紙購入量(kg)	34,234	34,489	24,389	15,106	15,479
生産高原単位(kg/百万円)	0.337	0.310	0.233	0.122	0.111
目標生産高原単位(kg/百万円)	0.421				0.110

対象範囲:(株)東京精密(単体)

水資源

当社グループは、水使用量削減と水リサイクルを推進して水資源保全に取り組んでいます。

水使用量削減(水使用量生産高原単位削減)

指標・目標値	2027年度までに2024年度比10%削減 基準使用量 1.39 m³/百万円 削減目標 1.25 m³/百万円以下
実績(2025年度)	1.52 m³/百万円

純水製造設備の水リサイクル率

指標・目標値	リサイクル率 30 %以上
実績(2025年度)	18.3 %

対象範囲:(株)東京精密 八王子工場、土浦工場、飯能工場、二次電池評価センター福島サイト[旧古殿工場]は資源利用(紙)の削減のみ
2020～2024年度期間の計画終了により、新たに2025～2027年度期間の計画・目標を設定

● 水使用量削減・水リサイクル

当社グループは取水を全て市水と地下水で賄っています。特に八王子工場では、水(純水)を大量に使用する半導体製造装置生産の増加に排水量も追随しているため、排水の一部を回収・ろ過し純水の原水として用いており、今後は水リサイクル率30%への引き上げを目指します。

化学物質管理

当社グループは、使用および部材に含有する化学物質について国内と輸出先地域の法令を遵守し、法規制外の化学物質も自主基準に基づき管理することで、環境や人への影響を最小限に留めています。

● 自主基準に基づく化学物質管理

環境を汚染する可能性のある物質を社内規程で定め、取り扱う場合は環境管理責任者に全て届け出ています。物質ごとに取扱量・保管場所・最大保管量などを把握し、SDS*および緊急対策用具を備え、緊急事態を想定した訓練を定期的に実施。有機溶剤など有害化学物質の削減・代替も進めており、2025年度には目標化学物質削減品目数6に対し54品目を削減しました。

＊SDS(安全データシート):化学物質を提供する際の、危険性・有害性、保管や廃棄法などの取り扱いに関する情報を記載したもの。

環境

エコプロダクツ(製品を通じた環境貢献)

東京精密グループは、安全・品質・高性能かつ環境に配慮した製品を提供することが重要だと考えています。エコプロダクツを提供することで、お客さまの環境課題の解決やカーボンニュートラル実現に貢献していきます。

LCA(ライフサイクルアセスメント)

当社の新製品開発では、設計時にLCA(ライフサイクルアセスメント:製品の原料・製造から廃棄までの各段階における環境負荷をCO_2排出量に換算する算定基準)の目標値を決め、その妥当性を評価機関などによるLCAの実績から評価しています。

既存製品のLCA算出を順次行い、2023年度よりScope3カテゴリ11(自社が販売した製品の使用に伴うCO_2排出量)のシミュレーションを行うとともに、機能向上などによるCO_2排出量削減の評価を行っています。今後も生産効率向上とCO_2排出量削減の両立を実現する改良を行っていきます。

製品含有化学物質管理

当社グループは、環境関連法規制や顧客要求に対応した製品含有化学物質管理の体制を構築するため、サステナビリティ推進室に製品環境推進チームを設置しています。

独自の含有化学物質管理システムを構築しており、製品の含有化学物質と法規制対象の有害物質情報を統合管理することで、変化するグローバルな環境規制に迅速に対応し、サプライチェーン全体での有害化学物質の排除と環境負荷低減を推進しています。サプライヤーに対しては、説明会やコミュニケーションツールを通じて、クラウドサービスによる製品含有化学物質調査への協力を要請しています。また、蛍光X線分析装置やガスクロマトグラフィー質量分析装置などを配備した分析室を有しており、必要に応じた確認を行える体制を構築しています。

● グリーン調達

当社は、2003年4月にグリーン調達ガイドラインを制定、サプライヤーには製品含有化学物質管理に関する取り組みにご協力いただいています。近年、有害化学物質の管理に対する規制が強まる中、2023年度には、ガイドラインを強化したグリーン調達基準も定めました。以来、環境負荷の少なく環境配慮設計がされた部材を優先的に調達する運用に向け、体制構築に取り組んでいます。

● RoHS指令などへの対応

計測社製品については、RoHS指令の6物質および2021年より追加された4種のフタル酸について調査を実施し、100%適合品を出荷しています。半導体社製品は大型据付型産業機器としてRoHS指令適用除外となっていますが、2018年度にRoHS分析室を設置し、調達部材に含有される化学物質の分析を自主的に行っています。

2020年7月からは、POPs規則で追加されたPFOA*1関連物質の使用制限に加え、TSCA-PBT*2規制に対しても全製品が対応しており、同規制が施行されている地域へは100%適合品を出荷しています。

*1 PFOA(ペルフルオロオクタン酸):有機フッ素化合物の一種で、発がん性が指摘されている
*2 TSCA-PBT:米国の有害物質規制法(TSCA)が定める難分解性、高蓄積性、毒性を有する物質

環境負荷低減装置

当社の製品は生産設備の性格上、稼働時間が長く長寿命であることから、CO_2排出量に換算した場合、製品使用時の電力消費がライフサイクル総排出量の多くを占めることになります。

このことから、お客さまのモノづくりの現場での環境負荷を低減する製品の開発・設計に注力しています。

スループット向上による環境負荷低減

半導体製造装置のスループット向上は、生産効率を高めるだけでなく、環境負荷の低減にも直結します。単位時間当たりの処理枚数が増えることで、製品1枚当たりに消費される電力や薬液、純水などの資源量を大幅に削減できます。また、装置の稼働時間を短縮できるため、工場全体のエネルギー効率が向上し、CO_2排出量の抑制にも貢献します。

HRG3000RMⅢ



ウェーハ薄片化時間を約50%短縮
(PG3000RMX比)
ポリッシュ・レス(ケミカル・レス)な加工

AP3000



ロット処理時間を約20%短縮
(UF3000EX比)

環境

脱炭素化に向けた次世代パワー半導体への対応

パワー半導体は、電力変換器に使用されるキーデバイスです。電力消費量を減らし、効率よくエネルギーを使用できるため、電気自動車や鉄道車両、冷蔵庫やエアコン、また風力発電、再生可能エネルギー関連など、さまざまなエレクトロニクス機器に搭載されており、脱炭素社会の実現に向けて必要不可欠なデバイスです。SiCやGaNなどの新素材から作られる次世代パワー半導体は、高耐圧・低損失・高周波動作が可能となり、省エネルギー化への貢献に期待されています。当社グループでは、次世代パワー半導体に対応した製品のラインナップを強化しています。

HRG200X
HRG300



SiC／GaN基板などの
硬脆材料の研削が可能

UF2000



SiC／GaN向けの
高耐圧、大電流に対応した
オプションを用意

ChaMP211
ChaMP232



高圧・高速研磨により
SiCウェーハの研磨レートを向上

精密切断ブレード



SiC向けのブレードを展開

幅広い精度保証温度による環境負荷低減

精密測定機器の高精度な測定を実現するためには、校正室など温度や湿度が厳密に管理された精密空調の環境で測定を行う必要がありました。

SURFCOM NEX 200 HTGオプションでは、測定精度を保証できる温度変化範囲を拡大させ、一般空調環境下での高精度な測定を可能としました。精密空調は一般的な空調に比べ、初期コストが大きく掛かるだけでなく、運用時の消費電力も大きくなります。当社の精密測定機器は、お客さまの測定機使用環境を改善するとともに、精度と信頼性を維持しながら環境負荷の低減にも貢献します。

精密空調
温度変化：0.5℃ /h
校正温度：20℃±0.1℃～±0.5℃

SURFCOM NEX 200
精度保証温度を拡大

一般空調
温度変化：2.0℃ /h
校正温度：20℃±5℃

SURFCOM NEX



SURFCOM NEX 200DX/SD2

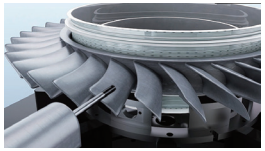
脱炭素化に向けたモノづくりを支える精密測定機器

自動車や航空機など、動力を効率よく細部に伝えるためには、設計通り、規格通りの部品が必要です。部品の寸法や形状、真円度や表面粗さを測定・管理することで、脱炭素化の実現に向けたモノづくりが進められています。

XYZAX AXCEL



XYZAX Opt-BLISK



サステナブルな社会の実現に貢献する二次電池の評価

CO_2を発生させない電気自動車や太陽光発電などの再生可能エネルギーの蓄電に二次電池は欠かせません。この二次電池やキャパシターの研究開発や量産時の品質検査など、幅広い用途で充放電サイクル試験に充放電試験システムが使用されています。



エネルギーシェア式
充放電試験装置

当社の充放電試験システムは、従来も商用電源までエネルギーを回生させていましたが、試験を実施している装置内の複数の電池間や装置間での余剰電力を融通する当社独自の「エネルギーシェア機能」により、最大30%（当社比）の省エネルギーを実現しました。これにより、導入先のお客さまのCO_2排出量や電力コストの削減に貢献します。

サプライチェーンマネジメント

東京精密グループは、原材料の調達から製品の生産、物流、販売に至るサプライチェーン全体を重要な経営基盤と位置づけています。変化する事業環境や社会課題に対応しながら、パートナー企業との協働を通じて安定供給と品質確保を実現するとともに、人権、労働安全、環境保全、コンプライアンスに配慮した責任あるサプライチェーンの構築を推進し、持続可能な社会の実現と企業価値の向上の両立を目指します。

ガバナンス

当社は、責任ある調達活動を推進するための基本方針として「調達方針」を定めています。

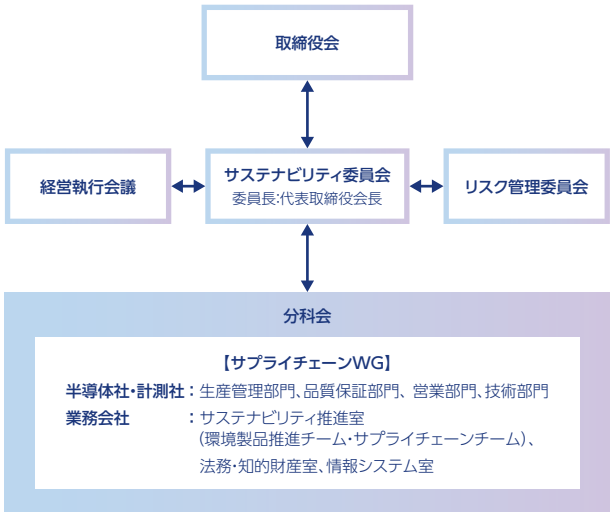
サプライヤーとの信頼関係のもとで持続可能なサプライチェーンを構築するため、サステナビリティ推進室内に「サプライチェーンチーム」を設置し、同チームが主導するワーキンググループ(WG)を中心に活動を展開しています。

サプライヤーとの対話の機会や環境を整備し、課題管理とリスク軽減に取り組むことで、サステナブル調達をさらに推進していきます。

調達方針

お客様に高機能で高品質な製品とサービスを提供するにあたり、全てのサプライヤーの皆様と調達を通じてパートナーシップを深め、相互協力・信頼関係を構築し、共に成長・発展することができる関係を築きます。
品質はもとより法令や社会規範を遵守し、人権・労働、安全衛生、地球環境保全、情報セキュリティなど社会的な責任を果たす調達活動をサプライチェーン全体で取り組みます。
公平・公正な評価プロセスとコミュニケーションを通じて、信頼できる優れたサプライヤーの皆様とともに、市場変化への対応や付加価値の高いものづくりを進めます。

推進体制



サステナブル調達の推進

当社グループは、全てのサプライヤーさまを重要なパートナーと位置づけ、相互の信頼関係と協働に基づくサステナブル調達を推進しています。「調達方針」のもと、当社基準として「東京精密サプライヤーCSRガイドライン」「グリーン調達基準」「情報セキュリティ基準」を策定しました。これらの基準の周知と実践を通じて、サプライヤーとの連携を強化し、サプライチェーン全体で社会的責任を果たすとともに、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

契約書、その他基準の概要

● 取引基本契約書

2024年5月に取引基本契約書を改訂。法令遵守や贈収賄防止、個人情報保護といった基本条項にとどまらず、当社の各種基準(CSRガイドライン・情報セキュリティ基準・グリーン調達基準)の遵守を求める条項を新たに追加しました。

● サプライヤーCSRガイドライン

当社は、サプライチェーン全体で労働環境の安全、労働者の尊厳や環境負荷に対する企業責任など、国際社会の要求に応えるために、RBA(Responsible Business Alliance)への準拠を宣言しています。RBAの行動規範を踏まえ、「調達方針」「人権と労働」「安全と衛生」「環境」「倫理」「安全と品質」「情報セキュリティ」に関する要望を記載した「東京精密サプライヤーCSRガイドライン」を制定しています。

● グリーン調達基準

当社はグリーン調達を推進しており、管理体制の整ったサプライヤーさまから、環境負荷が少なく環境配慮設計がなされた部材を優先的に調達することを示した「グリーン調達基準」を制定しています。本基準は、2003年4月に制定した「グリーン調達ガイドライン」をベースに、強化された環境法規制に対応するため2024年4月に定められました。

サプライチェーンマネジメント

サプライヤーCSR調査

当社グループは、持続可能な社会の実現と中長期的な企業価値向上のため、サプライチェーン全体における環境・社会・ガバナンスのリスク低減に努めています。サプライヤーの環境面および社会面の取り組み状況を確認するために、RBA SAQを参考にしたサステナビリティアセスメントを実施しており、サプライチェーン全体の状況をより正確に把握するため、2023年度以降は調査対象を、購入金額上位80%に該当する主要なサプライヤーさまへと拡大しました。

アセスメント分析結果はサプライヤーさまに個別にフィードバックし、取り組みが不足している項目については是正・改善を要請しています。2025年度は、6社のサプライヤーさまと個別面談（Web面談5社、対面面談1社）を実施し、回答に至った経緯や実情の把握、および具体的な改善策について対話を行いました。

サプライヤーCSR調査の実績

	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
対象社数（社）	56	125	121	116
調達金額割合（%）	26	80	80	80
回答社数（社）	53	113	112	104
回答率（%）	94.6	90.4	92.6	89.7

環境影響（リスク）の抑制・管理

当社は、「環境管理体制調査書」、または「環境管理チェックリスト」を使用して調査・評価を行い、サプライチェーンにおける環境リスクの回避につなげる体制整備と管理をお願いしています。製品製造委託やサービスを委託するサプライヤーさまには、大気汚染・水質汚濁・悪臭防止法・振動騒音施設・特別管理廃棄物など、人の健康または生活環境に関わる調査を2年ごとに実施しています。

サプライヤーとの対話活動

サプライヤーさまとの対話の機会として、サプライヤー説明会を毎年開催しています。本説明会を通じて、当社のサステナブル調達に関する取り組みへのご理解とご協力を求めています。

また、サプライヤーさま主催の研修会にてCSRセミナーを毎年開催しています。2026年5月のセミナーでは、前年の「情報セキュリティアンケート」で判明した課題への対策が着実に進んでいることを共有しました。昨今増加するサプライチェーン攻撃の事例を交え、限られたリソースで効率的にリスクを低減できるよう、費用対効果と即効性の高い具体的なセキュリティ対策を提案しました。



「ASCRet」を活用した対話

双方向のコミュニケーションを可能にする新たなプラットフォーム「ASCRet（アスクレット）」を開発し、2025年7月より導入しました。本ツールは、サステナビリティに関するアンケート調査の実施とそれに基づくフィードバックの共有、各種説明会のご案内、さらに最新の規制・法令情報の発信と適合状況の確認などを一元管理できる実務プラットフォームです。このツールの活用を通じて、より円滑なコミュニケーションを図れる体制の構築を目指しています。

責任ある鉱物調達

当社は、紛争地域および高リスク地域における児童労働や武装勢力の資金源化といった人権・環境リスクを重く受け止め、責任ある鉱物調達に取り組みます。

2026年9月に「責任ある鉱物調達方針」を制定しました。経済協力開発機構（OECD）の「紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」を参考に、鉱物調査を行い、クリーンで透明性の高い調達活動を展開します。

パートナーシップ構築宣言

当社は、「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議*」の趣旨に賛同し、2023年2月1日「パートナーシップ構築宣言」を公表しました。サプライチェーンの取引先の皆さまや価値創造を図る事業者の皆さまと連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップの構築を目指します。

パートナーシップ構築宣言

https://www.biz-partnership.jp/declaration/22838-05-18-tokyo.pdf

* 未来を拓くパートナーシップ構築推進会議
サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を越えた新たな連携を推進する活動。関係閣僚（内閣府、経産省、厚労省、農水省、国交省および内閣官房副長官）と経団連会長、日商会頭、連合会長等がメンバーとなっている。

人権の尊重

東京精密グループは、人権リスクへの対応を持続的な事業活動を支える重要な基盤の一つと捉えています。グローバルな事業展開とサプライチェーンの拡がりに伴い2022年度からは、自社、国内外グループ会社、主要サプライヤーを対象に人権デュー・ディリジェンス(人権DD)を段階的に拡大し、事業活動に関わる人権リスクの把握と評価を進めてきました。
今後は、調査によるリスクの把握にとどまらず、特定した課題への対応とその実効性の確認を重視し、人権尊重の取り組みを事業活動に組み込んでいきます。

ガバナンス

人権方針

当社グループは、事業展開する国・地域における法令・文化・宗教・価値観などを正しく理解・認識し、事業と組織の持続的成長と持続可能社会の実現を目指すことを目的に、2022年10月3日に「東京精密グループ人権方針」を定めました。

人権方針

1. 人権に関する基本的な考え方
2. 国際人権規範の支持・尊重、地域労働法令の遵守
3. 適用範囲
4. 児童労働の禁止、強制労働の禁止
5. 差別の禁止と多様性の受入れ
6. 結社の自由と団体交渉権の尊重
7. ハラスメントの禁止
8. 人権デュー・ディリジェンスと救済
9. 人権教育
10. 情報開示と対話

人権方針全文
https://www.accretech.com/jp/company/humanrightspolicy.html

人権DD

当社グループは「東京精密グループ人権方針」に基づき、グループの事業活動が与える人権へのリスクを特定・防止・是正するために、2022年度から人権DDを実施しています。2025年度には、株式会社東京精密および国内グループ会社4社、海外グループ会社24社を対象とし、Responsible Business Alliance(RBA)行動規範、SAQ(Self-Assessment Questionnaire)を参考に現状調査を実施しました。調査の結果、深刻度の高い人権侵害リスクは認められませんでしたが、従業員の安全面についての検討課題を発見し、改善に向けた取り組みを進めています。

人権DDの基本的な流れ



リスク管理

リスクの特定・評価

当社グループでは、自社、グループ会社およびサプライヤーを対象に、SAQや人権DD質問シート、サプライヤーアンケートなどを活用し、人権への負の影響が生じている、または生じる可能性のある課題を洗い出しています。

抽出した課題については、回答内容を精査し、必要に応じて関係部門や対象先への確認を行った上で、想定される人権リスクを具体化します。その上で、当社が負の影響を「引き起こしている」「助長している」「取引関係を通じて直接結びついている」のいずれに該当するかを整理するとともに、深刻度と発生可能性について評価していきます。

深刻度は「影響の規模」「影響を受ける範囲」「是正の困難度」の3つの観点から分析し、発生可能性と合わせて優先的に対応すべき人権リスクを特定しています。

当社が特定する8つの優先課題



人権の尊重

戦略

当社グループは、「計測で未来を測り、半導体で未来を創る」というパーパスの実現に向け、事業活動を支える持続可能なバリューチェーンの構築と、ステークホルダーからの信用・信頼の獲得を重要な経営基盤と捉えています。

グローバルに事業を展開する中、当社グループのみならず、グループ会社やサプライヤーを含む事業活動全体で人権への負の影響を防止・軽減することは、持続的な事業成長を実現する上で重要性を増しています。

人権DDを通じて人権リスクを継続的に把握し、対話と改善を事業活動に組み込むことで、持続可能で信頼されるバリューチェーンの構築を目指します。

人権リスク防止・軽減の取り組み

● 人権教育・研修

「ACCRETECHグループ行動規範」に明示された、労働基準や労働安全衛生に関する法令・社会的規範の遵守、および人権を侵害する行為の禁止について、当社グループ全体を対象にe-learning教育を毎年実施しています。

また、「東京精密グループ人権方針」の理解と実践を促進するための人権尊重に関する教育・研修も別途設けており、2025年度には国内グループ会社4社を対象に、ハラスメント防止に関するe-learning教育を行いました。

● 通報・相談窓口の設置

当社グループでは、以前より法令違反や不正行為などを通報できる内部通報窓口を設置しています。2025年度のグループ内からの人権に関する通報は0件でした。また、2023年度よりサプライヤー向け外部窓口も設置し、運用を開始しました。

サプライヤー向け人権DDの実施

当社グループは、サプライチェーン全体における人権尊重を重要な課題と捉え、主要サプライヤーを対象とした人権DDを継続的に実施しています。

2025年度には116社を対象に調査を実施し、104社から回答を得ました。その結果、深刻な人権リスクは確認されませんでした。一方、人権や労働安全衛生などの観点から追加確認が必要と判断した項目については、回答内容を精査し、サプライヤーへの個別確認やフィードバックを進めています。

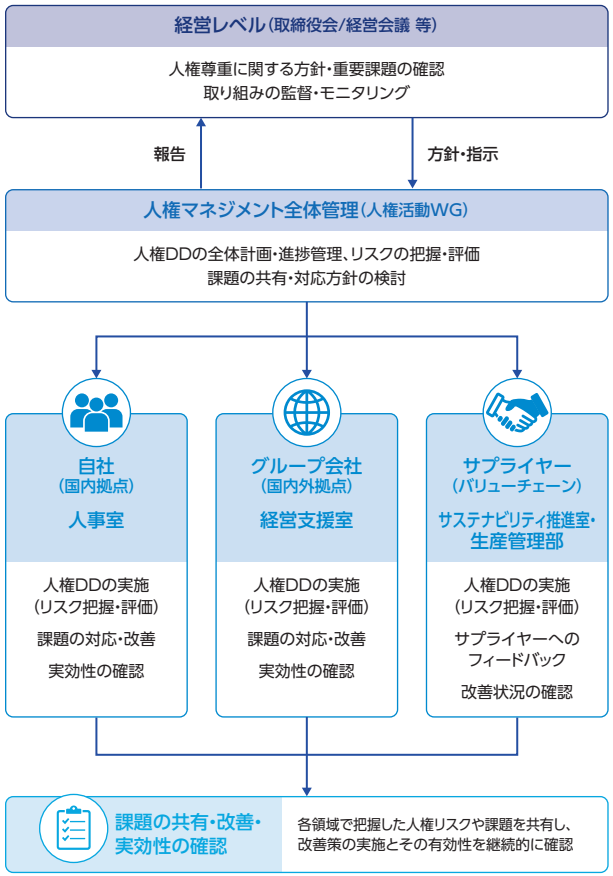
今後は、調査結果の把握にとどまらず、リスクが認められる項目についてサプライヤーとの対話や個別確認を行い、改善状況を継続的に確認することで、サプライチェーン全体の人権リスク低減につなげていきます。

調査対象会社：主要サプライヤー116社
①ACCRETECH協力会 ②2024年度購入金額上位80%
時期：2025年8月18日～2025年9月30日
質問内容：サプライヤーCSRガイドラインおよびRBA行動規範をベースに作成。今回はRBA行動規範Ver.7からVer.8の変更点を反映。
人権DD対象：116社
回答企業：104社
回答率:89.7%

推進体制

当社グループは、事業活動における人権リスクを継続的に管理するため、自社、グループ会社、サプライヤーの各領域を担当する実務部門が人権DDを推進しています。

各領域で把握した人権リスクや課題については、関係部門と共有し、必要な改善を進めるとともに、その対応状況を継続的に確認しています。



社外取締役座談会①

デバイスメーカーと製造装置メーカー、双方向のコミュニケーションを

当社の高増潔、森重哉両社外取締役は、それぞれ精密工学の研究や半導体デバイスメーカーの経営に多大な功績を残された方々です。
そのお二方と吉田均代表取締役会長が、現在当社グループで進められている「精密測定機器事業と半導体製造装置事業の融合」について語り合いました。



顧客ニーズに合致、自信を持って進めてほしい

吉田▶ お二方から見て、「融合」の進捗具合は如何でしょうか?

高増▶ 計測社のカンパニー長が石川さんになったのは、実態的にも社内へのメッセージとしても意味のあることだと思います。もともと半導体のアプリケーションを手掛けていた人で、ユーザーとのつながりが深い。お陰で共通認識が高まって半導体製造装置の開発会議にも計測社の従業員が参加するようになり、双方が意見交換できる場が増えてきました。いくつかの半導体製造装置には既に計測社の技術を取り入れた計測機器が搭載され、実際に発売されています。これは融合の具体的な大きな成果です。

森▶ デバイスメーカーが製造プロセスにおける検査工程で何を測定するかは会社ごとに違い、その情報は外には出てきません。計測機器メーカーには、自分の装置が何の測定に使われているかは実は分からないのです。当社の計測技術がどう活かされているかは、顧客との対話を通じて理解するしかありません。そこに、ユーザーとのつながりが深い石川さんを計測社のカンパニー長に起用した意味があります。

一般的な製造業では精密測定機器は汎用的に使われることが多いのですが、半導体製造の世界では、顧客と会話して意図を汲んだ計測機器を作り、要求にどれだけ応えられるかが重要です。現時点では計測社にはまだ課題があると感じています。最近、半導体社と計測社の営業マンが一緒に客先訪問を行っていますが、これはまだ第一歩です。今後さらなる顧客理解を期待します。

半導体メーカーは生産設備には投資しますが、検査装置については、検査に掛かる時間が時間当たり生産性を引き下げる側面もあるので、必ずしも投資に積極的ではありません。一方で、当社製品のように製造装置に測定機器が組み込まれていれば、工程も伸びないし時間も長くは掛からない。顧客のニーズに合致しています。自信を持って進めてほしいですね。

高増▶ そういう機器の開発に向け、部門間を超えた交流が行われているのは良いことです。両事業では開発に求められる考え方の違いがあります。時間軸的にも、計測機器は時間を掛けて高精度、半導体製造装置の場合はスピード重視と、ニーズの在り方が異なります。そうした要求事項の違いについても、だんだん理解が浸透してきていると思います。

森▶ システム設計などのソフトウェア面でも、双方が一緒に作るようにすると融合に寄与してくれそうですね。

吉田▶ やはり森取締役がお持ちの「ユーザー目線」の発想には重みがあります。そうしたアドバイスを元に、実現するための方向性を理論的に示してくれるのが高増取締役です。この

社外取締役座談会①

二人をアドバイザーに擁しているのは、当社グループにとってものすごい利点となっています。助かります。

そんなお二方にお伺いしたいのですが、半導体製造装置と精密測定機器の融合を加速していくのに、必要なこととは何でしょうか?

デバイスメーカーに人を送り、5年10年先のための開発を

高増▶ 短期的な開発と同時に長期的な研究戦略を考えていく必要があり、その際には外部の大学や研究機関、学会との連携が重要です。実際に、当社グループの計測関係の研究者は、大学の先生とコンタクトを取っていますね。双方、いろいろな刺激を受けているようです。

吉田会長が精密工学会の会長に就任されたことも大きい。大学や研究機関との人的交流も進むし、会社のアピールにもなります。ちょうど精密工学会は半導体製造にもこれから力を入れるところですので、良い流れです。

森▶ 顧客とのコミュニケーションをさらに進めるために、デバイスメーカーに当社グループのエンジニアを出向させられないでしょうか。先端を行くデバイスメーカーには、自分たちが使いやすい装置を自主開発してきた歴史があります。製造装置メーカーと一緒になって開発するのは、デバイスメーカーの要望でもあるのです。



吉田▶ 企業機密の面は大丈夫なのですか?

森▶ 秘密保持契約は当然結びますが、実際に人を受け入れていますよ。

吉田▶ 実は大手自動車メーカーとはそういうことをしています。顧客の計測技術部に毎年人を送り、現状の課題をいち早く聞き、将来に必要な機器を開発したり。半導体デバイスでも可能なのですか。



森▶ 私は積極的にやっていましたよ。こういうことは、製造装置メーカーがどれだけ乗り気になってくれるかにもよります。デバイスメーカーと製造装置メーカー、双方のコミュニケーションで進む類の話です。

吉田▶ ぜひやりたいですね。実現すれば、5年先、10年先に向けた開発ができます。向こうから相談が来る時というのは、大抵が目の前で必要なものの話で、将来に向けた要素技術開発などは双方向のコミュニケーションからしか出てきません。

高増▶ 欧州のベンチャーだと一番優秀なエンジニアは顧客のところに行きますし、さらにアメリカの大学は、それを仕組みとして作っています。

吉田▶ ある大きなテーマについて、複数のメーカーや大学から人を集めて共同開発できるとよいですね。精密工学会でもそういうことが必要と言っているのですが、そのような産学官の連携は日本のものづくりの発展につながると思いますし、手掛けていかないと駄目なんじゃないでしょうか。

人財確保に向け、人的資本投資の強化を

吉田▶ 一方で、取締役という経営を監督する立場としては、シナジーを発展させるためにどうすべきだと思われますか?

高増▶ 予算と人員の計画をきちんと立案・実行できるように、取締役会で必要な議論を随時行っていくことが第一だと思います。開発のスピードが思ったほど出ない要因のひとつは人員不足、特に優秀な研究者の不足だと聞きます。中でも経験者の中途採用は厳しい。

優秀な人財の確保・定着に向け、さらなる人的資本等を充実させていくのがよいのではないでしょうか。

あとは品質管理ですかね。十分過ぎるほど慎重に取り組むぐらいでちょうどよい。リスクマネジメントの一環として取締役会でも注目していきたいと思います。



森▶ 人財確保という面では、女性エンジニアをどう採用し育てるかがとても重要です。福利厚生の充実に加え、産休が昇進に影響しないような体制づくりが求められます。海外人財の活用も課題で、社内がグローバルになっていかなければなりません。そうしたダイバーシティの進展については、取締役会で今後もチェックしていきます。

吉田▶ お二方には、取締役会に限らず年2回のグループ経営審議会にも出ていただいていて、会社にとってはものすごくプラスになっています。感謝しかありません。今後もぜひアドバイスを続けていただければ幸いです。

社外取締役座談会②

大きなアクシデント処理を、さまざまな助言でサポート

当社グループの持続的成長のためには、コーポレート・ガバナンスの充実が不可欠です。そこで今回、監査等委員をお願いしている社外取締役3名と吉田均代表取締役会長が集い、ガバナンスの現状と未来について語り合いました。



社外取締役
相良 由里子



社外取締役
川﨑 素子



社外取締役
髙山 清子



代表取締役会長
吉田 均

グローバル内部監査の体制を強化

吉田▶ まずは当社のガバナンスや取締役会の実効性について、最近進歩が見られたことを教えてください。

髙山▶ 取締役会の構成バランスがダイバーシティ面やスキル面を含め良くなってきており、苦労してこういう形を作ってこられたのだと感じます。議論もオープンで皆さん活発に発言されており、議事運営もスムーズです。

内部監査の体制強化も進んできました。人員も増員され、過去に内部監査の実績が無い事業所やリスクが高い事業所を優先に、海外を含め細かく監査した上で、取締役会に詳しく報告していただいていることは、我々社外取締役にとっても有意義だと思います。

相良▶ 内部監査室の充実は特筆すべきですね。人員も増え、評価基準や監査のポイントも整理されてきました。監査品質が維持向上できる体制づくりが整ってきたと思います。今後もこの品質で監査を進めていただきたいです。

川﨑▶ 中長期の視点を交えて議論することも増えてきました。新規事業に関する議論の他、各事業のカンパニー長が発表する戦略のたたき台を元に、当社の持続的成長に向けた議論を取締役会で行おう、という話も出てきています。

吉田▶ ダイバーシティについては、バランスは良くなってきていると思います。社内取締役ですが外国人も一人配しており、日本人以外から見たらどう見えるか、という視点を期待しているところです。内部監査には、グローバル監査を含め体制を強化しシステマティックに取り組んでいますので、それをちゃんと評価していただけているのは嬉しいですね。また、中長期的な事業戦略を立案する「事業戦略室」という組織を社内で作り、定期的に取締役会で報告する体制を作りましたが、川﨑さんに評価していただいていて、作った甲斐がありました。

ところで、取締役会での最近の議論や報告については如何ですか？　印象に残っていることがあれば教えてください。

セキュリティインシデントには、トップ自らが舵取り

髙山▶ 私は会計が専門ですので、適正な在庫水準について議論したことが印象に残っています。在庫が最近増えてきているので、どの程度が適正かという判断は難しいが会社全体でチェックする目安を設けたらどうか、と申し上げ、取締役会でも議論しました。その後、経営執行会議の方で具体的な資料を作成する、という形で応えていただいています。セキュリティについても最近、いろいろ議論がありました。

相良▶ 最近起こったセキュリティインシデントに対する対応については、毎回の取締役会で報告してもらっていますが、必要な対応を世界中の子会社に徹底されることが必要であるところ、木村社長ご自身が迅速な対応の徹底を指示されていました。情報セキュリティの徹底については、トップ自らが危機感を持って舵取りをすることが重要だと感じました。

川﨑▶ 会社として真摯に動き、再発防止策を含め継続的に報告があるのは良いことですね。他にも、取締役会では投資案件が審議事項としてしばしば出てくるのですが、個別の案件だけ

社外取締役座談会②

でなく全体戦略の中での位置づけを示すよう要望したところ、今後の成長の方向性、どういう投資をどのタイミングで行うのかの方針、今回の投資はそのうちのどれに当たるのか、についてすぐに明確化していただけました。方向性や中長期プランを踏まえて議論することが重要ですので、今後もこういった動きを大事にしていただきたいです。

吉田▶ ありがとうございます。今日集まっていただいたお三方には、会計士、知財関係の弁護士、ガバナンスやコンプライアンスに長けた企業人という特徴があり、いつもそれぞれの専門性や視点に基づきいろいろなアドバイスを貰っています。今話題に出たセキュリティインシデントは最近では一番大きなアクシデントだったのですが、いろいろなご教示をいただきました。

インシデントの話や、先ほど出た内部監査の話もそうですが、ガバナンスやリスク管理の領域というのは今や、本社や国内には限りません。当社のグローバル・ガバナンスについては、皆さんはどう評価されていますか?

海外グループ会社の統廃合が着実に進展

相良▶ 海外現地法人の統廃合については高く評価しています。ネットワークが拡がり過ぎてグリップが効かなくなるリスクが整理され、きちんと目が届く体制づくりが進んできました。今後は、各社の実質的なガバナンスを整えることが必要でしょう。人財育成面からもガバナンス面からも、さらには、当社のポリシーを浸透させていくという観点からも、重要な海外の現地法人に当社から人財を派遣する動きを推進すべきと思っています。

川﨑▶ 内部監査についても、海外現法に当社の内部監査室の方が出向いたり、現地のスタッフを上手く活用したりして、細かく見られるようになってきたとのこと。会計・経理やコーポレート周りを管理できる日本の従業員を現地に送る動きもあり、何かが起こってもその人を中心に事態のグリップが効く形になってきました。あとは、各社の会計システムなど基幹システムの連携、統合化により、グループ全体を見渡せるように改良し、売上、在庫情報も含めてリアルタイムで情報を掴めるようになれば、なお良いですね。

髙山▶ グループの統合が着実に進捗しており、本社が全ての海外子会社をコントロールし、重要な拠点へは本社から人を派遣する、という方向性が明確な点を評価しています。本社の管理部門が海外子会社をきちんとサポートしていく体制整備に、着実に取り組んでいただきたいと思っています。

吉田▶ 基本的には、各エリア1社体制にしたいと思っています。何社も子会社や孫会社があると見えづらいですから。その上で、本社から各拠点に1人ずつ配置し、お金や在庫の流れを見えやすくしていきます。監査についても、こちらからチェックするだけでなく、現地の要望や考え方も汲み上げられる機会を作りたいですね。

議論の質をより高めていくために

吉田▶ 最後に、長い目で見たガバナンスの話をお伺いします。取締役会で担うべきガバナンスについてはいろいろ考えるべきことがありますが、4～5年先ならともかく、10年先を読むのは難しい。皆さんは、中長期的に見たガバナンスの在り方についてどうお考えでしょうか?

髙山▶ 毎月の取締役会は審議事項や報告事項も多く、あまり時間的余裕がありませんが、その中でも中長期的な議論の機会を増やしていただけるとありがたいですね。また、外部の有識者を招いた勉強会などインプットの機会も増やしていただけると、中長期的な視点の取り込みに役立つと思います。

相良▶ この点は以前から何度も申しあげておりますが、中長期のガバナンスについて考えた時に、とりわけ重要なのは後継者人財の育成だと思っています。10年後、20年後に当社を正しく経営してくれる人財です。長期戦略検討会のような社内の場での議論が活発になっていくことが人財育成につながり、そういう人たちと我々社外取締役とが一緒になって考えていくことができればよいと思っています。

川﨑▶ 取締役会のアジェンダについては、細かいことは少し執行側にお任せして数を減らすことも、取締役会の議論の質を上げるためには必要ではないかと思います。取締役会で議論して中長期の方向性を定め、それに従って業務の進捗を確認するなど、大きな方向性、会社にとっての重要事項に絞っていくことも検討すべきだと思います。

吉田▶ 今日のお話をいろいろ伺っていて、社外取締役の皆さんも我々社内取締役と同じような課題認識、方向感を持たれていることが分かったことは収穫でした。課題はいろいろありますが、定期的に取締役会に進捗報告を行いますので、今後とも良きアドバイスをお願いします。

取締役・執行役員 (2026年6月22日現在)



吉田 均
代表取締役　会長

所有株式数　9,700株

1983年 4月　当社入社
2002年 4月　計測社執行役員
2005年 6月　取締役に就任
2007年10月　計測社執行役員社長
2011年 6月　代表取締役に就任
2015年 4月　代表取締役社長CEOに就任
2022年 4月　代表取締役会長CEOに就任
2025年 6月　代表取締役会長(現任)



木村 龍一
代表取締役　社長CEO

所有株式数　3,612株

1986年 4月　当社入社
2005年 4月　半導体社執行役員
2005年 6月　取締役に就任
2007年 8月　半導体社執行役員社長
2011年 6月　代表取締役に就任
2015年 4月　代表取締役副社長COOに就任
2019年 4月　半導体社カンパニー長
2022年 4月　代表取締役社長COOに就任
2025年 6月　代表取締役社長CEOに就任(現任)



伯耆田 貴浩
取締役
半導体社
執行役員カンパニー長

所有株式数　3,600株

1995年10月　当社入社
2010年 4月　半導体社執行役員
2012年 4月　半導体社技術部門テスト技術部長
2014年 4月　半導体社執行役員常務
2015年 6月　取締役に就任(現任)
2023年 7月　半導体社技術部門長
2025年 4月　半導体社執行役員カンパニー長(現任)



秋本 伸治
取締役

所有株式数　2,712株

1987年 4月　当社入社
2000年 4月　企画部人事企画室長
2002年 4月　業務会社人事室長
2007年 4月　業務会社執行役員人事室長
2018年 6月　監査役に就任
2019年 6月　取締役(監査等委員)に就任(現任)



ロミ プラダン
取締役

所有株式数　300株

1991年 1月　米国California Energy Commission入社
1992年10月　(株)ブリヂストン入社
2000年 8月　米国Teradyne Inc.入社
2001年 3月　ACCRETECH AMERICA INC.(当社米国子会社)入社
2012年 4月　同社取締役副社長
2013年 4月　当社半導体社執行役員 兼 World Wideアカウント統括(現任)
2016年 6月　ACCRETECH AMERICA INC.プレジデント(現任)
2023年 6月　当社取締役(非常勤)に就任(現任)

取締役・執行役員



高増 潔
社外取締役

所有株式数　— 株

1982年 4月　東京大学工学部精密機械工学科助手
1987年10月　東京電機大学工学部精密機械工学科助教授
1990年 3月　英国ウォーリック大学客員研究員
2001年11月　東京大学大学院工学系研究科精密機械工学専攻（現、精密工学専攻）教授
2020年 3月　公益社団法人精密工学会会長
2020年 6月　当社取締役（監査等委員）に就任
　　東京大学名誉教授（現任）
2021年 6月　当社取締役（非常勤）に就任（現任）



森 重哉
社外取締役

所有株式数　— 株

2014年 4月　（株）東芝 大分工場 工場長
2016年 4月　（株）ジャパンセミコンダクター取締役社長
2021年 6月　（株）ニューフレアテクノロジー常勤監査役
2023年 6月　当社取締役（非常勤）に就任（現任）



相良 由里子
社外取締役

所有株式数　— 株

2001年10月　弁護士登録　中村合同特許法律事務所入所
2005年 8月　弁理士登録
2013年 1月　中村合同特許法律事務所パートナー（現任）
2019年 6月　当社取締役（監査等委員）に就任（現任）
2021年 6月　日油（株） 社外取締役（監査等委員）（現任）



川﨑 素子
社外取締役

所有株式数　— 株

2016年 6月　富士フイルムホールディングス（株）
　　経営企画部CSRグループ長
　　富士フイルム（株）CSR推進部長
2019年 6月　富士フイルムホールディングス（株）
　　執行役員ESG推進部長兼総務部長
　　富士フイルム（株）執行役員ESG推進部長
2021年 6月　富士フイルムホールディングス㈱常勤監査役（現任）
　　富士フイルム（株）常勤監査役（現任）
2024年 6月　当社取締役（監査等委員）に就任（現任）



髙山 清子
社外取締役

所有株式数　— 株

1997年 4月　（株）荏原製作所入社
2001年10月　監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人トーマツ）入所
2005年 7月　公認会計士登録（日本公認会計士協会東京会所属）
2019年 1月　髙山清子公認会計士事務所 代表（現任）
2020年 1月　リーガレックス合同会社業務執行社員
2022年12月　（株）SHOEI社外取締役（現任）
2024年 6月　（株）MIXI社外監査役（現任）
2025年 6月　当社取締役（監査等委員）に就任（現任）

カンパニー制および執行役員体制

半導体社					
カンパニー長	伯耆田 貴浩	執行役員常務	酒井 広幸	執行役員	坂田 亮
執行役員常務	久保 祐一	執行役員	ロミ プラダン		
執行役員常務	金澤 雅喜	執行役員	ティー ケン ホイ		
執行役員常務	井出 良一	執行役員	赤田 幸治		

計測社			
カンパニー長	石川 一政	執行役員	菊田 徹也
執行役員常務	藤田 太一	執行役員	外川 陽一
執行役員	増田 岳史	執行役員	増田 光
執行役員	小野 睦		

業務会社	
カンパニー長	加藤 朝史
執行役員常務	小泉 公人
執行役員	猪瀬 朋子

コーポレート・ガバナンス

東京精密グループは、国際社会から信頼される企業市民として、公正で透明性の高い経営活動を展開するためのコーポレート・ガバナンスの充実が不可欠と認識し、「コーポレート・ガバナンス基本方針」の下、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制、システムの構築を目指しています。

コーポレート・ガバナンス基本方針

1. 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
2. 株主の権利を尊重し、株主の平等性の確保に努めます。
3. 中長期的な株主利益を尊重する投資方針の株主との建設的な対話に努めます。
4. 株主以外のステークホルダー(お客さま、仕入先、従業員、債権者、地域社会等)との適切な協働に努めます。
5. 適切な情報開示と透明性の確保に努めます。

コーポレート・ガバナンス基本方針全文
https://www.accretech.com/jp/company/basicpolicy.html

コーポレート・ガバナンス体制

当社は、監査等委員会設置会社という形態を採用しています。取締役会において付議基準に該当しない事項は、当社関連諸規程によって職務の範囲や権限を定めた上で、意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を採用し、各カンパニー長に多くの権限を委譲しています。また、経営執行会議においてカンパニー横断的な情報共有化と審議充実を図るとともに、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会等カンパニー横断的な各種委員会を設け、重要課題に対してさまざまな観点から検討・モニタリングを行い、適正な意思決定に努めています。

取締役会

当社の取締役会は6名の監査等委員ではない取締役（うち2名は社外取締役）と4名の監査等委員である取締役（うち3名は社外取締役）で構成され、取締役会議長は、代表取締役会長が務めています。毎月1回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会も開催されます。

取締役会では、法令・定款・取締役会規程などに定められた経営に関する重要事項や月次・期次・年次などの業務実績などについて審議を行うとともに、取締役相互の業務執行状況を監督します。

●2025年度の主な審議内容

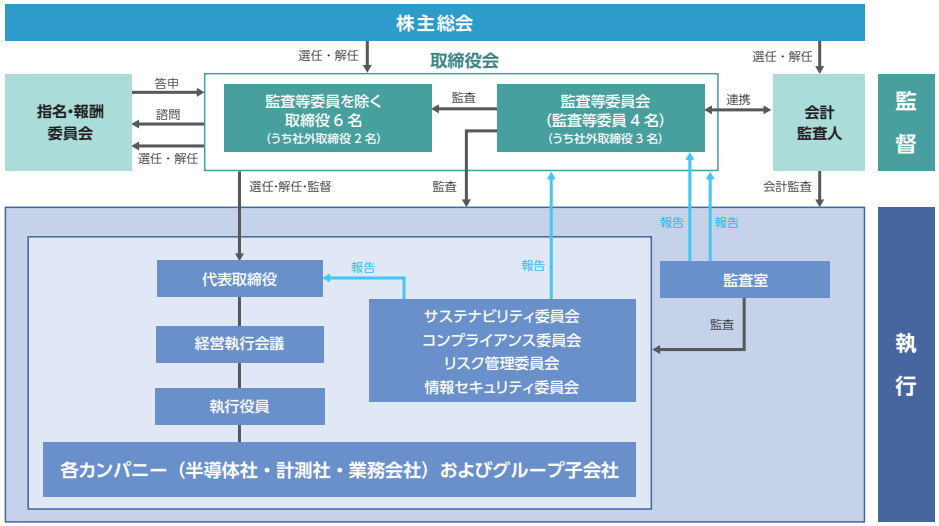
<事業ポートフォリオマネジメント>
・業務計画(開発・設備・人員・経費等など)

<サステナビリティ>
・サステナビリティ委員会の2024年度活動実績報告
・サステナビリティ委員会報告

<全社的なリスク管理>
・「コンプライアンス委員会」と「リスク管理委員会」の2024年度下期活動報告および2025年度上期活動計画
・「コンプライアンス委員会」と「リスク管理委員会」の2025年度上期活動報告と2025年度下期活動計画
・懲戒委員会の新設およびコンプライアンス委員会の役割変更

<その他>
・「コーポレート・ガバナンス報告書」開示
・取締役会の実効性評価
・IR活動報告

コーポレート・ガバナンス体制



コーポレート・ガバナンス

監査等委員会

当社の監査等委員会は取締役会と並列の組織として、社内監査等委員1名および社外監査等委員3名から構成されています。監査等委員のうち1名は財務・会計に関する相当程度の知見を有する者です。監査等委員は年間を通じ、取締役会をはじめとする重要会議への出席、業務執行状況の聴取、重要決裁書類の閲覧といった手続きを通じて会社の行う業務執行、会計処理、財産管理などに関し監査を行い、法令違反、忠実義務違反などの行為の有無のチェックを行っています。また、内部監査部門である監査室ならびに会計監査人と、それぞれ随時監査体制や監査上の問題点の有無、課題などについて意見交換を行い監査の実効性を高めるよう努めるとともに、年間の監査計画に基づき実施する内部監査の所見や関連情報について定期的に報告を受ける体制となっています。

経営執行会議・執行役員会

当社は、製品開発計画におけるスピーディな意思決定や市場動向への迅速かつ柔軟な対応等のため、執行役員制度を採用しています。月1回の定例の経営執行会議や執行役員会議により、業務計画の進捗状況について監督等を行う他、経営執行会議においてカンパニー横断的な情報共有化と審議充実を図っています。

指名・報酬委員会

取締役会機能の独立性・客観性と説明責任を明確化することを目的に、役員指名や取締役報酬に係る事項に関する任意の委員会として設置しています。委員は監査等委員である取締役および社外取締役で構成し、独立社外取締役が過半（現在は全委員5名中全員が独立社外取締役）を占め、経営から独立した立場で審議を行います。

■機能

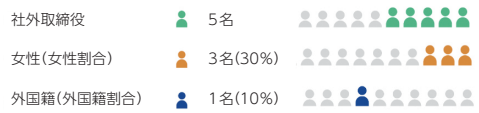
・取締役の選任、解任等の役員指名に係る事項の審議と取締役会への答申
・取締役報酬に係る役位別報酬基準額などの審議と決定
・役員報酬の方針等に係る事項に関する審議と取締役会への答申

取締役会、委員会の構成および活動実績

	構成			開催回数（2025年度）
	議長・委員長	社内取締役	社外取締役	
取締役会	代表取締役会長	5名*	5名**	16回
監査等委員会	社内取締役	1名	3名	14回
指名・報酬委員会	社外取締役	0名	5名	6回

* うち常勤監査等委員 1名　** うち監査等委員 3名

取締役会の多様性



取締役会の構成（スキル・マトリックスと出席の実績）

	年齢	取締役会出席状況	社外取締役ダイバーシティ	主な職歴	取締役会	監査等委員会	指名・報酬委員会	専門性・経験など								
								企業経営・経営戦略	業界知見	技術・知的財産・製造	営業・マーケティング	国際ビジネス・グローバル経験	財務・ファイナンス	法務・リスクマネジメント	人事・労務・人財開発	IT・情報システム
吉田 均	66	16回/16回		計測技術	○			○	○	○	○	○				○
木村 龍一	63	16回/16回		半導体営業	○			○	○		○	○				
伯耆田 貴浩	64	16回/16回		半導体技術	○				○	○	○	○				○
ロミ プラダン	57	16回/16回	●	現地法人経営	○			○	○		○	○				
高増 潔	71	16回/16回	◎	学者	○		○		○	○		○				
森 重哉	66	16回/16回	◎	会社経営	○		○	○	○	○		○				
秋本 伸治	62	16回/16回		人事	○	○								○	○	
相良 由里子	51	16回/16回	◎○	弁護士	○	○	○			○		○		○		
川﨑 素子	65	16回/16回	◎○	会社経営	○	○	○	○						○		
髙山 清子	51	*12回/12回	◎○	公認会計士	○	○	○						○	○		

年齢：2026年6月末時点
独立社外取締役：◎　女性：○　外国人：●
(注1)本マトリックスは各氏の経験などを踏まえ、より専門的な知見を有する分野、より活躍を期待する分野を表しているもので、有する全ての知見を表すものではありません。
(注2)取締役会出席状況は2025年度のものです。
* 2025年6月23日開催の第102期定期株主総会において新たに選任されましたので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しています。

コーポレート・ガバナンス

役員報酬

当社は「コーポレート・ガバナンス基本方針」において、役員の報酬等の額の決定に関する方針および手続を定めています。

コーポレート・ガバナンス基本方針全文
https://www.accretech.com/jp/company/basicpolicy.html

基本方針

1. 企業理念実現に向けて適切に機能することを目的とします。
2. 各役員が担う役割・責任や成果に応じた報酬体系とします。
3. 業績および中長期的な企業価値・株主価値向上を動機付ける報酬体系とします。
4. 経済情勢や当社業績、外部調査等を踏まえ、適時適切に見直しを行います。
5. 客観性・透明性の高い決定プロセスとします。

報酬体系

監査等委員でなく社外取締役でない取締役（以下、「業務執行を担う取締役」という）の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と変動報酬である「業績連動賞与」「株式報酬」で構成します。

監査等委員および社外取締役の報酬は、業務執行の監督および監査の職責に鑑み、「基本報酬」のみとします。

取締役に対して支払う「基本報酬」は、在任中に毎月支給する固定金銭報酬とします。基本報酬と業績連動賞与を合わせた年間支払総額は株主総会で承認された上限額の範囲内とします。「基本報酬」は、個々の取締役に対し、役位別報酬基準額*に基づき支給します。

＊ 役位別報酬基準額：代表取締役社長を基準として役位に応じて定める報酬割合に基づく報酬額で報酬案検討会が策定し指名・報酬委員会にて決定

業務執行を担う取締役に対して支払う「業績連動賞与」は、在任中毎年一定の時期に支給する短期業績連動金銭報酬とします。基本報酬と業績連動賞与をあわせた年間支払総額は株主総会で承認された上限額の範囲内とします。個々の業務執行を担う取締役に対して支払う「業績連動賞与」は、以下の算式で算出します。

【業績連動賞与】
基本賞与支給額×会社業績係数×カンパニー業績係数等

基本賞与支給額：連結当期純利益×0.6%×基本報酬割合
基本報酬割合：業務執行を担う取締役の基本報酬総額に占める各取締役の基本報酬の割合

会社業績係数：年度営業利益計画の達成状況に対応した係数
計画比±10%以下：1／+10%超30%以下：1.1／+30%超50%以下：1.2／+50%超：1.3／−30%以上−10%未満：0.9／−50%以上−30%未満：0.8／−50%未満：0.7
（但し前年度比減益の場合は1以下とします）

カンパニー業績係数等：カンパニー業績、その他事項での顕著な実績を総合評価（0.9〜1.1）

業務執行を担う取締役に対して支払う「株式報酬」は、株主との利益共有可能な中長期インセンティブとして支給します。株式報酬は第1給付および第2給付により構成されており、取締役に対しては役員株式給付規程に基づいてポイントが付与され、一定の要件を満たした場合に保有ポイント数に応じて1ポイント当たり当社株式1株に換算された株式等が給付されます。当社の取締役に付与されるポイントの合計は株主総会で承認された上限の範囲内とします。個々の業務執行を担う取締役に対して付与するポイントは、第1給付と第2給付それぞれについて、以下の通り算出します。

【株式報酬】
第1給付のポイント
　役位別に定めるポイント
第2給付のポイント
　役位別に定めるポイント×資本効率係数×ESG係数×中期業績係数

役位別に定めるポイント：役位別報酬基準額を参考に報酬案検討会が策定し指名・報酬委員会で決定

資本効率係数：直近3年平均連結ROE15%以上：1.2／同10%以上15%未満：1／同10%未満：0.8

ESG係数：ESG活動への取り組み状況を評価（指名・報酬委員会による評価 0.9〜1.1）

中期業績係数：中期営業利益目標の達成状況に対応した係数
基本係数：1／中期営業利益目標達成時：2

報酬決定プロセス

I. 取締役会は、取締役報酬について、代表取締役と取締役の一部で構成する報酬案検討会を設置し、報酬体系案や役位別報酬基準案等の策定を委嘱します。
II. 報酬案検討会が策定した取締役報酬案等（役位別報酬基準額等）および各取締役の基本報酬、業績連動賞与、株式報酬は、透明性・客観性を高めるため、監査等委員および社外取締役で構成する指名・報酬委員会で協議の上決定します。
III. 監査等委員である取締役報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定します。

コーポレート・ガバナンス

提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額（百万円）	報酬等の種類別の総額（百万円）					対象となる役員の員数（名）
		基本報酬	業績連動報酬	譲渡制限付株式報酬	株式給付信託（BBT）	左記のうち非金銭報酬等	
取締役（監査等委員および社外取締役を除く）	481	147	148	8	177	185	6
取締役（監査等委員）（社外取締役を除く）	23	23	－	－	－	－	1
社外取締役	42	42	－	－	－	－	6

（注）1. 社外取締役の員数には、2025年６月23日開催の第102期定時株主総会終結の時をもって退任した２名が含まれています。
2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の限度額は、第101期定時株主総会（2024年６月21日開催）において、年額700百万円以内（うち社外取締役は70百万円以内）と、別枠として業績連動型株式報酬制度「株式給付信託」（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の導入が決議されています。非金銭報酬等は、報酬の対象期間に応じて、複数年にわたって費用を計上する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託」および譲渡制限付株式報酬の当事業年度の費用計上額です。当該株主総会終結時の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は８名（うち社外取締役は２名）です。
3. 監査等委員である取締役の報酬の限度額は、第96期定時株主総会（2019年６月24日開催）において、年額60百万円以内と決議されています。当該株主総会終結時の監査等委員である取締役の員数は４名です。
4. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別報酬は、報酬の基本方針・体系・決定プロセスに基づき、指名・報酬委員会での諮問を受けて取締役会で決定されており、基本方針に沿うものであると判断しています。
5. 業績連動報酬に係る指標は、株主の皆さまへの利益還元に直結する親会社株主に帰属する当期純利益によっています。

提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名	連結報酬等の総額（百万円）	役員区分	会社区分	連結報酬等の種類別の額（百万円）				
				基本報酬	業績連動報酬	譲渡制限付株式報酬	株式給付信託（BBT）	左記のうち、非金銭報酬等
吉田 均	169	取締役	提出会社	53	54	2	59	61
木村 龍一	189	取締役	提出会社	60	61	2	65	67

（注）1. 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。
2. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

関連当事者取引等

当社は、コーポレート・ガバナンス基本方針（7）関連当事者取引等において、取締役や主要株主等と、当社や株主共同の利益を害する取引を行いません。取締役が、自己または第三者のために当社と取引を行おうとする場合は、取締役会規程に基づき、取締役会の事前承認を得るとともに、その取引についての重要な事実についても取締役会に報告し、取引条件等については、第三者の取引と同様に決定することとしています。

取締役による利益相反取引の有無を把握するため、取締役およびその近親者（二親等内）と当社グループとの間の取引（役員報酬を除く）の有無を毎年定期的に確認しています。

当社が主要株主等の関連当事者と取引を行う場合は、取締役会が定める社内規程に従い、重要性や取引規模に応じて権限を有する者が事前に承認を行います。

政策保有株式

政策保有株式については、取締役会においてリスク／リターンを踏まえた中長期的な経済合理性の視点および保有目的、信用状態などの定性面から総合的に検証しています。検証を行った結果、保有意義が認められない政策保有株式については、原則として縮減する方針ですが、中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合には保有することとします。その結果、2015年4月より2026年3月までの間に政策保有株式（みなし保有株式を含む）21銘柄を8,781百万円で売却しています。

コーポレート・ガバナンス

取締役会の実効性評価

当社は取締役会の機能向上のため、毎年、取締役会の実効性に関する評価と今後の対応を検討しています。

全ての取締役（監査等委員であるものを含む。）に、以下の項目を内容とするアンケートを実施し、この回答結果のまとめと分析結果を、社内取締役間ならびに社外取締役間の討議を経て、取締役会で討議を行い、当社取締役会の実効性に関する評価と今後の対応を検討しました。

なお、アンケートの作成、アンケート結果のまとめと分析に当たっては、外部機関を活用することで透明性および実効性を確保しています。

【2025年度アンケート項目】

7項目全25問

- 取締役会の役割・機能
- 取締役会の規模・構成
- 取締役会の運営
- 内部統制等の整備
- 社外取締役の活用
- 株主・投資家との関係
- 総括

アンケートにおいては、項目ごとの評価に加え、当社取締役会の強みや改善すべき事項に関するコメント、各取締役自身の取締役会への貢献に関する反省点、その他自由な意見や提案を各取締役から求める形式を採用しています。

取締役会の実効性に関する分析・評価の結果

当社取締役会は、多様な知識・経験を持つメンバーがバランスよく配置され、社外取締役からも独立した立場から積極的かつ自由闊達に意見、質問が出され、活発な議論が行われる風土が定着しており、実効性がおおむね確保されていると評価しました。

昨年の課題について、中長期的課題に関する一層の議論充実に関しては、中長期戦略検討チームを立ち上げ、その検討内容を長期戦略検討会で議論する等の改善に取り組みました。後継者計画については、後継者候補と社外取締役との接点を増やす他、指名・報酬委員会にて育成計画について議論を進める等の改善に取り組みました。

他方、今回のアンケートを通じて以下のような課題も認識されました。

・中長期的な経営戦略の議論の深化
・後継者計画についての議論の深化
・グローバルガバナンス体制のさらなる強化

今後の対応

当社取締役会は、中長期的な経営戦略の議論の深化に向けては、議論すべき戦略テーマの整理や、必要な検討の枠組みの構築、取締役間での共有体制の整備等を推進します。

後継者計画については、既に行っている候補者との接点構築や育成施策を継続・充実させるとともに、指名・報酬諮問機関等での議論を一層深めていきます。

グローバルガバナンスについては、監督・モニタリングの体制整備を進めることで、リスク管理の強化に取り組んでいきます。

これらの取り組みを通じ、今後も取締役会の実効性確保に向けて努めます。

コンプライアンス

東京精密グループは、全てのステークホルダーの皆さまからの期待に応えられるよう、法令や社会的規範を遵守し、誠実かつ倫理的に行動します。そのため、当社の企業理念に基づく行動原則、全ての役員・従業員が心掛けるべき行動規範を定めた「ACCRETECHグループ行動規範」を制定し、当社グループの役員・従業員への企業倫理意識の浸透・定着を図っています。

ACCRETECHグループ行動規範
https://www.accretech.com/jp/company/action_guidelines.html

コンプライアンス管理体制

当社グループは、コンプライアンス統括責任者、コンプライアンス統括管理者を配置の上、業務会社カンパニー長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置しています。

コンプライアンス委員会は、「ACCRETECHグループ行動規範」の改定や諸規程の制改定、コンプライアンスに係る教育・研修の計画や取り組み状況など、コンプライアンス施策の推進について報告・審議しています。また、法令や諸規程などへの違反もしくは抵触の恐れがある場合は、速やかに取締役会および監査等委員会へ報告し、対応策や再発防止策の審議などを行っています。

2025年度、「コンプライアンス委員会」は9回開催されました。

コンプライアンス委員会

委員長	：業務会社カンパニー長
開催頻度	：年6回＋必要に応じて臨時開催
機能	：『ACCRETECHグループ行動規範』の改定および諸規程の制改定 コンプライアンスに関わる教育・研修の計画や取り組み状況についての審議 事業運営に関する主要な法令・社会規範等と対応する主管部署および関連組織を定め、法令遵守などの徹底を図る コンプライアンスに関する不祥事が発生した場合は、内容や対応策等を、取締役会および監査等委員会に報告する

コンプライアンス意識調査

コンプライアンス意識の浸透状況を確認するため、2021年度・2024年度に国内外の全従業員を対象とした匿名Webアンケート調査を実施しました。2024年度の調査では、前回課題に挙がった「業務量の負荷軽減」が解消された他、内部通報の認知度などで顕著な改善が見られました。

今後も実効性のある施策を継続し、より強固なコンプライアンス体制の構築に努めていきます。

▶コンプライアンス意識調査から得られた課題

- コンプライアンス遵守体制に関する取り組みの強化
- ハラスメントや差別解消に向けた取り組みの強化
- 内部通報窓口の認知向上に向けた取り組みの強化
- コミュニケーションをはじめとした組織風土の改善

贈収賄防止・腐敗防止

当社グループは、「ACCRETECHグループ行動規範」に定める行動指針に基づいた「贈収賄防止方針」を2020年1月に制定しています。不正防止に関する基本姿勢を明確化するとともに、従業員への啓発・教育を行っています。2025年度には、ACCRETECHグループ行動規範研修（e-learning）の中で、「法令、社会的規範等の遵守」「公正で誠実な事業活動」「接待・贈答への対応」に関する教育を実施しました。なお、万が一の違反事例はコンプライアンス委員会へ報告される体制を整えています。2025年度には、贈収賄および腐敗防止に関する違反事例はありませんでした。

贈収賄防止方針
https://www.accretech.com/jp/company/anti-bribery_anti-corruption_policy.html

コンプライアンス教育

当社グループは、コンプライアンスに関わる知識の充実とコンプライアンス意識レベルの維持向上のために、さまざまな教育の機会を設けています。

「新入従業員研修」や「管理職研修」など、階層別の研修機会を捉えた教育とともに、日本国内においてはe-learningによる研修も導入しています。毎年継続的に実施している研修テーマ「ACCRETECHグループ行動規範」を含め、2025年度のコンプライアンス研修を、全受講対象者に対し実施しました。

また、コンプライアンスに係る教育の計画と実績については「コンプライアンス委員会」へ定期的に報告をしています。

▶2025年度 ACCRETECHグループ企業行動規範研修

- 受講者数：3,477名（単体:1,574名、グループ：1,903名）
- 受講率：100%

コンプライアンス

内部通報制度

当社グループは、法令違反および人権侵害・ハラスメント行為や贈収賄といった不正な取引などの腐敗行為、その他の不適切な行為などについての通報や相談に応じる「内部通報制度」を導入しています。職制の上司以外に、コンプライアンス委員・事務局や、人事相談室、社外弁護士、社外取締役・監査等委員である取締役などに、直接通報できる社内外窓口を設けています。

内部通報については、通報者の匿名性の確保とプライバシー保護を徹底するとともに、通報者の不利益にならないよう配慮しています。また、通報内容と対応については「コンプライアンス委員会」へ報告し同委員会で審議することとしています。

2022年8月、内部通報制度規程を以下のように改定しました。

- 内部通報者の対象拡大（「公益通報者保護法」に合わせる）
- 匿名通報を匿名であることをもって受け付け拒否しないことを明確化
- 内部通報窓口だけでなく、調査に関わる関係者にも守秘義務を課す
- 調査への協力を依頼された者が虚偽の情報を提供すること、誹謗中傷、その他不正目的で情報提供することを禁止することを明確化

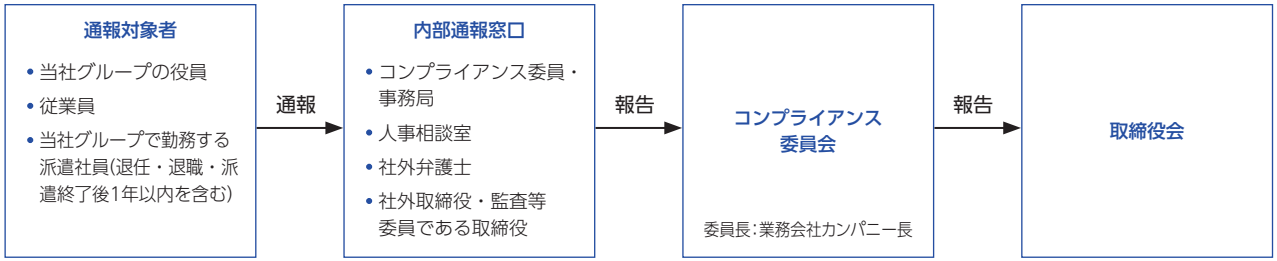
2025年度の内部通報実績は15件で、当社の事業活動に影響を与えるコンプライアンスに係る問題はありませんでした。

内部通報制度規程

1. 目的	4. 内部通報者の保護	7. 調査活動	10. 是正措置
2. 内部通報窓口	5. 内部通報者の身元秘匿	8. 調査協力	11. 処分
3. 内部通報の方法	6. 不正目的での通報の禁止	9. 調査に関わる者の保護	12. 内部通報者への説明

内部通報制度規程全文
https://www.accretech.com/jp/company/internal_reporting.html

内部通報体制図



▶通報または相談の対象事案

- 従業員、取引先、その他利害関係者の安全、健康に対して危険を及ぼす行為など
- 地域の環境の悪化もしくは破壊を招く行為など
- 企業行動規範、コンプライアンス規程、就業規則その他社内規程に重大な違反をする行為
- 各種ハラスメント行為
- その他法令違反や、不適切な行為、社会正義に反する行為
- 前各号の行為の隠蔽、証拠隠滅、情報漏えいなどの行為

コンプライアンス遵守状況

2025年度には、内部監査・外部監査による評価を実施した結果、当社の財務報告の適正さ、製品の品質・環境に対する取り組み、社内外全てのステークホルダーの皆さまへの対応などに関し、不正行為、法令違反、コンプライアンス違反などの事業活動に影響を与えるような問題はありませんでした。

リスク管理

東京精密グループは、持続的な成長と社会からの信頼獲得に向け、リスクマネジメントの推進を経営の重要課題と位置づけています。業務執行に関わるリスクの把握と管理を目的として「リスク管理規程」を定め、代表取締役社長を責任者とする「リスク管理委員会」を設置し、潜在的なリスクの発生予防と危機発生に備えた体制を整備しています。また、リスクが発生したときは、直ちに代表取締役社長を本部長とする「リスク対策本部」を設置し、リスクへの対応と速やかな収拾に向けた活動を行う体制を整えています。

リスク管理方針

1. 東京精密グループは、潜在的なリスクの発生予防に努めるとともに、リスクが顕在化したときは、代表取締役社長以下全従業員が一丸となって迅速かつ冷静に対応する。
2. リスクが顕在化したときは、人命の保護・救助を優先させる。

リスク管理方針およびリスク項目
https://www.accretech.com/jp/sustainability/esg/risk_management.html

リスク管理委員会

委員長　：代表取締役社長
開催頻度：年6回
機能　　：リスク主管部署等より、潜在的なリスクの発生予防について報告を受ける
定例委員会の議事内容について、必要に応じて取締役会に報告する
リスクの顕在化の報告があった場合は、リスクの内容や対応策を取締役会および監査等委員会に報告し、必要に応じ直ちに「リスク対策本部」を設置する

リスク項目とリスクの内容

事業を取り巻くリスクとは以下の場合をいいます。

1. 自然災害や突発的事象発生のリスク(地震、火災、風水害、テロなど)
2. 経済や金融市場の動向によるリスク(景気動向、為替レートの変動など)
3. お客さまの投資動向変化のリスク(半導体業界、自動車業界の変動など)
4. 競合他社や業界の動向によるリスク(価格競争、開発競争、知的財産権など)
5. 公的規制、政策、税務に関するリスク(カントリーリスクなど)
6. 人的資源に関するリスク(労働災害、不慮の事件・事故など)
7. 資本提供者に関するリスク(株式所有の変化など)
8. ITシステムに関するリスク(ITシステムの不具合など)
9. 製品・サービスの品質に関するリスク
10. 気候変動に関するリスク
11. その他事業遂行上のリスク

事業継続計画

当社グループは、従業員とその家族の安否確認・安全確保、および地域における人命保護・救助・復興活動とともに、顧客の操業維持に必要な部材などの供給維持を最優先とする「事業継続方針」を策定し、BCPおよび工場BCPの見直し・調整を実施しています。外部環境の変化を加味した上で、総務・生産管理・製造・ITなどの各部門レベルでの耐震補強策に加え、製品供給・サービス業務提供の継続策、実務面からのBCPやマニュアルの見直し・詳細化を引き続き実施していきます。

[主な取り組み]
・半導体製造装置向け保守パーツ・消耗品の社内・社外在庫の充実(2023年度からの継続取り組み)
・基幹システム(ERP)の年次DR*テスト

[大規模災害時の備蓄管理規程に基づく、各工場での備蓄・保管の管理]
八王子工場：1,922人の3日分
飯能工場　：　400人の3日分
土浦工場　：　 50人の3日分

＊DR(Disaster Recovery)：情報システムが自然災害などで深刻な被害を受けたときに、損害を軽減したり、機能を維持あるいは回復・復旧すること。また、そのための備えとなる設備や体制、措置などのこと

● 安否確認システム

当社は災害・事故発生時に携帯電話やスマートフォンから従業員の安否状況を確認する「安否確認システム」を導入しています。従業員入社時の説明と早期登録を徹底し、年2回の稼働訓練を行い、実効性の確認と認知度向上を図っています。メールによる安否確認に加え、安否アプリやメッセンジャーアプリを併用し、応答率向上やメールの受信遅延、受信拒否発生への対策を強化しています。引き続き、最終応答率と経過時間を集計し、改善策を実施していきます。

サイバーBCPの推進

当社グループは、深刻化するサイバー攻撃の脅威に備え、サイバーBCPの策定とサイバーレジリエンスの強化に注力しています。万が一、システム侵害やデータ暗号化等の有事が発生した場合でも、重要業務の停止を最小限に抑え、迅速に復旧・再開できる体制の構築を進めています。予期せぬ事態から柔軟に回復できる強靭な経営基盤を確立し、持続可能な企業価値の向上と社会的責任を果たしていきます。

リスク管理

情報セキュリティ

当社グループは、情報セキュリティの強化をリスクマネジメント推進における優先的な活動と定め、取り組みを進めています。お客さまや取引先から預かった情報資産および自社の情報資産を守るため、「情報セキュリティ基本方針」を定めています。変化の激しいデジタル環境において、常に最適なリスク管理を徹底し、誠実な企業活動を推進していきます。

情報セキュリティ基本方針
https://www.accretech.com/jp/company/securitypolicy.html

推進体制

情報セキュリティ委員会の委員長は業務会社カンパニー長が務め、各カンパニーにセキュリティ担当役員、管理責任者、セキュリティ部会を配置し、グループ会社も同委員会に参加しています。

情報セキュリティ委員会

委 員 長：業務会社カンパニー長
開催頻度：年2回
機　　能：情報セキュリティ管理体制の確立
情報セキュリティ規程の制定
情報セキュリティ対策の実施、教育・訓練、
定期的評価および継続的改善を実施する体制の推進、維持

SOCおよびCSIRTの設置

年々増大するサイバー攻撃の脅威に対し、外部SOCによる24時間365日の監視体制を構築しています。また専門チーム「ACCT-CSIRT」を設置し、平時における脆弱性の監視やインシデントの予防措置から、有事における迅速な復旧、外部専門機関との緊密な連携までを一貫して担い、事故対応マニュアルの定期的な見直しを通じてセキュリティ体制の高度化を図っています。

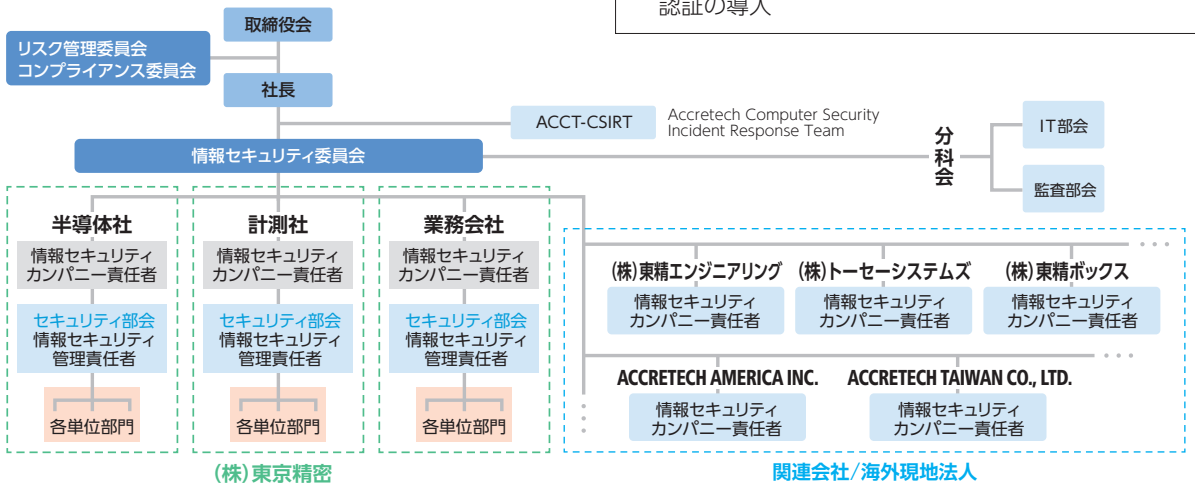
グループ・グローバルセキュリティ体制の見直し

インシデント発生時の迅速・的確な対処に向け、「ACCT-CSIRT」の対応フローと連携体制の強化を進めています。ガバナンスの実効性を高めるため、情報セキュリティ委員会や各拠点の役割分担を整理しました。また、グローバル展開に伴うリスクへ対応すべく、国内外のグループ会社を網羅する一元的な報告・連携に向けて活動を推進しています。

サプライチェーンにおける情報セキュリティの強化

当社は「サプライヤー情報セキュリティ基準」を定め、サプライチェーン全体のセキュリティ向上を推進しています。毎年のアンケート結果に基づき、個別フィードバックと対策解説書をサプライヤーへ提供。さらに説明会やCSRセミナーを通じて分析結果を共有し、有事の連絡体制整備やセキュリティ強化を働きかけています。サイバーリスクを共通の経営課題として認識し合うことで、強固なサプライチェーンを構築していきます。

情報セキュリティ体系図



情報セキュリティに関する目標と実績

	目標	実績
情報セキュリティに関する定期的な情報交換打ち合わせ回数	38回	38回
重大なインシデント発生件数	0件	0件
重大な個人情報漏えい件数	0件	0件
セキュリティ関連セミナーへの参加	2回／年	2回／年
セキュリティ関連専門教育の実施	3回／年	5回／年
情報セキュリティ教育受講率	100%	99.70%
標的型メール訓練の実施回数	4回	4回
サプライヤー向けのセキュリティ研修実施	1回	1回
海外現法の情報セキュリティ監査の実施	6社	6社

セキュリティ強化実施内容（2024年～）

- 外部SOCと契約して24時間365日のセキュリティ監視体制構築
- EDRソフトを国内外の全端末へ導入し、不審な挙動・サイバー攻撃を即座に検知・対応できる体制の構築
- グローバル共通データ管理基盤の導入
- インシデント発生時に迅速に対応する「ACCT-CSIRT」の活動開始
- サプライヤー情報セキュリティ基準に基づくセキュリティアンケートの実施
- 生体情報を活用した、リモートアクセス環境の多要素認証の導入

株主・投資家の皆さまとの対話

東京精密は、株主・投資家の皆さまに対し、適時適切な情報開示と建設的な対話を通じ、当社をより深く理解していただくためのIR活動に取り組んでいます。

IRディスクロージャーの基本方針

東京精密グループは、各種法令・規制、ならびに「ACCRETECHグループ行動規範」に基づき、公正で正確な情報を適時に開示し提供します。
また、株主・投資家等、ステークホルダーとの建設的な対話を促進することを目的に、東京精密グループをより深く理解していただくために有効と考えられる情報を適宜開示いたします。

IRディスクロージャーポリシー全文
https://www.accretech.com/jp/ir/irpolicy.html

情報開示方法

法令や証券取引所の規則にのっとり電子公告を行う他、東京証券取引所が運営する企業情報の適時開示情報伝達システム（TDnet）、金融庁の金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム（EDINET）などに掲載します。また、適時開示システムに連携した当社ホームページのIRサイトで開示しています。

決算情報などは、IRサイトのトップページよりダウンロードが可能な形に整理している他、格付情報などステークホルダーの皆さまに対する重要な情報は、当社ホームページのIRニュースを通じ、お知らせしています。

- 連結決算情報（決算短信、概要プレゼンテーション、説明会質疑応答など）
- 有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、確認書
- 株主総会招集ご通知、その他の電子提供措置事項、決議ご通知
- コーポレート・ガバナンス報告書
- 内部統制報告書
- 独立役員届出書
- 定款
- 統合報告書
- その他、投資判断に重要な影響を与える会社の業務、運営または業績などに関する情報

対話の機会

当社は、株主・投資家の皆さまに当社グループをより深く理解していただくため、以下のような対話の機会を設けています。これら株主・機関投資家との対話を通じて把握した意見などは適宜集約し、取締役会、経営執行会議で報告する他、関係各部門と共有しています。

2025年度の実績

	実施回数
(第103期)定時株主総会	1回 議決権行使率：82.0%
機関投資家・アナリスト 取材対応	延べ1,180回
海外投資家向けカンファレンス	8回
個人投資家向け説明会	1回 (Web参加者1,876名)
決算説明会・記者会見	4回

2025年度は、前年度より続く半導体製造装置業界の強い成長による当社の企業価値拡大を期待する声が高まり、当社と機関投資家・アナリストとの対話の機会がさらに増加しました。そうした中、当社は伝達すべき情報を定め、これらを決算説明会資料等で事前に共有し、限られた対話の時間をより中長期の考え方に向けられるようにした他、各種カンファレンスやグループミーティングへの参加機会を増やし、株主・投資家の要求に応えました。

インサイダー情報について

当社は、各種法令・規制、「ACCRETECHグループ行動規範」、ならびに社内規程にのっとり、インサイダー情報がTDnetならびに法令・規制が定める手段で開示されるまでは厳重に管理するとともに、インサイダー取引の未然防止を図っています。

さらに、IR担当者が特定のステークホルダーと対話を行う場合は、複数名で臨むことなどにより、インサイダー情報や有価証券の価額に重要な影響を及ぼす蓋然性が高い未公開情報が意図せず伝達されることがないよう留意します。

IR情報サイト

- **日本語サイト**
  https://www.accretech.com/jp/ir/
- **グローバルサイト**
  https://www.accretech.com/en/ir/

主要連結財務データ

	(単位)	2014年度 (2015年3月期)	2015年度 (2016年3月期)	2016年度 (2017年3月期)	2017年度 (2018年3月期)	2018年度 (2019年3月期)	2019年度 (2020年3月期)	2020年度 (2021年3月期)	2021年度 (2022年3月期)	2022年度 (2023年3月期)	2023年度 (2024年3月期)	2024年度 (2025年3月期)	2025年度 (2026年3月期)
売上高	百万円	66,445	70,274	77,792	88,194	101,520	87,927	97,105	130,702	146,801	134,680	150,534	166,839
半導体製造装置	百万円	40,179	41,773	50,291	59,523	69,117	56,198	71,745	101,145	112,365	100,055	113,481	127,878
精密測定機器	百万円	26,266	28,500	27,501	28,671	32,403	31,728	25,359	29,556	34,436	34,624	37,053	38,960
売上原価	百万円	40,275	42,185	48,152	53,818	60,430	53,452	60,190	77,694	84,967	79,917	88,081	97,978
売上総利益	百万円	26,169	28,089	29,640	34,375	41,090	34,474	36,914	53,008	61,834	54,762	62,453	68,860
営業利益	百万円	12,124	13,222	13,659	17,283	20,221	12,282	15,562	28,327	34,494	25,307	29,703	33,738
半導体製造装置	百万円	6,963	7,339	8,820	11,292	13,195	7,915	13,565	24,698	29,866	19,899	24,311	28,404
精密測定機器	百万円	5,160	5,883	4,839	5,990	7,025	4,366	1,996	3,628	4,628	5,408	5,392	5,333
営業外収益	百万円	726	243	318	170	688	255	540	987	965	1,404	921	1,481
営業外費用	百万円	59	232	112	138	104	177	235	153	162	259	684	394
経常利益	百万円	12,791	13,232	13,864	17,316	20,805	12,360	15,867	29,160	35,297	26,453	29,939	34,825
特別利益	百万円	9	8	583	4	58	57	1,354	390	103	824	4,493	194
特別損失	百万円	4	0	32	2	419	1,712	1,074	34	2,099	21	158	1,833
税引前当期純利益	百万円	12,796	13,240	14,415	17,318	20,443	10,705	16,147	29,516	33,301	27,255	34,275	33,186
法人税等	百万円	3,767	3,484	4,464	4,542	5,719	3,598	3,978	8,132	9,607	7,791	8,531	8,354
当期純利益	百万円	9,028	9,756	9,951	12,775	14,724	7,106	12,169	21,384	23,693	19,463	25,744	24,831
非支配株主に帰属する当期純利益	百万円	35	52	41	58	58	(49)	(6)	57	62	84	106	92
親会社株主に帰属する当期純利益	百万円	8,993	9,704	9,909	12,717	14,665	7,156	12,175	21,326	23,630	19,378	25,637	24,739
その他の包括利益	百万円	1,940	(2,557)	420	2,348	(2,483)	(722)	849	1,026	1,051	1,688	741	1,917
包括利益	百万円	10,969	7,199	10,371	15,124	12,240	6,384	13,018	22,411	24,745	21,152	26,486	26,749
自己資本当期純利益率 (ROE)	%	13.0	12.7	12.0	13.8	14.4	6.7	10.9	17.4	17.3	12.9	15.5	13.5
総資産当期純利益率 (ROA)	%	9.9	9.7	9.2	10.3	10.1	4.7	7.9	12.1	11.8	8.9	11.1	10.1
1 株当たり純資産 (BPS)	円	1,787.05	1,903.29	2,083.40	2,367.92	2,551.20	2,601.10	2,810.79	3,187.39	3,573.81	3,875.32	4,305.52	4,706.73
1 株当たり当期純利益 (EPS)	円	217.97	234.58	239.32	306.41	352.92	171.89	293.83	522.52	581.33	480.49	633.75	610.02
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	円	216.93	233.29	237.80	304.02	350.23	170.72	291.43	517.51	575.62	475.42	628.31	606.14
売上総利益率	%	39.4	40.0	38.1	39.0	40.5	39.2	38.0	40.6	42.1	40.7	41.5	41.3
営業利益率	%	18.2	18.8	17.6	19.6	19.9	14.0	16.0	21.7	23.5	18.8	19.7	20.2
半導体製造装置	%	17.3	17.6	17.5	19.0	19.1	14.1	18.9	24.4	26.6	19.9	21.4	22.2
精密測定機器	%	19.7	20.6	17.6	20.9	21.7	13.8	7.9	12.3	13.4	15.6	14.6	13.7
経常利益率	%	19.3	18.8	17.8	19.6	20.5	14.1	16.3	22.3	24.0	19.6	19.9	20.9
当期純利益率	%	13.5	13.8	12.7	14.4	14.4	8.1	12.5	16.3	16.1	14.4	17.0	14.8

主要連結財務データ

	(単位)	2014年度 (2015年3月期)	2015年度 (2016年3月期)	2016年度 (2017年3月期)	2017年度 (2018年3月期)	2018年度 (2019年3月期)	2019年度 (2020年3月期)	2020年度 (2021年3月期)	2021年度 (2022年3月期)	2022年度 (2023年3月期)	2023年度 (2024年3月期)	2024年度 (2025年3月期)	2025年度 (2026年3月期)
流動資産	百万円	67,873	72,710	82,792	94,990	110,094	97,771	111,516	133,829	143,972	153,831	169,341	174,607
固定資産	百万円	30,584	29,223	31,670	37,902	47,478	48,777	50,039	56,457	65,060	71,693	68,610	75,925
資産合計	百万円	98,457	101,933	114,463	132,893	157,573	146,549	161,556	190,287	209,032	225,524	237,952	250,533
流動負債	百万円	21,718	21,416	26,570	32,807	40,948	29,017	39,296	55,641	50,947	46,002	46,933	47,879
固定負債	百万円	2,367	1,099	698	731	9,220	7,857	5,482	3,564	12,057	21,094	14,789	9,737
純資産	百万円	74,371	79,418	87,194	99,354	107,403	109,674	116,777	131,081	146,028	158,427	176,229	192,916
負債・純資産合計	百万円	98,457	101,933	114,463	132,893	157,573	146,549	161,556	190,287	209,032	225,524	237,952	250,533
自己資本比率	%	75.0	77.3	75.5	74.0	67.3	73.9	71.4	68.1	69.0	69.4	73.2	76.3
ネット現預金	百万円	24,754	25,768	32,521	35,869	30,102	24,999	36,076	43,535	25,888	11,611	34,457	38,361
1株配当(普通配当)	円	55	59	72	92	105	76	104	185	235	192	253	262
1株配当(記念配当)	円	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—
自己株式の取得	百万円	2	2	1	2	1	1	3,002	2,501	1,583	922	1,383	3
配当性向	%	25.2	25.2	30.1	30.0	35.4	44.2	35.4	35.4	40.3	40.0	40.1	43.2
発行済株式数	株	41,340,681	41,423,381	41,495,581	41,575,881	41,598,381	41,695,381	41,759,981	41,869,581	41,903,281	42,104,381	42,170,081	42,282,881
うち自己株式数	株	34,609	35,393	35,819	36,251	36,791	37,207	715,164	1,222,956	1,529,552	1,705,058	1,705,289	1,695,286
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円	10,820	7,210	12,809	10,931	12,932	5,965	22,062	23,837	1,000	4,892	28,824	25,012
投資活動によるキャッシュ・フロー	百万円	(2,958)	(3,823)	(3,486)	(4,649)	(13,952)	(6,116)	(5,191)	(8,990)	(8,421)	(10,563)	2,541	(11,491)
財務活動によるキャッシュ・フロー	百万円	(1,762)	(2,851)	(2,953)	(3,163)	5,443	(6,375)	(8,282)	(10,346)	(2,174)	1,616	(13,991)	(15,674)
受注高	百万円	70,241	69,159	83,487	103,979	98,909	87,576	117,060	186,056	136,326	120,885	145,631	163,096
半導体製造装置	百万円	43,297	41,033	56,232	73,327	65,335	57,709	93,181	152,896	99,366	86,082	107,713	123,396
精密測定機器	百万円	26,943	28,126	27,254	30,651	33,573	29,866	23,878	33,159	36,960	34,802	37,917	39,700
受注残高	百万円	18,662	17,994	23,663	39,448	36,836	36,965	56,920	112,274	101,799	88,004	83,101	79,359
半導体製造装置	百万円	12,467	11,706	17,647	31,452	27,670	29,182	50,619	102,370	89,371	75,398	69,630	65,149
精密測定機器	百万円	6,194	6,288	6,015	7,996	9,165	7,782	6,301	9,904	12,428	12,606	13,470	14,210
受注高/売上高レシオ(BBレシオ)	—	1.06	0.98	1.07	1.18	0.97	1.00	1.21	1.42	0.88	0.90	0.97	0.98
半導体製造装置	—	1.08	0.98	1.12	1.23	0.95	1.03	1.30	1.51	1.07	0.86	0.95	0.96
精密測定機器	—	1.03	0.99	0.99	1.07	1.04	0.94	0.94	1.12	0.93	1.01	1.02	1.02
受注残高/売上高比率	%	28.1	25.6	30.4	44.7	36.3	42.0	58.6	85.9	69.3	65.3	55.2	47.6
半導体製造装置	%	31.0	28.0	35.1	52.8	40.0	51.9	70.6	101.2	79.5	75.4	61.4	50.9
精密測定機器	%	23.6	22.1	21.9	27.9	28.3	24.5	24.8	33.5	36.1	36.4	36.4	36.5

主要連結財務データ

	(単位)	2014年度 (2015年3月期)	2015年度 (2016年3月期)	2016年度 (2017年3月期)	2017年度 (2018年3月期)	2018年度 (2019年3月期)	2019年度 (2020年3月期)	2020年度 (2021年3月期)	2021年度 (2022年3月期)	2022年度 (2023年3月期)	2023年度 (2024年3月期)	2024年度 (2025年3月期)	2025年度 (2026年3月期)
研究開発費	百万円	5,744	6,292	6,791	7,194	7,469	8,234	7,193	8,146	8,542	9,042	10,354	12,037
半導体製造装置	百万円	4,645	5,104	5,443	5,826	6,154	6,216	5,748	6,728	6,798	7,383	7,989	9,254
精密測定機器	百万円	1,098	1,187	1,347	1,368	1,314	2,017	1,445	1,418	1,743	1,659	2,365	2,782
設備投資	百万円	3,249	3,795	4,145	3,547	13,872	7,477	5,950	9,793	9,725	11,602	10,245	11,069
半導体製造装置	百万円	2,459	2,940	3,647	2,543	12,235	3,832	3,499	9,223	7,248	8,652	6,590	7,224
精密測定機器	百万円	789	855	498	1,003	1,636	3,644	2,450	569	2,476	2,949	3,655	3,844
減価償却費	百万円	1,837	2,012	2,380	2,541	2,655	3,450	3,516	3,551	3,832	4,673	5,105	5,582
半導体製造装置	百万円	1,238	1,340	1,668	1,824	1,909	2,450	2,343	2,447	2,642	3,411	3,670	3,840
精密測定機器	百万円	599	671	711	716	746	1,000	1,172	1,103	1,189	1,262	1,435	1,741
のれんの償却額	百万円	427	261	102	102	226	41	28	29	42	54	49	45
半導体製造装置	百万円	133	119	102	102	102	39	7	7	8	9	9	6
精密測定機器	百万円	294	141	—	—	123	1	20	21	34	45	39	39
売上高研究開発費比率	%	8.6	9.0	8.7	8.2	7.4	9.4	7.4	6.2	5.8	6.7	6.9	7.2
半導体製造装置	%	11.6	12.2	10.8	9.8	8.9	11.1	8.0	6.7	6.1	7.4	7.0	7.2
精密測定機器	%	4.2	4.2	4.9	4.8	4.1	6.4	5.7	4.8	5.1	4.8	6.4	7.1
売上高設備投資比率	%	4.9	5.4	5.3	4.0	13.7	8.5	6.1	7.5	6.6	8.6	6.8	6.6
半導体製造装置	%	6.1	7.0	7.3	4.3	17.7	6.8	4.9	9.1	6.5	8.6	5.8	5.6
精密測定機器	%	3.0	3.0	1.8	3.5	5.1	11.5	9.7	1.9	7.2	8.5	9.9	9.9
売上高減価償却費比率	%	2.8	2.9	3.1	2.9	2.6	3.9	3.6	2.7	2.6	3.5	3.4	3.3
半導体製造装置	%	3.1	3.2	3.3	3.1	2.8	4.4	3.3	2.4	2.4	3.4	3.2	3.0
精密測定機器	%	2.3	2.4	2.6	2.5	2.3	3.2	4.6	3.7	3.5	3.6	3.9	4.5
正社員合計(*)	人	1,447	1,559	1,784	1,933	2,119	2,250	2,293	2,354	2,468	2,658	2,767	2,890
単体	人	637	679	726	809	868	912	944	992	1,054	1,200	1,292	1,428
連結子会社	人	810	880	1,058	1,124	1,251	1,338	1,349	1,362	1,414	1,458	1,475	1,462
非正規社員合計(*)	人	620	690	720	820	980	980	996	1,123	1,258	553	566	597
単体	人	380	440	445	500	620	610	611	712	783	323	337	365
連結子会社	人	240	250	275	320	360	370	385	411	475	230	229	232
従業員合計(*)	人	2,067	2,249	2,504	2,753	3,099	3,230	3,289	3,477	3,726	3,211	3,333	3,487
単体	人	1,017	1,119	1,171	1,309	1,488	1,522	1,555	1,704	1,837	1,523	1,629	1,793
連結子会社	人	1,050	1,130	1,333	1,444	1,611	1,708	1,734	1,773	1,889	1,688	1,704	1,694
正社員平均年齢(単体)	歳	41.8	41.3	41.4	40.9	40.4	40.0	39.9	39.8	39.6	39.2	38.9	38.5
正社員平均勤続年数(単体)	年	13.2	12.7	12.5	12.1	11.6	11.2	11.2	11.1	11.1	10.2	10.1	9.5
正社員平均年間給与(単体)	円	7,329,971	7,523,864	7,426,572	7,815,525	7,582,169	7,152,806	7,013,791	7,496,101	7,984,646	8,018,157	7,828,240	8,276,412
連結子会社	社	13	14	16	16	17	17	17	17	17	17	17	16
国内連結子会社	社	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5
海外連結子会社	社	8	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
非連結子会社	社	16	17	15	14	14	16	16	13	12	12	11	11
関連会社	社	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	2

* 統合報告書では、有価証券報告書に記載されている従業員数を正社員数と表記し、正社員数に非正規社員数を加えたものを従業員数と表記しています。また2023年度以降、派遣社員は対象外としています。

非財務データ

環境関連

			2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量							
Scope1 [GJ]	連結		—	—	—	26,409	25,302
	㈱東京精密(単体)	生産拠点	1,506	1,502	1,756	1,873	1,913
		その他(*1)	—	—	—	6,352	6,416
	連結子会社	国内	—	—	—	9,157	8,848
		海外	—	—	—	9,027	8,126
Scope2 [GJ]	連結		—	—	—	456,494	489,378
	㈱東京精密(単体)	生産拠点	287,891	287,042	323,412	375,567	387,900
		その他(*1)	—	—	—	6,690	6,171
	連結子会社	国内	—	—	—	40,454	60,454
		海外	—	—	—	33,782	34,853
再生可能エネルギー電力割合 [%]	㈱東京精密(単体)	生産拠点	18.5	29.8	27.5	43.9	48.1
CO_2排出量							
CO_2排出量合計 (Scope1+Scope2) [t-CO_2]	連結		—	—	—	18,846	19,446
	㈱東京精密(単体)	生産拠点	8,191	8,257	11,598	12,733	12,796
		その他(*1)	—	—	—	767	754
	連結子会社	国内	—	—	—	2,608	3,566
		海外	—	—	—	2,738	2,330
CO_2排出量 生産高原単位 (Scope1+Scope2)[t-CO_2/百万円]	㈱東京精密(単体)	生産拠点	0.080	0.074	0.111	0.103	0.091
発電量							
太陽光発電 [MWh]	㈱東京精密(単体)	生産拠点	494.2	469.6	659.9	1,022.0	1,023.8
取水							
取水量合計 [m^3]	連結		—	—	—	214,028	253,898
	㈱東京精密(単体)	生産拠点	163,662	164,150	168,685	172,482	212,787
		その他(*1)	—	—	—	1,296	1,247
	連結子会社	国内	—	—	—	13,329	14,125
		海外	—	—	—	26,921	25,740
生産高原単位 [m^3/百万円]	㈱東京精密(単体)	生産拠点	1.61	1.48	1.59	1.39	1.52
排水							
工業排水 [m^3]	連結		—	—	—	201,570	252,529
	㈱東京精密(単体)	生産拠点	163,662	164,150	168,685	172,482	212,787
		その他(*1)	—	—	—	1,296	1,247
	連結子会社	国内	—	—	—	13,329	14,125
		海外	—	—	—	14,463	24,370
水リサイクル							
純水製造設備(*2)の水リサイクル率 [%]	㈱東京精密(単体)	生産拠点	17.2	17.7	17.1	17.4	18.3

*1 営業所・出張所等を除く
*2 東京精密 八王子工場

人財関連

	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
連結従業員の状況					
従業員数合計 [人]	3,477	3,726	3,211	3,333	3,487
正社員合計 [人]	2,354	2,468	2,658	2,767	2,890
女性割合 [%]	—	—	15.0	15.0	15.5
東京精密単体の状況					
従業員数合計(*1,3) [人]	1,704	1,837	1,523	1,629	1,793
正社員合計 [人]	922	1,054	1,200	1,292	1,428
正社員に占める女性割合 [%]	7.4	8.5	10.2	11.3	11.7
管理職女性比率 [%]	1.9	2.4	2.1	2.6	2.9
役員女性比率 [%]	7.7	15.4	16.7	16.7	30.0
正社員平均年齢 [歳]	39.8	39.6	39.2	38.9	38.5
正社員平均勤続年数 [年]	11.1	11.1	10.2	10.1	9.5
男性 [年]	11.4	11.5	10.6	10.5	10.0
女性 [年]	7.5	7.3	6.3	6.4	6.2
新卒入社3年後定着率 [%]	87.7	88.4	95.5	91.2	87.3
離職率 [%]	4.1	3.7	4.0	3.5	3.5
障がい者雇用率(*2) [%]	1.95	2.07	2.17	2.39	2.43
育児休業取得率 [%]	19.2	42.9	58.6	59.3	83.9
男性 [%]	19.2	38.5	57.1	54.2	80.8
女性 [%]	対象者なし	100.0	100.0	100.0	100.0
研修時間の総計 [時間]	6,445.9	9,938.7	14,992.9	14,668.2	15,482.2
1人当たりの平均研修時間 [時間]	7.0	9.4	12.5	11.4	10.8
1人当たりの教育投資額 [円]	29,415.3	35,576.5	41,981.4	40,909.3	38,712.0

*1 統合報告書では、有価証券報告書に記載されている従業員数を正社員数と表記し、正社員数に非正規社員数を加えたものを従業員数と表記。
*2 該当年度の6月1日時点。なお、雇用者数および雇用率は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」にのっとり、重度の障がいのある人の1人の雇用をもって「2人」と見なしています。
*3 2023年度より従業員の公開人員数の社内定義を変更し、派遣社員を除いた員数としています。

会社情報・株式情報

会社情報 (2026年3月31日 現在)

会社商号 ： 株式会社東京精密
URL ： https://www.accretech.com
本社所在地 ： 東京都八王子市石川町2968-2
設立 ： 昭和24年（1949年）3月28日
資本金 ： 11,748百万円
従業員数* ： 単体 1,793名
連結 3,487名
主要事業 ： 半導体製造装置と精密測定機器の製造販売

* 統合報告書では、有価証券報告書に記載されている「従業員数」を「正社員数」として記載し、これに非正規社員数を加えた合計を「従業員数」として表記。

関連会社

(国内)
(株) 東精エンジニアリング
(株) トーセーシステムズ
(株) アクレーテク・クリエイト
(株) 東精ボックス
(株) アクレーテク・ファイナンス

(海外)
ACCRETECH AMERICA INC.
ACCRETECH (EUROPE) GmbH
ACCRETECH KOREA CO., LTD.
東精精密設備 (上海) 有限公司
ACCRETECH TAIWAN CO., LTD.
ACCRETECH (MALAYSIA) SDN. BHD.
ACCRETECH ADAMAS (THAILAND) CO., LTD.
ACCRETECH (THAILAND) CO., LTD.
東精計量儀 (平湖) 有限公司
TOSEI (THAILAND) CO., LTD.
ACCRETECH SBS, INC.
ACCRETECH (SINGAPORE) PTE. LTD.
ACCRETECH VIETNAM CO., LTD.
PT ACCRETECH INDONESIA
ACCRETECH-TOSEI DO BRASIL LTDA.
PT TOSEI INDONESIA
TOSEI PHILIPPINES CORPORATION
TOSEI ENGINEERING PRIVATE LIMITED
TOSEI MEXICO S.A.DE.C.V.
ACCRETECH-TOSEI HUNGARY KFT.
東精精密設備 (平湖) 有限公司
ACCRETECH-SBS UK LTD.

株式情報

概要 (2026年3月31日現在)

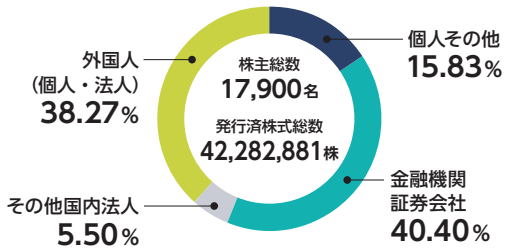
証券コード	7729
上場証券取引所	東京証券取引所　プライム
発行済株式総数	42,282,881株
株主数	17,900名

大株主（上位10名） (2026年3月31日現在)

氏名または名称	持株数 (千株)	持株比率 (%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	6,797	16.67
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	4,382	10.75
JP MORGAN CHASE BANK 385642	1,540	3.78
THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON SECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT	1,179	2.89
公益財団法人精密測定技術振興財団	1,058	2.60
株式会社みずほ銀行	672	1.65
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	657	1.61
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT	569	1.40
JP MORGAN CHASE BANK 385781	560	1.37
矢野信太郎	559	1.37

(注) 持株比率は、自己株式(1,505,586株)を控除して計算しております。

所有者別状況 (2026年3月31日現在)



編集方針・報告対象

編集方針

東京精密グループは、お客さま、株主・投資家をはじめとしたステークホルダーの皆さまに、財務情報と環境や社会、ガバナンスといった非財務情報を統合的にお伝えするとともに、東京精密グループの持続的な企業価値向上に向けた取り組みをご理解いただくため、2022年度より統合報告書を発行しています。

本年度版は、中期経営計画（2025-2027年度）の2年目として、初年度の具体的な進捗や成果、見えてきた課題への対応策を分かりやすく開示しています。

編集にあたってはIIRC（現、IFRS財団）の「国際統合報告フレームワーク」、経済産業省の「価値協創ガイダンス2.0」を参考にするとともに、皆さまから頂戴した貴重なご意見を参考にし、改善に努めています。本報告書が、当社に対するご理解を一層深めていただく一助となれば幸いです。

Environment Social Governance
価値協創ガイダンス

情報開示体

本報告書に掲載されていない詳細な財務情報、非財務情報などは、Webサイトをご覧ください。



報告対象

報告期間

2025年4月1日～2026年3月31日を主たる対象期間としていますが、一部当該期間の前後する記述も含まれます。

報告対象組織

株式会社東京精密ならびに連結子会社（当社グループ）。

原則として、株式会社東京精密ならびに連結子会社について報告していますが、非財務データの一部については株式会社東京精密を対象組織としています。

会計基準

別途記載がない限り、日本会計基準（JAPAN GAAP）に準拠しています。

将来の見通しに関する注意事項

本報告書に記載されている将来についての計画、戦略、見通しなどは、開示時点で当社が合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績などの結果はさまざまな要因により異なる可能性があります。

発行時期

2026年10月

お問い合わせ先

株式会社東京精密
〒192-8515　東京都八王子市石川町2968-2
https://www.accretech.com/jp/contact/index.html

株式会社東京精密

〒192-8515　東京都八王子市石川町2968-2
TEL：(042) 642-1701　FAX：(042) 642-1798
URL：https://www.accretech.com

